

# STRUKTUREN OPTIMIEREN – ZUKUNFT GESTALTEN

A decorative horizontal band consisting of a grid of small, light blue squares.

Geschäftsbericht 2010

# INHALT

- 2 Vorstandsinterview
- 8 Bericht des Aufsichtsrats



## 14 STRUKTUREN OPTIMIEREN

---



## 18 STERNENFELS, EIN STANDORT MIT POTENZIAL

---

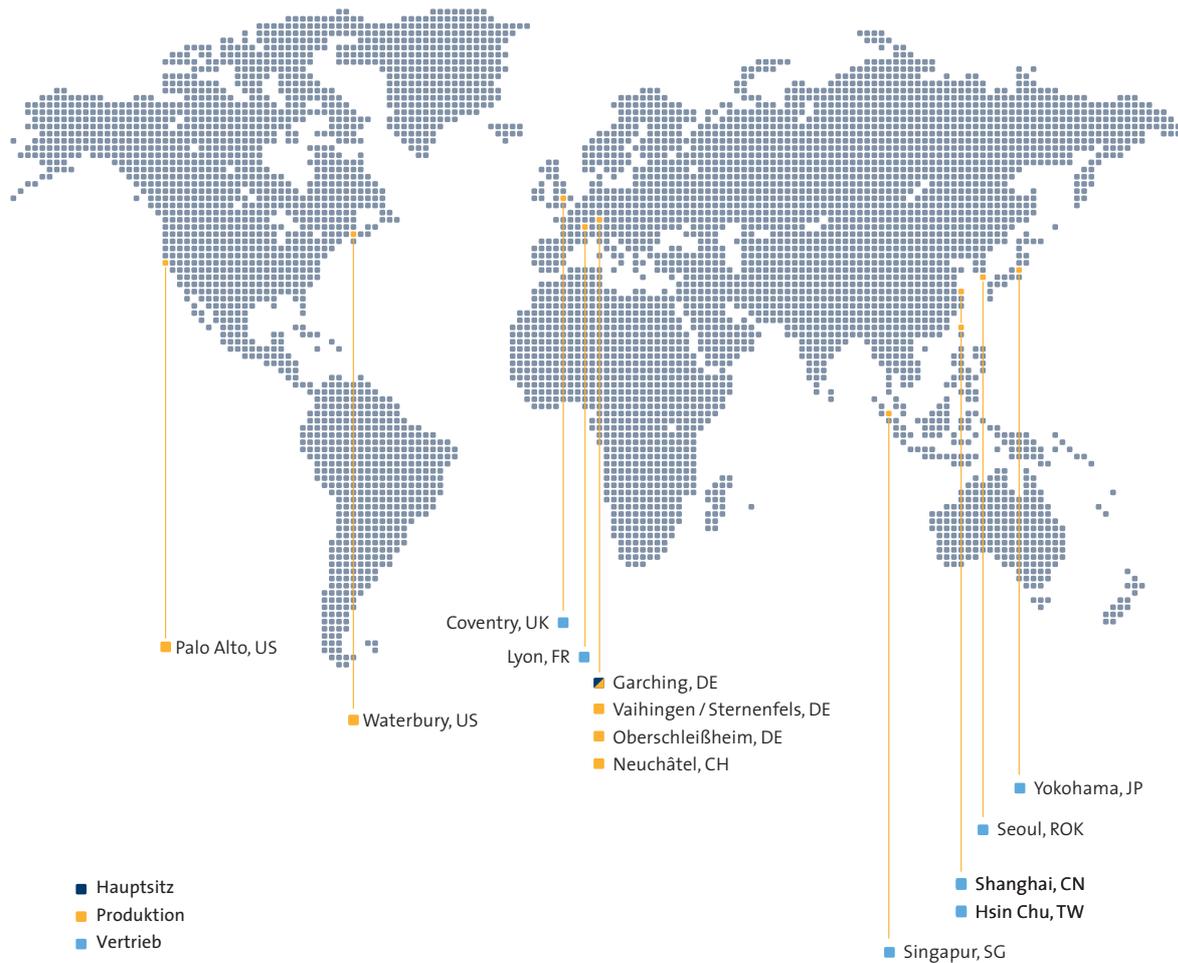


## 22 FOKUS AUF WACHSTUMS- MÄRKTE

---

- 28 Investor Relations
- 32 Corporate Governance
- 44 Konzernlagebericht
- 73 Konzernabschluss
- 88 Konzernanhang
- 140 Service

# WELTWEIT GUT AUFGESTELLT



## 2010

### NORDAMERIKA

Mitarbeiter 140  
Umsatz 19,0 Mio. €

### EUROPA

Mitarbeiter 380  
Umsatz 36,7 Mio. €

### JAPAN

Mitarbeiter 20  
Umsatz 6,9 Mio. €

### SONSTIGES ASIEN

Mitarbeiter 76  
Umsatz 76,5 Mio. €

# KENNZAHLEN

in Mio. €	2010	2009	2008	Veränderung 2010 / 2009
<b>Fortgeführte Aktivitäten</b>				
Auftragseingang	189,3	96,3	118,2	96,7%
Auftragsbestand zum 31.12.	116,1	57,0	65,1	103,7%
Umsatz gesamt	139,1	103,9	121,5	33,9%
Umsatzrendite	9,3%	0,5%	-9,5%	8,8 %-Punkte
Rohertrag	51,1	38,8	38,3	31,7%
Rohertragsmarge	36,7%	37,4%	31,6%	-0,7 %-Punkte
Herstellungskosten	88,0	65,1	83,1	35,2%
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,8	4,9	5,7	38,8%
<b>Fortgeführte Aktivitäten</b>				
EBITDA	20,5	7,6	9,2	169,7%
EBITDA-Marge	14,7%	7,3%	7,6%	7,4 %-Punkte
EBIT	14,3	2,8	-8,7	410,7%
EBIT-Marge	10,3%	2,7%	-7,2%	7,6 %-Punkte
Ergebnis nach Steuern	13,0	0,5	-11,6	▸ 250%
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	0,71	0,03	-0,68	▸ 250%
<b>Fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten</b>				
Ergebnis nach Steuern	13,4	-4,9	-13,9	373,5%
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	0,73	-0,28	-0,82	360,7%
<b>Bilanz und Cashflow</b>				
Eigenkapital	106,4	86,1	90,6	23,6%
Eigenkapitalquote	58,6%	63,1%	59,0%	-4,5 %-Punkte
Eigenkapitalrentabilität	12,2%	0,6%	-12,8%	11,6 %-Punkte
Bilanzsumme	181,6	136,4	153,6	33,1%
Net Cash	34,6	18,4	9,4	88,0%
Free Cashflow <sup>(1)</sup>	14,1	8,9	1,9	58,4%
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Investitionen <sup>(2)</sup>	3,0	3,1	9,0	-3,2%
Investitionsquote	2,2%	3,0%	7,4%	-0,8 %-Punkte
Abschreibungen	6,2	4,8	17,9	29,2%
Mitarbeiter zum 31.12. <sup>(3)</sup>	616	498	545	23,7%
Mitarbeiter zum 31.12. <sup>(4)</sup>	616	614	674	0,3%

<sup>(1)</sup> vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben, Wertpapierverkäufen und Sondereffekten aus Erwerb und Verkauf von Tochtergesellschaften

<sup>(2)</sup> ohne Berücksichtigung des Erwerbs HamaTech und des Grundstücks Sternenfels

<sup>(3)</sup> fortgeführte Aktivitäten

<sup>(4)</sup> fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten

# SEGMENTINFORMATIONEN

## FOTOMASKEN EQUIPMENT



Produkte  
Mask Track

Adressierte Märkte  
Halbleiterindustrie

Umsatz 2010  
↗ 18,4 Mio.€

Ergebnis 2010  
↗ 2,1 Mio.€

## LITHOGRAFIE



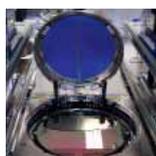
Produkte  
Mask Aligner  
Entwicklungssysteme  
Spin- und Spray-Coater

Adressierte Märkte  
Advanced Packaging  
Mikrosystemtechnik (MEMS)  
Verbindungshalbleiter  
3D-Integration

Umsatz 2010  
↗ 88,9 Mio.€

Ergebnis 2010  
↗ 17,0 Mio.€

## SUBSTRAT BONDER



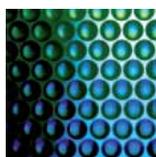
Produkte  
Substrat (Wafer) Bonder

Adressierte Märkte  
3D-Integration  
Mikrosystemtechnik (MEMS)  
Verbindungshalbleiter

Umsatz 2010  
↗ 24,7 Mio.€

Ergebnis 2010  
↘ -7,1 Mio.€

## SONSTIGE



Produkte  
Masken  
Mikrooptik und -linsen  
C4NP

Adressierte Märkte  
Mikrooptik  
Halbleiterindustrie  
Advanced Packaging (C4NP)

Umsatz 2010  
↗ 7,0 Mio.€

Ergebnis 2010  
↗ 2,3 Mio.€

## NEUE STRUKTUREN BEI SÜSS MicroTec

Wir blicken heute auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2010 zurück. Wie fällt der Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr aus Ihrer Perspektive aus?

**FRANK AVERDUNG:** Auch aus meiner Sicht blicken wir auf ein sehr erfolgreiches, aber ebenso bewegtes Geschäftsjahr zurück. In kaum einem Jahr der Firmengeschichte hat es maßgeblichere Veränderungen im Unternehmen gegeben, nie zuvor hat die SÜSS MicroTec einen stärkeren Wandel in so kurzer Zeit vollzogen. Wir haben wichtige Weichenstellungen für die strategische Neuausrichtung des Konzerns vorgenommen.

Können Sie etwas genauer darauf eingehen, welche Veränderungen Sie in 2010 eingeleitet haben?

**FRANK AVERDUNG:** Wir haben uns beispielsweise Anfang 2010 vom verlustträchtigen Bereich Test Systeme getrennt. Dieser Bereich konnte trotz technologisch führender Produkte aufgrund der sehr starken Wettbewerbssituation im Markt nicht mehr profitabel wirtschaften. Auf der anderen Seite haben wir mit der Akquisition der HamaTech APE unsere Kernkompetenz der Fertigungslösungen für die Mikrostrukturierung in der Mikroelektronik weiter verstärkt. Die HamaTech APE hat sich in der Vergangenheit als weltweit führender Ausrüster für die Reinigung von Fotomasken in der Halbleiterindustrie etabliert. Daneben hat im abgelaufenen Geschäftsjahr der Umzug unserer Bonder und der Coater- und Developer-Fertigung an den Standort Sternenfels sowie die Integration der HamaTech APE in die SÜSS MicroTec-Gruppe unser besonderes Augenmerk gefordert.

Was war das Ziel dieser Maßnahmen?

**MICHAEL KNOPP:** Mit diesen Maßnahmen haben wir unser Konzernportfolio nicht nur optimiert, sondern es ist uns gelungen, die Komplexität der Unternehmensstruktur deutlich zu verringern. Durch die eingeleiteten Maßnahmen hat darüber hinaus das gesamte Unternehmen enorm an Flexibilität gewonnen. Die Zusammenlegung der Produktlinien Substrat Bonder mit den Coatern / Developern sowie dem Fotomasken Equipment am Standort Sternenfels erfolgte vor dem Hintergrund der Optimierung und Vereinfachung der Unternehmensstruktur sowie dem Ziel der Reduzierung von noch vier Entwicklungs- und Fertigungsstandorten im Januar 2010 auf zukünftig zwei hocheffiziente deutsche Standorte. Des Weiteren ermöglicht die Bündelung der Coater- und Bonderproduktlinien an einem Standort die Realisierung von Technologie- und Fertigungssynergien im Bereich des „temporären Bondens“ sowie ein flexibleres und schnelleres Reagieren auf Marktanforderungen.

Neben den Kostenvorteilen in Entwicklung und Produktion bietet das Produktionsgelände in Sternenfels darüber hinaus die notwendigen räumlichen Voraussetzungen, um die Wachstumsperspektive 3D-Integration erfolgreich wahrnehmen zu können. Mit dem Umzug wird dem zukünftig antizipierten Platzbedarf sowie den steigenden Anforderungen an moderne Produktions- und Reinraumstandards Rechnung getragen. Alternativ hätte der aktuelle US-Standort Waterbury aufwendig ausgebaut werden müssen.

Trotz dieser strukturellen Veränderungen haben Sie ausgezeichnete Geschäftszahlen vorgelegt. Wie sehen die wichtigsten Kennzahlen im Einzelnen aus?

**MICHAEL KNOPP:** Unsere Aufgabe im Jahr 2010 war es, die hart erkämpften schlanken Kostenstrukturen auch in einem von Wachstum geprägten Marktumfeld aufrechtzuerhalten. Wie Sie mit einem Blick auf den Jahresabschluss erkennen können, ist uns dies sehr gut gelungen. Wir konnten – trotz Akquisition und Restrukturierung – unsere Liquiditätsposition über das Jahr hinweg kontinuierlich verbessern. 2010 war im Hinblick auf Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis in jeder Hinsicht ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Im zweiten, dritten und auch im vierten Quartal konnten jeweils Auftragseingänge auf Rekordniveau verbucht werden. Der Auftragseingang betrug für

das Gesamtjahr rund 189 Millionen Euro und hat damit deutlich das Vorjahresniveau übertroffen. 2010 erwirtschaftete das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 139 Millionen Euro und übertraf somit den Vorjahreswert von 104 Millionen Euro um rund 34 Prozent. Durch den Umsatzanstieg, aber auch aufgrund der wesentlich schlankeren Kostenstruktur ist es uns im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich zu steigern. Das EBIT lag nach knapp 3 Millionen Euro in 2009 im vergangenen Geschäftsjahr bei 14,3 Millionen Euro. Im EBIT enthalten sind Sonderaufwendungen aus den Investitions- und Desinvestitionsaktivitäten des abgelaufenen Geschäftsjahres in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro. Im Einzelnen waren dies Kosten in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro für die



links:  
**FRANK AVERDUNG**  
Vorstandsvorsitzender

rechts:  
**MICHAEL KNOPP**  
Finanzvorstand

Verlagerung der Bonder-Aktivitäten von Waterbury, USA, nach Sternenfels und ein Ertrag aus einem Badwill in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro, der im Rahmen der HamaTech Akquisition erworben wurde. Mit 0,3 Millionen Euro schlug der Umzug der Coater- und Developer-Produktion von Vaihingen nach Sternenfels zu Buche. Darüber hinaus enthält das EBIT für das Geschäftsjahr 2010 einmalige Währungseffekte in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Diese resultieren aus der Rückführung von konzerninternen Fremdwährungskrediten durch die Süss MicroTec Inc., Waterbury, im Zusammenhang mit der im Dezember erfolgten Übertragung von immateriellen Vermögenswerten an die Süss MicroTec Lithography GmbH. Somit liegt das bereinigte EBIT für 2010 bei 14,0 Millionen Euro.



**Sie haben im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut einen positiven Cashflow erwirtschaftet. In Folge dessen ist Ihre Netto Cash Position deutlich angewachsen. Planen Sie eine Beteiligung Ihrer Aktionäre, etwa durch Ausschüttung einer Dividende?**

**MICHAEL KNOPP:** Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen sowie Sondereffekten aus den getätigten M&A-Aktivitäten einen freien Cashflow von 14,1 Millionen Euro erwirtschaften. Damit hat sich unsere Liquiditätsposition weiter verbessert und wir konnten zum Jahresende eine Netto Cash Position in Höhe von 34,6 Millionen Euro ausweisen. In einem schnell wachsenden und technologisch sehr anspruchsvollen Umfeld ist es unabdingbar, genügend liquide Mittel für die Finanzierung des laufenden Geschäfts, aber auch des geplanten Wachstums vorzuhalten. Darüber hinaus möchte die Süss MicroTec nicht nur organisch, sondern auch anorganisch wachsen. Vor diesem Hintergrund werden wir keine Ausschüttung einer Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr vorschlagen.

**Sie haben 2010 sehr gute Ergebnisse vorgelegt, dabei kamen Ihnen die verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen doch sicher zu Gute?**

**FRANK AVERDUNG:** Nach dem zyklischen Abschwung der Halbleiterbranche und der zeitgleich verlaufenden Wirtschaftskrise in 2008 / 2009 hat sich die Weltkonjunktur im Jahr 2010 deutlich schneller erholt, als noch Ende 2009 erwartet. Unsere Kernmärkte sind nach zwei sehr schwierigen Jahren erneut auf Wachstumskurs gegangen. Insbesondere im Halbleiterbereich hat sich die Nachfrage nicht nur erholt, sondern ist



rapide angestiegen. 2010 wuchs der weltweite Markt für Halbleiter um mehr als 30 Prozent. Auch unsere anderen Zielmärkte MEMS und LED wiesen ein sehr dynamisches Wachstum auf. Durch unsere breit gefächerte Aufstellung in den Endmärkten sind wir in geringerem Maße vom Halbleiterzyklus abhängig als andere Equipment-Hersteller.

Unabhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben wir unseren 2009 eingeschlagenen Kurs konsequent weiterverfolgt, um auch in Zukunft mit unseren Produkten und Lösungen am Markt erfolgreich zu sein. Dies zeigt sich nun auch in den verbesserten Ergebnissen. Die SÜSS MicroTec hat ihre Fähigkeiten zur nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes weiter ausgebaut und wird sich dieser Herausforderung auch in Zukunft stellen.

#### Sind Sie 2010 neue Partnerschaften eingegangen bzw. gab es wichtige Produkteinführungen?

**FRANK AVERDUNG:** Ja, auch 2010 ist SÜSS MicroTec wichtige strategische Partnerschaften eingegangen. Zeitgleich mit dem Verkauf des Bereichs Test Systeme haben wir mit dessen Käufer, Cascade Microtech Inc., eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Auch mit der Koordination des europaweiten Forschungsprojektes JEMSIP\_3D, dessen Aufgabe die Vereinfachung der neuen Herstellprozesse, Anlagen und Materialien für die 3D-Integration ist, positioniert sich SÜSS MicroTec in diesem Bereich. Weiterhin wurde im Dezember eine Entwicklungs- und Exklusiv-Lizenzvereinbarung mit der Rolith, Inc. abgeschlossen. Die Zusammenarbeit wird die Entwicklung und den Bau von Anlagen für die Nanostrukturierung

beinhalten. Darüber hinaus wurde SELECT im abgelaufenen Geschäftsjahr in den Markt eingeführt. Es handelt sich hierbei um eine Technologieerweiterung für Bond Aligner und Mask Aligner, die eine selektive Plasmaaktivierung von Wafer-Oberflächen ermöglicht. SÜSS MicroTec arbeitet kontinuierlich an einer Erweiterung des bestehenden Produktportfolios.

#### Eine gewisse Volatilität gehört in Ihrer Branche zum Alltag, an welcher Stelle im Zyklus befinden wir uns Ihrer Einschätzung nach aktuell?

**FRANK AVERDUNG:** Historisch lässt sich die Zyklusbreite von etwa vier bis fünf Jahren ableiten, die maßgeblich von der Entwicklung im Frontend-Bereich der Halbleiterfertigung bestimmt wird. Hier sehen wir alle zwei Jahre umfassende Investitionen in neue Maschinen, mit denen sich noch kleinere Halbleiterstrukturen realisieren lassen. Im Unterschied zum Frontend-Bereich, der die Herstellung der Chips in den sogenannten „Fabs“ umfasst, sind wir weitestgehend im Backend-Bereich tätig. Hier dreht sich alles um die Weiterverarbeitung der fertigen Wafer wie etwa das Aufbringen von Verbindungsstrukturen sowie die Vereinzelung und Verpackung der Chips. 2010 gab es ein deutliches Wachstum bei Maschinenumsätzen in beiden Segmenten, für 2011 erwarten wir für den Umsatz mit diesen Maschinen einen weiteren Zuwachs von knapp 10 Prozent.

#### Von welchen Trends ist Ihr Geschäft derzeit getrieben und von welchen Trends werden Sie zukünftig profitieren?

**FRANK AVERDUNG:** Generell profitieren wir von zwei sehr langfristigen Entwicklungen. Zum einen nimmt die Zahl der produzierten Chips ständig zu, zum anderen steigt der Anteil komplexer Chips, die eine Advanced-Packaging-Lösung, wie wir sie anbieten, erforderlich macht. Die Chips, die auf unseren Maschinen weiterverarbeitet werden, müssen immer kleiner werden, dürfen dabei ihren Preis aber nicht verändern. Dieser Megatrend lässt sich mit den Schlagworten „Miniaturisieren – Stapeln – Integrieren“ sehr gut beschreiben. Unsere Produkte und Lösungen sind ausgezeichnet auf diese Entwicklung zugeschnitten. Nehmen Sie zum Beispiel das Marktsegment 3D-Integration. Hier bieten wir mit unserer Substrat Bonder-Produktlinie Lösungen für das Bonden und die Handhabung von gedünnten Wafern an.

Darüber hinaus bergen die innovativen Märkte für MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) und LED immense Wachstumschancen. So finden MEMS-basierte Sensorikbausteine neben der klassischen Anwendung im Auto, wie z. B. in Airbag-Sensoren, in immer mehr Konsumelektronik-Produkten eine Verwendung. Man denke hier zum Beispiel an Bewegungssensoren in Kontrolleinheiten für Spielkonsolen oder Lagesensoren in modernen Mobiltelefonen und Digitalkameras.

#### Wie sieht Ihr Ausblick für das kommende Geschäftsjahr aus?

**FRANK AVERDUNG:** Anfang 2010 hatten wir in unserem Brief an die Aktionäre von einer langsamen konjunkturellen Belebung gesprochen. Die Realität hat uns gezeigt, dass die Weltwirtschaft deutlich stärker und schneller als erwartet gewachsen ist. Darüber hinaus scheint das Vertrauen in die Finanz- und Kapitalmärkte langsam zurückzukehren. Die Prognosen für 2011 erwarten eine weitere Stabilisierung der Weltwirtschaft. Im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten, insbesondere innerhalb der Europäischen Währungsunion, fällt unsere Gesamtprognose für das kommende Geschäftsjahr vorsichtig optimistisch aus.

#### Für Ihre Aktie war es auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Was waren die Gründe dafür?

**FRANK AVERDUNG:** Nach zwei sehr schwierigen Jahren – auch für unser Unternehmen – war der Start in das Aktienjahr 2010 für die SÜSS-Aktie nicht einfach. Nach den deutlichen Kursgewinnen 2009 führte die Aktie in der ersten Jahreshälfte 2010 eine sehr ausgeprägte Seitwärtsbewegung im Gleichklang mit dem TecDAX aus. Beginnend mit der zweiten Jahreshälfte hat die Aktienkursentwicklung dann allerdings stark an Dynamik gewonnen. Der Aktienkurs hat sich nach der Veröffentlichung unserer Halbjahreszahlen im August 2010 vom allgemeinen Markttrend losgelöst und sehr deutliche Gewinne verzeichnen können. Mit unserem Halbjahresbericht konnten wir ganz offensichtlich den Kapitalmarkt überzeugen, dass die von uns eingeleiteten Maßnahmen richtig waren und zur positiven Entwicklung unseres Unternehmens

beitragen haben. Das gestiegene Interesse an der SÜSS-Aktie hat sich auch in verstärkten Investor-Relations-Aktivitäten des Vorstands, wie z. B. Roadshows und Investorenkonferenzen, niedergeschlagen.

**MICHAEL KNOPP:** Insgesamt konnte die Aktie im abgelaufenen Gesamtjahr um 105 Prozent an Wert zulegen. Das vergangene Geschäftsjahr zählte damit auch im Hinblick auf den Aktienkurs zu einem der besten Jahre unserer Firmengeschichte. Dies ist sicherlich ein Anlass zur Freude, aber kein Grund für den Vorstand, die angestoßenen Maßnahmen zur Restrukturierung und zur strategischen Neuausrichtung mit weniger Nachdruck zu verfolgen. Wir werden den 2009 eingeschlagenen Weg der Neufokussierung des Unternehmens weiter beschreiten und konsequent die von uns gesetzten Ziele verfolgen.

**Möchten Sie zum Abschluss des Interviews noch etwas hinzufügen?**

**FRANK AVERDUNG:** Meine Damen und Herren, unser Unternehmen hat ein ausgezeichnetes Jahr hinter sich. Befreit von übermäßiger Komplexität und starren Strukturen gehen wir mit Entschlossenheit und großem Selbstvertrauen in das neue Geschäftsjahr. Wir sind überzeugt, dass wir das Unternehmen mit den eingeleiteten Maßnahmen erneut auf den Weg des soliden Wachstums und der nachhaltigen Wertsteigerung gebracht haben.

Garching, im März 2011



Frank Averdung  
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp  
Finanzvorstand



## BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat möchte Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im nachfolgenden Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 informieren. Im Mittelpunkt der Beratungen standen insbesondere die strategischen Investitions- und Desinvestitionsprojekte sowie der Umzug der Bonder-Aktivitäten von Waterbury, USA, nach Sternenfels.

### SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

im vergangenen Geschäftsjahr haben wir den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine Tätigkeit überwacht. Wir sind damit den vom Gesetz, der Satzung und der Geschäftsordnung verlangten Aufgaben nachgekommen. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens stimmte der Vorstand mit uns ab. Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig schriftlich und auch mündlich, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden uns im Einzelnen erläutert und von uns anhand der erhaltenen Unterlagen und Informationen überprüft. Bedeutende Geschäftsvorgänge haben wir auf Basis der Berichte des Vorstands ausführlich erörtert, und zu zustimmungspflichtigen Geschäften haben wir unsere Zustimmung erteilt. Im Geschäftsjahr 2010 fanden insgesamt acht ordentliche Sitzungen sowie drei außerordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt. An diesen Sitzungen haben stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen. Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in engem Kontakt und hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Es gab keine Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen waren und über die die Hauptversammlung zu informieren wäre.

### SITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Im Aufsichtsrat wurden regelmäßig die Geschäftsentwicklung der SÜSS MicroTec AG, ihrer Tochtergesellschaften und des Konzerns sowie die Finanzlage und die Investitions- bzw. Desinvestitionsprojekte erörtert. Der Vorstand unterrichtete regelmäßig und umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weichenstellung und die Entwicklung im Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis. Der Aufsichtsrat hat sich außerdem mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagement-Systems befasst.

In der Sitzung am 14. Januar 2010 hat der Aufsichtsrat sich vorrangig mit den strategischen Investitions- und Desinvestitionsprojekten befasst. Es wurde ein Aufsichtsratsbeschluss zum Verkauf des Bereichs Test Systeme gefasst, in dem der Vorstand ermächtigt wurde, alle weiteren Einzelheiten der Transaktion zu den vorliegenden Rahmenbedingungen festzulegen und zu entscheiden und den Verkaufsvertrag und verbundene Verträge zu verhandeln und abzuschließen. Darüber hinaus wurden der Status der Übernahme der HamaTech APE sowie weitere strategische Kooperationsprojekte besprochen.

Die zweite ordentliche Aufsichtsratssitzung fand am 10. Februar 2010 statt. Hierbei befassten wir uns insbesondere mit dem Bericht des Vorstands zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2009. Ferner beschäftigte sich der Aufsichtsrat in dieser Sitzung noch einmal mit dem am 27. Januar 2010 erfolgten Verkauf des Bereichs Test Systeme. Der vom Vorstand vorgelegten Planung für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach ausführlicher Erläuterung zugestimmt. Zudem wurden die langfristigen Ziele für die erfolgsabhängige Vergütung des Vorstands erörtert.



**DR. STEFAN REINECK**  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

An der Sitzung am 23. März 2010 hat unser Abschlussprüfer teilgenommen. Er informierte den Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2009. Wir diskutierten mit den Vertretern des Abschlussprüfers Fragen der Bilanzierung sowie die wesentlichen Sachverhalte des abgelaufenen Geschäftsjahres und deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns. Des Weiteren erläuterte uns der Abschlussprüfer die Schwerpunkte der Einzel- und Konzernabschlussprüfung. Den Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2009 und zur aktuellen Geschäftslage haben wir zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat billigte nach eingehender Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2009. Außerdem wurde Beschluss über den Bericht des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr gefasst. Weiterhin setzte der Aufsichtsrat die kurzfristigen Ziele und die langfristigen 3-Jahres-ziele für die Bonusvereinbarungen mit den Vorständen fest. Darüber hinaus haben wir mögliche Punkte der Tagesordnung für die Hauptversammlung am 23. Juni 2010 besprochen. Weiterhin beschäftigte sich der Aufsichtsrat eingehend mit zukünftigen Trends im Bereich Lithografie sowie mit der aktuellen Situation des Bereichs Bonder.

In der vierten ordentlichen Sitzung am 29. April 2010 hat sich der Aufsichtsrat mit den aktuellen Zahlen zum ersten Quartal 2010 und der Prognose für das Gesamtjahr befasst. Es wurden die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung am 23. Juni 2010 beschlossen. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat über die Zusammenarbeit mit der Firma Thin Materials und den Fortgang anderer strategischer Projekte. Des Weiteren wurde das Thema Kapitalerhöhung in dieser Sitzung diskutiert.

Im Anschluss an diese Sitzung hat der Aufsichtsrat seine Effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex durchgeführt und dokumentiert. Dabei konnten keine Defizite festgestellt werden.

Die Überprüfung der Effizienz der Aufsichtsrats-tätigkeit findet in regelmäßigen Abständen durch sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats einzeln und im Plenum mit Unterstützung von unternehmensspezifischen Frage- und Checklisten statt.

In den außerordentlichen Sitzungen am 10. Mai und am 11. Mai 2010 befasste sich der Aufsichtsrat intensiv mit dem Thema Kapitalerhöhung und fasste die zur Durchführung notwendigen Beschlüsse.

In der außerordentlichen Sitzung am 27. Mai 2010 hat uns der Vorstand über den geplanten Zeitplan des Umzugs des Bereichs Bonder informiert. Der Aufsichtsrat stimmte dem Antrag des Vorstands zu, die Bereiche Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Produktmanagement nach Sternenfels zu verlagern. Weiterhin wurde beschlossen, die nordamerikanische Service- und Vertriebsorganisation und das Applikationscenter von Waterbury, Vermont, nach Kalifornien zu verlegen. Der Aufsichtsrat beschäftigte sich zudem mit der im Rahmen des Erwerbs der Anteile an der HamaTech APE GmbH & Co.KG von der Singulus Technologies AG gegebenen Eigenkapitalgarantie. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat über die in diesem Zusammenhang von der SÜSS MicroTec AG gegenüber der Singulus Technologies AG geltend gemachten Ansprüche.

In der Sitzung am 23. Juni 2010, unmittelbar vor der ordentlichen Hauptversammlung, hat uns der Vorstand vornehmlich über die aktuelle Geschäftslage informiert. Wir haben außerdem vom Vorstand ein Update zum Umzug der Bonder-Aktivitäten erhalten.

Am 2. August 2010 fand die sechste ordentliche Aufsichtsratssitzung statt. In dieser Sitzung wurden die Zahlen zum zweiten Quartal sowie der aktuelle Gesamtjahresausblick erörtert. Der Vorstand erläuterte uns den aktuellen Stand der strategischen Projekte, insbesondere den Status des Bonder-Umzugs sowie diverser Kooperationen.

In der Sitzung des Aufsichtsrats vom 2. November 2010 berichtete der Vorstand über die aktuelle Geschäftslage im dritten Quartal sowie den Ausblick auf das Gesamtjahr. Darüber hinaus berichtete der Vorstand über den Status des Bonder-Umzugs. Der Aufsichtsrat diskutierte wesentliche Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Konzerns. Ferner wurden die Themen temporäres Bonden und der Umzug der nordamerikanischen Service- und Vertriebsorganisation sowie des Applikationscenters von Waterbury nach Kalifornien besprochen. Zudem haben wir in dieser Sitzung Beschluss über die Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gefasst.

Gegenstand der am 16. Dezember 2010 stattgefundenen letzten Sitzung des Geschäftsjahres 2010 waren die aktuelle Geschäftslage sowie die vorläufige Planung für das neue Geschäftsjahr. Es wurde der aktuelle Stand der strategischen Projekte, insbesondere des Umzugs der Bonder-Aktivitäten und der nordamerikanischen Service- und Vertriebsorganisation sowie des Applikationscenters, diskutiert. Der Vorstand stellte die kürzlich abgeschlossene Kooperation mit Rolith vor. Zur Debatte standen als weitere Themen die mögliche Aufnahme in den TecDAX und die neue Situation, die sich aus dem vollständigen Rückzug der Sterling Strategic Value Limited aus ihrem Investment bei der SÜSS MicroTec AG ergeben hat.

### CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2010 erneut mit den Inhalten und der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst. Informationen zur Corporate Governance im Unternehmen sowie der ausführliche Bericht zur Höhe und Struktur der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat sind im separaten Corporate Governance Bericht auf den Seiten 39 ff. des Geschäftsberichts wiedergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat haben in ihren Sitzungen am 2. November 2010 die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG beschlossen und diese den Aktionären auf der Website der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht. In seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 hat sich der Aufsichtsrat noch einmal sehr eingehend mit den neuesten Empfehlungen des Kodex zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats beschäftigt. Dabei hat der Aufsichtsrat auch festgestellt, dass ihm eine nach seiner Einschätzung ausreichende Anzahl unabhängiger Mitglieder angehört. Ebenso hat der Aufsichtsrat festgestellt, dass er durch Teilnahme einzelner AR-Mitglieder an geeigneten Seminaren und Diskussionsveranstaltungen sowie durch aktuelle Fachliteratur seine eigene Fortbildung angemessen betreibt. Eingehend diskutiert wurde zudem das Für und Wider von erfolgsabhängigen Vergütungen für den Aufsichtsrat.

### JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, hat den nach HGB-Grundsätzen aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2010 sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2010 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden gemäß § 315a HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) vorgenommen.

Die Prüfungsberichte der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 29. März 2011 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagements vorlägen. Insbesondere hat er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns abgegeben und uns für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung ein.



Der Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns sowie der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasste Lagebericht wurden von uns geprüft. Es bestanden keine Einwände. Die Berichte des Abschlussprüfers haben wir nach eingehender Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem gemeinsamen Lagebericht für die AG und den Konzern und insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des Unternehmens haben wir zugestimmt.

## VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT UND VORSTAND

Im Geschäftsjahr 2010 gab es weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat personelle Veränderungen.

Der Aufsichtsrat erkennt, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr wichtige strategische Weichenstellungen veranlasst und operativ eingeleitet wurden, die außerordentliche Belastungen für die Vorstände und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten. Für die erfolgreiche Umsetzung und für ihre engagierte Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr spricht der Aufsichtsrat den Vorständen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen Dank und Anerkennung aus.

Garching, 29. März 2011

Für den Aufsichtsrat:



Dr. Stefan Reineck  
Aufsichtsratsvorsitzender

# STRUKTUREN OPTIMIEREN

NEUER PRODUKTIONSSTANDORT IN STERNENFELS SCHAFFT FLEXIBILITÄT  
UND RAUM FÜR ZUKÜNFTIGES WACHSTUM



Im Zeitalter des rapiden technologischen Wandels ist es notwendig, schnell und flexibel auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren.

Damit die SÜSS MicroTec auch zukünftig in der Lage ist, den Markt- und Kundenbedürfnissen zeitnah und kompetent zu entsprechen, wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr wichtige strategische Weichenstellungen zur Fokussierung und Repositionierung des Geschäfts vorgenommen. Der im Rahmen der HamaTech APE-Übernahme erworbene Produktionsstandort in Sternenfels wird zukünftig die Entwicklung und die Fertigung von drei Produktlinien unter einem gemeinsamen Dach beherbergen. ▶



### FOKUS AUF KERNKOMPETENZEN

Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2010 stand ganz im Zeichen der Durchführung zweier strategischer Investitions- und Desinvestitionsprojekte.

### AKQUISITION DER HAMATECH APE

SÜSS MicroTec hat zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 die HamaTech APE von der Singulus Technologies AG übernommen. Diese Akquisition ist ein bedeutender Meilenstein in der Firmengeschichte von SÜSS MicroTec. Die Eingliederung in die SÜSS MicroTec-Gruppe hat die Marktpräsenz der HamaTech erhöht, die Servicestrukturen ergänzt und die Marktposition gestärkt. Die HamaTech APE ist Marktführer in der Herstellung von Reinigungs-Equipment und Prozesslösungen für Fotomasken, die für die Herstellung von integrierten Schaltkreisen eingesetzt werden. Diese Fotomasken können mehrere hunderttausend Euro kosten und sind extrem empfindlich. Daher ist der Einsatz der adäquaten Reinigungstechnologie für den Anwender äußerst

wichtig. Das Produktportfolio der HamaTech APE umfasst Reinigungsplattformen für jede Strukturgröße in der Halbleiterindustrie, gleichzeitig ist die HamaTech APE weltweit der einzige Anbieter von Lösungen zur EUV-Lithografie Maskenreinigung. Die Technologie der HamaTech APE weist ein hohes Synergiepotenzial mit der SÜSS MicroTec Coater/Developer-Produktlinie auf. Mit dem Erwerb wurde nicht nur das Produktportfolio im Bereich der Nassprozesse sinnvoll erweitert, sondern mit dem Kauf des modernen Produktionsgebäudes am HamaTech-Standort Sternenfels wurde gleichzeitig auch die Basis für den Ausbau eines konzernweiten Kompetenz-Centers für Nassprozesse geschaffen. Bisher fertigte SÜSS MicroTec die Coater in Vaihingen, einem Nachbarort von Sternenfels. Diese beiden Fertigungsstandorte Vaihingen und Sternenfels wurden noch im ersten Halbjahr 2010 in Sternenfels zusammengelegt. Darüber hinaus wurde 2010 mit dem Umzug der Bonder-Aktivitäten aus Waterbury, USA, nach Sternenfels begonnen.

01 // SÜSS MicroTec erweitert sein Produktportfolio um Geräte zur Maskenreinigung

02 // Konzentration auf Kernkompetenzen im Bereich Mikrostrukturierung





# STERNENFELS, EIN STANDORT MIT POTENZIAL

EIN KOMPETENZ-CENTER FÜR NASSPROZESSE ENTSTEHT



Das Grundstück am Standort Sternenfels hat eine Gesamtfläche von rund 34.000 m<sup>2</sup>. Auf dem Gelände befinden sich Gebäude mit einer Grundfläche von rund 15.000 m<sup>2</sup>.

Davon entfallen auf Produktions- und Lagerflächen rund 8.300 m<sup>2</sup>, auf Entwicklungs- und Applikationsräume etwa 500 m<sup>2</sup> und die Büroflächen nehmen eine Fläche von rund 3.000 m<sup>2</sup> ein. Der Standort wurde in drei Bauabschnitten zwischen 1991 und 1998 fertiggestellt und erfüllt somit die modernsten Anforderungen an Entwicklungs-, Produktions- und Verwaltungsgebäude. ▶



### SYNERGIEN NUTZEN

Das moderne Produktionsgebäude in Sternenfels ermöglicht es SÜSS MicroTec, vielfältige Synergien in den Bereichen Entwicklung, Beschaffung und Produktion zu nutzen. Am neuen Standort Sternenfels werden nach der kompletten Verlagerung der Produktlinie Bonder in den dann drei Produktlinien Photomask Equipment, Coater / Developer und Bonder mehr als 70 Prozent der Wertschöpfung in der SÜSS MicroTec-Gruppe erzeugt. Durch die räumliche Zusammenfassung kann zum Beispiel die Kapazitätsauslastung in der Montage deutlich optimiert werden, sodass Auftragsschwankungen in den Produktlinien besser ausgeglichen werden können.

Für die Fertigungslogistik bedeutet das moderne Produktionsgebäude in Sternenfels einen deutlichen Fortschritt. Die Fertigungs- und Lagerbereiche sind so angeordnet, dass das Material „fließen“ kann und die zur Verfügung stehenden Flächen optimal genutzt werden können. Hier profitiert SÜSS MicroTec von der bereits vorhandenen Reinraumumgebung und den

flexiblen Ver- und Entsorgungssystemen innerhalb der Fertigung.

Auch das Working Capital profitiert von der Zusammenfassung durch niedrigere Lagerbestände und höhere Umschlagraten. Dies gilt insbesondere für Kaufteile wie etwa Motoren, Sensoren, Ventile usw., die in allen Produktlinien eingebaut werden und somit eine bessere Ausgestaltung der logistischen Kette ermöglichen. Durch das gebündelte Beschaffungsvolumen realisiert SÜSS MicroTec unmittelbar wirksame Vorteile bei den Einkaufspreisen und in der Versorgungssicherheit.

Hohes Synergiepotenzial liegt auch im Engineering-Bereich. In den beiden Produktlinien Photomask Equipment und Coater / Developer werden grundsätzlich ähnliche Technologieschritte eingesetzt wie Cleaning, Bake und Develop unter Einsatz von Nasschemie. Diese gemeinsame Kompetenz im Bereich „Wet Processing“ führt SÜSS MicroTec am Standort Sternenfels nun zusammen.

01 // Die Fertigungs- und Lagerbereiche sind so angeordnet, dass das Material optimal „fließen“ kann

02 // Die großzügig angelegten Reinräume bieten Platz für weiteres Wachstum





Über alle Produktlinien lässt sich mit der Zusammenlegung neues Potenzial im Bereich der Software-Steuerung für unsere Maschinen adressieren: ein gemeinsames, integriertes Steuerungskonzept auf dem neuesten Stand der Technik.

Für Engineering und Kunden gleichermaßen bedeutsam ist die Verfügbarkeit von speziellen Reinräumen, in denen die Prozesse auf unseren Anlagen demonstriert und weiterentwickelt sowie Maschinen vor ihrer Auslieferung abgenommen werden können. Die Reinräume können saubere Luft bis zu einer Klasse 100 bereitstellen und erfüllen damit die üblichen Anforderungen für viele Prozesse im Markt. Durch die enge räumliche Verzahnung von Engineering, Applikation



und Montage sind wir in der Lage, Neuentwicklungen zeitnah zur Marktreife zu bringen.

### RAUM SCHAFFEN FÜR WACHSTUM

Das großzügig gestaltete Produktionsgebäude erlaubt Potenzial für weiteres Wachstum. SÜSS MicroTec ist bestens vorbereitet für den erwarteten Anstieg der Produktion von Bondern in den kommenden Jahren, und auch neue Produktlinien können durch intensivere Nutzung der vorhandenen Flächen integriert werden. Bei Bedarf ist auch eine Erweiterung der Gebäudefläche auf dem Grundstück möglich.

Nicht zuletzt stärkt der neue Standort Sternenfels auch die Wahrnehmung von SÜSS MicroTec als attraktivem Unternehmen, insbesondere in der wirtschaftlich prosperierenden und landschaftlich attraktiven Region zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Mit mittlerweile über 200 Mitarbeitern wird die Bekanntheit von SÜSS MicroTec als Arbeitgeber im Hochtechnologie-Umfeld spürbar steigen, was im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter in Zukunft ständig an Bedeutung gewinnen wird.

### Global Footprint

Nach der Restrukturierung umfasst die weltweite Präsenz die beiden deutschen Standorte in Garching und Sternenfels, ergänzt um ein Netz aus Vertriebs- und Servicenerlassungen mit Schwerpunkt in Asien. Dank dieser hervorragenden Infrastruktur ist SÜSS MicroTec in der Lage, den Kunden weltweit Service und Support rund um die Uhr anzubieten, eine Voraussetzung für den erfolgreichen Produktionseinsatz der Systeme. Um das Serviceangebot zukünftig noch kundennäher zu gestalten, wurde ein Applikationslabor in Sunnyvale, im Herzen des Silicon Valley, eingerichtet, darüber hinaus wurden die Vertriebs- und Servicestandorte in Taiwan und China ausgebaut.

# FOKUS AUF WACHSTUMS- MÄRKTE

ZUNEHMENDE TECHNISIERUNG UND FUNKTIONALITÄTS-  
ZUWACHS TREIBEN DAS GESCHÄFT



Gegenwärtig gibt es in der industrialisierten Welt keinen Bereich mehr, der ohne elektrische und elektronische Geräte auskommt. Moderne Fortbewegungsmittel, Haushaltsgeräte, Fernseher und Spielkonsolen sowie auch Mobiltelefone und Navigationsgeräte stecken voller Technologie. Insbesondere der Anteil von Steuerungselementen und Sensoren hat in diesem Zusammenhang drastisch zugenommen. Viele dieser Funktionen werden durch Halbleiterbauelemente wie zum Beispiel MEMS oder Mikrochips gesteuert.

Darüber hinaus nimmt die Funktionalität der einzelnen elektronischen Endgeräte stetig zu, ohne dass sie wesentlich größer werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die verbauten Komponenten immer kleiner und leistungsfähiger werden müssen. Die Maschinen aus dem Hause SÜSS MicroTec sind hochkomplexe Geräte, die bei der Herstellung dieser Komponenten zum Einsatz kommen. Das Unternehmen bedient mit seinen Maschinen und Prozesslösungen wachstumsstarke und zukunftssträchtige Märkte, wie das Advanced Packaging, die 3D-Integration sowie die Märkte für MEMS und LEDs. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht über die Produkte und Prozesslösungen von SÜSS MicroTec und die damit bedienten Märkte. ▶



### ADVANCED PACKAGING

ist eine alternative Verpackungstechnologie zum klassischen Wire Bonding, mit dem heute noch ein großer Teil der Mikrochips verdrahtet wird. Beim Advanced Packaging dagegen werden alle Schritte der Mikrochipverpackung noch vor dem Vereinzeln der Chips durchgeführt. Die Mikrochips können durch das sogenannte Micro Bumping anschließend direkt auf das Substrat aufgesetzt werden. Dadurch lassen sich geringere elektrische und thermische Widerstände realisieren, die wiederum höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig geringerem Platzbedarf ermöglichen. Für den Endverbraucher bedeutet dies mehr Funktion auf kleinerem Raum. Dabei adressiert das auf die fotolithographische Mikrostrukturierung zugeschnittene Produktportfolio aus Belacker- und Entwickleranlagen sowie Mask Alignern von SÜSS MicroTec alle wesentlichen Prozessschritte des Advanced Packaging. Mit den Coatern werden Fotolacke mittels Spin- oder

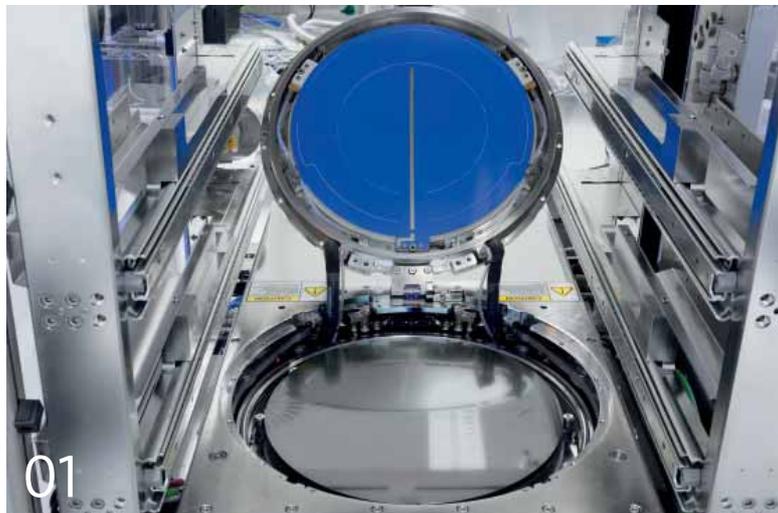
Spraycoatingverfahren auf den Wafer aufgebracht und ausgehärtet. Im Anschluss wird die gewünschte Struktur im Mask Aligner in den Fotolack belichtet und somit übertragen. Den Abschluss der Strukturübertragung bildet das Herauentwickeln der belichteten oder unbelichteten Bereiche des Fotolackes auf den Entwicklern. Die so auf den Fotolack übertragene Struktur bildet die Basis für die weiteren Abscheide- und Ätzverfahren zur Herstellung der Leiterbahnen und Kontakte. Auf dem Gebiet des 3D-Packaging setzt sich das Micro Bumping im Advanced Packaging mehr und mehr als der Standard für elektrische Verbindungen durch.

### 3D-INTEGRATION – „MORE THAN MOORE“

Das Stapeln von Chips in die dritte Dimension – die 3D-Integration – erlaubt die Herstellung von leistungsfähigeren Produkten auf der Grundlage bekannter Technologien. Bildsensoren und Speicherchips waren die ersten beiden Anwendungsbereiche, bei denen

01 // Blick in das Modul LF300,  
einem Low Force Bonder für  
das temporäre Bonden

02 // Belackungsmodul  
eines Spray Coaters



3D-Technologien in der Fertigung eingesetzt wurden. Künftig sollen bei der 3D-Integration Bauelemente verschiedenster Größe, Funktion und Herstellungstechnologie in das gleiche Paket integriert werden. So kann beispielsweise in einem Handy oder einer Spielkonsole ein Bewegungssensor mit einem Speicherchip auf kleinstem Raum kombiniert werden. Um möglichst wenig Platz in der dritten Dimension zu verbrauchen, müssen die einzelnen Bauelemente vor dem Stapeln auf eine möglichst geringe Dicke gebracht werden, sie müssen gedünnt werden. Nach dem Dünnen der Wafer können die elektrischen Durchkontakte (Trough Silicon Vias) hergestellt und unter Einsatz der vorher beschriebenen Advanced-Packaging-Technologien können die Anschlusskontakte gefertigt werden.

Um solch dünne Wafer mechanisch überhaupt bearbeiten zu können, ist es notwendig, sie vor dem Dünnen auf einen stabilen Träger aufzukleben. SÜSS MicroTec stellt in seinem Produktportfolio komplette Anlagenlösungen für das Aufbringen und Wiederablösen dieser Trägerwafer zur Verfügung. Neben dem Aufbringen des ursprünglich dicken Wafers auf den Träger im Temporary Bonder und dem Wiederablösen des fertig bearbeiteten und gedünnten Wafers, werden die Wafer im Debonder von Kleberresten gereinigt, um sie dann vereinzeln und stapeln zu können. Für die eigentliche 3D-Integration, das Stapeln der Chips, werden die metallischen Anschlusspunkte auf den Wafern unter hohem Druck und hoher Temperatur permanent miteinander verbunden. Dies geschieht in einem Wafer Bonder.



#### VERBINDUNGSHALBLEITER – LED

Ein weiterer Markt für SÜSS MicroTec ist die Beleuchtungsindustrie einschließlich LEDs (Light Emitting Diodes). Mit der Steigerung der Leuchtstärke auf 60 bis 120 Lumen haben zum Beispiel High Brightness LEDs neue Anwendungen erschlossen und verdrängen konventionelle Lichtquellen von ihrem angestammten Platz. Zu typischen Prozessschritten, die auf SÜSS MicroTec-Anlagen durchgeführt werden, zählen unter anderem lithografische Strukturierungen von Kontaktflächen, Elektroden und Ätzmasken. Substrat Bonder werden zur Integration von Spiegelflächen und auch zum Zusammenfügen von unterschiedlichen Epitaxielagen verwendet. Zudem werden SÜSS-Technologien und -Produkte eingesetzt, um die Leuchtstärke und Homogenität der Leuchtdioden weiter zu steigern. Dies beinhaltet beispielsweise modernste Nano-Imprint-Verfahren als auch Lithografie-Prozesse zur Mikrostrukturierung von Saphir-Substraten.

Derzeitig wichtige Segmente sind die dekorative Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Hintergrundbeleuchtung für Tastaturen und Bildschirme, Blitzlicht für Kameras, Video-Großleinwände und Werbetafeln, automobiler Rückleuchten und Blinker. Darüber hinaus gibt es interessante Neuanwendungen in der allgemeinen Beleuchtung oder der Hintergrundbeleuchtung von LCD-Displays in Camcordern, Laptops, Computer-Monitoren und TV-LCD. Auch die Bereiche optische Kommunikation, Fotovoltaik und Leistungshalbleiter, sind für SÜSS MicroTec ein weiterer Bereich mit interessantem Wachstumspotenzial.

### MEMS

sind Mikro Elektro Mechanische Systeme. Sie werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik, der Konsumelektronik und auch der Medizintechnik eingesetzt. Dieser Markt bietet attraktive Wachstumsmöglichkeiten. Findet man heute in einem modernen Mobiltelefon bereits rund neun MEMS-Bausteine, so soll sich dieser Anteil laut Expertenschätzungen in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln.



Bei der Herstellung von MEMS werden Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung eingesetzt, um kleinste mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. Bei der Herstellung von MEMS-Bauteilen werden SÜSS-Produkte aus mehreren Produktlinien eingesetzt. Die Lithografie wird auch hier unter anderem zur Strukturierung von Ätzmasken und zur Strukturierung von elektrischen Kontakten als auch zur Herstellung der mechanischen 3D-Strukturen, wie zum Beispiel Mikrozahnrädern, verwendet. Hierbei spielen die SÜSS-Produkte eine wesentliche Rolle. Durch das Aufspleuern des Fotolacks in einem SÜSS Spin Coater, wo zunächst ein Tropfen Photolack auf die Mitte des Wafers, welches durch Vakuumansaugung auf einem Drehteller gehalten wird, aufgebracht wird. Durch Zentrifugieren wird der flüssige Fotolack in dünner Schicht auf dem Wafer gleichmäßig verteilt. Anschließend erfolgt die Belichtung des Wafers mit Hilfe einer Maskenprojektion in einem SÜSS Mask Aligner. Beim Entwickeln befindet sich der Wafer erneut auf einem Drehteller und wird bei langsamer Umdrehung stetig in einem SÜSS Developer mit Entwicklerlösung besprüht. Nach dem vollständigen Entwickeln des Lackes wird der Wafer mit aufgespritztem Wasser gespült, um den Entwicklungsprozess zu stoppen. Durch das Entwickeln lösen sich, entsprechend der Lackart, bestimmte Bereiche des Lackes, sodass am Ende eine strukturierte Scheibe bestehen bleibt. Darüber hinaus werden SÜSS Wafer Bonder beispielsweise zum hermetischen Kapseln von MEMS-Bauelementen eingesetzt.

Der SB6 / 8 Bonder eignet sich besonders gut für die Bereiche MEMS, SOJ und Wafer Level Packaging



## INVESTOR RELATIONS

SÜSS MicroTec hat in den letzten beiden Geschäftsjahren wichtige Weichenstellungen vorgenommen, um das Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten und den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Dies ist uns insbesondere im Geschäftsjahr 2010 hervorragend gelungen und spiegelte sich auch in der Kursentwicklung wider. Die SÜSS-Aktie gehörte im Jahr 2010 mit einem Kursanstieg von mehr als 100 Prozent sicherlich zu den Topwerten am deutschen Kapitalmarkt.

### DEUTLICHE KURSGEWINNE ZUM JAHRESENDE

Die allgemeine Erholung an den Finanz- und Kapitalmärkten, die 2009 bereits begonnen hatte, setzte sich auch im vergangenen Geschäftsjahr weiter fort und hat sich im Jahresverlauf deutlich verstärkt. So lag der DAX, der mit 5.957 Punkten das Jahr 2009 beendet hatte, am Jahresende 2010 bei 6.914 Punkten. Dies entspricht einem Anstieg von 16 Prozent. Auch der MDAX und der SDAX konnten auf Jahressicht deutlich, um 35 Prozent bzw. 46 Prozent, zulegen. Lediglich der TecDAX hat sich im gleichen Betrachtungszeitraum kaum verändert und schloss bei 851 Punkten, was ein leichtes Plus von 4 Prozent gegenüber dem Jahresanfang bedeutet.

Im Vergleich zu unserem Referenzindex – dem TecDAX – hat sich die SÜSS MicroTec-Aktie deutlich positiver entwickelt. Nachdem der Aktienkurs im Laufe des Vorjahres bereits deutlich zugelegt hatte, schloss er das Geschäftsjahr 2009 bei 4,45 Euro. Bis in den August 2010 hinein hat unsere Aktie im Gleichklang mit dem TecDAX lediglich eine Seitwärtsbewegung vollzogen. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat die SÜSS-Aktie sich dann von der Entwicklung des TecDAX abgekoppelt und deutliche Kursgewinne verzeichnen können. Auch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen an allen deutschen Börsenplätzen hat seit diesem Zeitpunkt deutlich angezogen und lag zuletzt für den Monat Dezember bei 199.287 Stück (Xetra und Frankfurt Parkett). Über das Gesamtjahr gesehen lag der durchschnittliche tägliche Börsenumsatz bei 117.654 Stück. Im Vergleich dazu lag das Handelsvolumen in 2009 nur bei 46.414 Stück. Insgesamt lässt sich sowohl bei Investoren als auch bei Analysten ein gesteigertes Interesse an der SÜSS-Aktie feststellen.

Die SÜSS-Aktie profitierte 2010 nicht nur von der allgemein erfreulichen Entwicklung an den Aktienmärkten und der guten Entwicklung in den von uns bedienten Märkten, sondern auch von der strukturellen Verbesserung des operativen Geschäfts. Darüber hinaus wurden strategisch wichtige Weichen für die weitere Steigerung des Unternehmenswertes gestellt. Dazu gehören zum Beispiel die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen sowie die erfolgreich durchgeführte Desinvestition des verlustträchtigen Test-Bereichs und die Akquisition der HamaTech APE. Die SÜSS MicroTec AG hat ihr Produktportfolio bereinigt, aber auch in strategisch bedeutsamen Kernbereichen erweitert, um auch zukünftig den Anforderungen des sich rasant entwickelnden Marktumfeldes gerecht zu werden und zeitnah auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können.

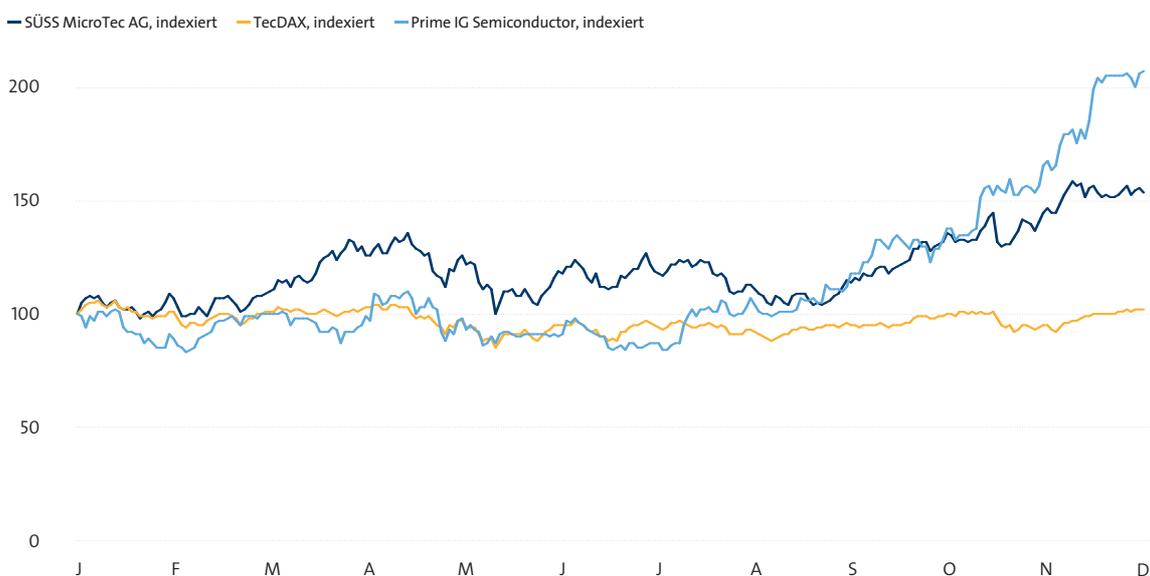
Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen in unserem Marktumfeld hat sich die Aktie gut entwickelt. Der Branchenindex IG Prime Semiconductor zeigte bereits in der ersten Jahreshälfte 2010 eine vergleichsweise gute Entwicklung und hat sich in der zweiten Jahreshälfte weiter gesteigert. Nach der Seitwärtsbewegung, die die SÜSS-Aktie im ersten Halbjahr vollzogen hat, hat sich die Aktie jedoch im Verlauf der zweiten Jahreshälfte deutlich dynamischer als dieser Vergleichsindex entwickelt. Ende Dezember 2010 schloss die SÜSS MicroTec-Aktie bei 9,14 Euro und verzeichnete damit ein Plus von 105 Prozent gegenüber Jahresende 2009. Der Vergleichsindex IG Prime Semiconductor schloss in demselben Zeitraum mit einem Plus von 62 Prozent gegenüber Jahresanfang ab.

Einen Überblick über den Kursverlauf im Jahr 2010 bietet die folgende grafische Darstellung.



DIE KURSENTWICKLUNG DER SÜSS MICROTEC-AKTIE 2010

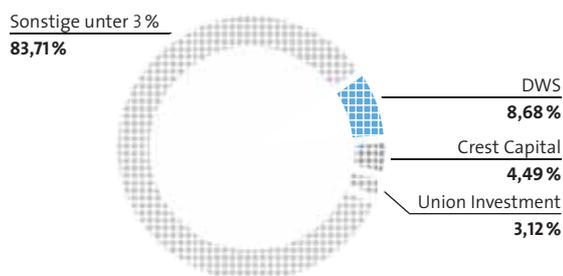
(Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 4. Januar 2010: 4,40 €)



VERGLEICH DER KURSENTWICKLUNG VON  
 SÜSS, TECDAX UND PRIME IG SEMICONDUCTOR  
 IM GESCHÄFTSJAHR 2010

	30.12.2009	30.12.2010	Veränderungen
TecDAX	817,58	850,67	4%
Prime IG Semiconductor	97,26	157,20	62%
SÜSS MicroTec	4,45	9,14	105%

AKTIONÄRSSTRUKTUR ZUM 31. DEZEMBER 2010 in %



## DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE IM ÜBERBLICK

Wertpapierkennnummer	722670
ISIN-Nummer	DE0007226706
Reuters-Kürzel	SMHG.F
Bloomberg-Kürzel	SMH GR
Börsensegment	Prime Standard
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31. Dezember 2010)	18.721.038
Wertpapiergattung	Nennwertlose Stückaktien
Designated Sponsor	equinet Bank AG Close Brothers Seydler Bank AG (seit November 2010)
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Jahresanfangs- / -schlusskurs in €	4,40 € / 9,14 €
Jahreshoch- / tief in €*	3,71 € / 9,14 €
Prozentuale Jahresentwicklung	+105 %
Kapitalmaßnahmen 2010	Plazierung von 1.701.912 Aktien
*XETRA Schlusskurs	

## INVESTOR-RELATIONS-AKTIVITÄTEN ERHÖHT

Eine wesentliche Aufgabe der Investor Relations ist die Pflege der bestehenden Kontakte zu Aktionären und Investoren. Darüber hinaus ist es eine Aufgabe, neue Investoren zu gewinnen und dem Kapitalmarkt die Perspektive des Unternehmens zu vermitteln. Bei dieser Aufgabe sieht sich insbesondere der Vorstand der SÜSS MicroTec in der Pflicht. So absolvierten Vorstand und Investor Relations insgesamt fünf Kapitalmarktkonferenzen und acht Roadshows im vergangenen Geschäftsjahr. Die Kapitalmarktkonferenzen fanden in Frankfurt, Hamburg, Zürich und New York statt. Während der Roadshows fanden Investorentreffen in Zürich, London, Amsterdam, Kopenhagen, Oslo und Frankfurt sowie Hamburg statt. Besonders in der zweiten Jahreshälfte hat die Nachfrage nach internationalen Roadshows deutlich an Dynamik gewonnen. Zusätzlich dazu wurde in vielen Einzelgesprächen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten genutzt. Anlässlich der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen sowie zu außerordentlichen Entwicklungen fanden auch im abgelaufenen Geschäftsjahr Telefonkonferenzen für Investoren und Analysten statt. Unser Ziel ist es, bei Analysten und Investoren durch vertiefende

Einblicke in das konzernweite Produktportfolio und dessen Anwendungsbereiche das Verständnis für unsere Geschäftsaktivitäten weiter zu steigern.

## ANALYSTEN RESEARCH

Mit der DZ Bank AG, der SES Research GmbH, der equinet Bank AG und der GBC AG Investment Research haben vier Researchhäuser ihre Berichterstattung des Vorjahres fortgesetzt. Zum Ende des Geschäftsjahres konnte Close Brothers Seydler als zweiter Designated Sponsor gewonnen werden. Close Brothers hat im Januar 2011 die Coverage der SÜSS-Aktie aufgenommen. Auch wenn sich die Anzahl an Analysten Research im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erhöht hat, so ist die Nachfrage nach Informationen zu SÜSS – auch von Analystenseite – besonders zum Jahresende deutlich angestiegen. Im Dezember hatten alle Analysten eine Kaufempfehlung für die SÜSS MicroTec-Aktie ausgesprochen.

Eine Übersicht über aktuelle Researchstudien zur SÜSS MicroTec-Aktie finden Sie im Internet unter [www.suss.com/investor\\_relations](http://www.suss.com/investor_relations)

## AUSGEZEICHNETER GESCHÄFTSBERICHT

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der Geschäftsbericht der SÜSS MicroTec AG bereits zum 6. Mal von der LACP (League of American Communications Professionals) ausgezeichnet. In der Wettbewerbskategorie „Technology – Semiconductors & Equipment“ erhielt der Geschäftsbericht 2009 den „Gold“-Award und lag damit an zweiter Stelle aller eingereichten Finanzberichte in seiner Branche.

## ERFOLGREICHE KAPITALERHÖHUNG

Am 11. Mai 2010 hat SÜSS eine Aktienplatzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und internationalen Investoren erfolgreich durchgeführt. Platziert wurden Stück 1.701.912 Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 zum Preis von 4,00 Euro je Aktie. Der Bruttomittelzufluss für die Gesellschaft betrug 6.807.648 Euro. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung wurden überwiegend für die Refinanzierung der HamaTech-Akquisition verwendet und sollen darüber hinaus zur Finanzierung des weiteren Wachstums dienen.

Das Grundkapital der Gesellschaft erhöhte sich von 17.019.126,00 Euro, eingeteilt in 17.019.126 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 Euro, um einen Betrag von 1.701.912,00 Euro auf 18.721.038,00 Euro.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde aufgrund der Ermächtigung in § 5 Abs. 2 der Satzung ausgeschlossen. Die Frankfurter Investmentbank equinet fungierte bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

## HAUPTVERSAMMLUNG

Die ordentliche Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG fand im Berichtsjahr am 23. Juni 2010 im Haus der Bayerischen Wirtschaft statt. Rund 80 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste waren der Einladung nach München gefolgt, um sich über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens persönlich zu informieren. Damit waren knapp 33 Prozent des Grundkapitals vertreten. Der Vorstand erläuterte in seinem Rechenschaftsbericht ausführlich die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres sowie des ersten Quartals 2010. Im Vordergrund standen dabei die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen sowie die Berichterstattung über die Akquisition der HamaTech APE und die Desinvestition des Test-Bereichs. Darüber hinaus wurde von der erfolgreichen Kapitalerhöhung berichtet.

Alle zur Abstimmung gestellten Beschlüsse wurden angenommen. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 und der Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers stand die Satzungsanpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) auf der Tagesordnung. Alle Vorlagen wurden mit mindestens 99 Prozent der bei der Hauptversammlung vertretenen Stimmen befürwortet. Die Abstimmungsergebnisse wurden direkt im Anschluss an die Hauptversammlung im Internet publik gemacht.

## CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Bei SÜSS MicroTec orientieren wir uns am deutschen Corporate Governance Kodex, der sich als Maßstab guter Unternehmensführung in Deutschland bewährt hat. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem nachfolgenden Bericht.

### CORPORATE GOVERNANCE-BERICHT

Vorstand und Aufsichtsrat sehen es als ihre Verpflichtung an, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung nicht nur für den Fortbestand des Unternehmens, sondern auch für eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu sorgen. Eine gute und transparente Corporate Governance ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des gesamten Unternehmens. SÜSS MicroTec strebt in seinem unternehmerischen Handeln danach, das Vertrauen, das uns Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, zu bestätigen und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend weiterzuentwickeln. Umfangreiche Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website.

### ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Die SÜSS MicroTec AG wird den Empfehlungen des „Deutsche Corporate-Governance-Kodex“ in der Fassung vom 26. Mai 2010 mit den folgenden fünf Ausnahmen entsprechen und hat den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 mit den vier Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – im Zeitraum vom 3. November 2009 bis zum 2. November 2010 entsprochen.

#### ■ Einladung zur Hauptversammlung

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 2.3.2 allen in- und ausländischen Finanzdienstleistern, Aktionären und Aktionärsvereinigungen die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege zu übermitteln, sofern die Zustimmungserfordernisse erfüllt sind. SÜSS MicroTec übermittelt die Einberufung nebst Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege nur den Aktionären, Aktionärsvereinigungen und Finanzdienstleistern, die dies verlangen. Eine automatische elektronische Übermittlung an alle in Ziffer 2.3.2 Genannten kann nicht erfolgen, da die SÜSS MicroTec AG Inhaberaktien ausgegeben hat und ihr die Aktionäre und deren Adressen nicht bekannt sind.

#### ■ Briefwahl

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 2.3.3 Satz 2, dass die Gesellschaft die Aktionäre bei der Briefwahl unterstützen soll. Die durch das ARUG eröffnete Möglichkeit der Briefwahl ist noch mit zahlreichen rechtlichen und praktischen Problemen behaftet. Vor diesem Hintergrund und in Ansehung des mit der Briefwahl verbundenen administrativen Aufwands sowie der Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auf elektronischem Weg zu bevollmächtigen, verzichtet SÜSS MicroTec einstweilen auf die Anwendung dieser Empfehlung.

#### ■ Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 bei Abschluss einer Directors' and Officers' Liability Insurance (Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) einen der gesetzlichen Regelung für Vorstände entsprechenden Selbstbehalt für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt für den Aufsichtsrat. Das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert.

#### ■ Bildung von Ausschüssen

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3 in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Aufsichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen. Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec nur aus drei Aufsichtsratsmitgliedern besteht, ist die Bildung von Ausschüssen, die im Regelfall aus mindestens drei Mitgliedern bestehen müssen, nicht möglich und im Übrigen auch nicht erforderlich, da im Plenum eine intensive und qualifizierte Diskussion stattfinden kann.

#### ■ Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern

In Ziffer 5.4.6 Absatz 2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 13 der Satzung festgelegt. Die Satzung der SÜSS MicroTec AG sieht aktuell keine erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats vor. Nach Ansicht der Gesellschaft wird das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats durch Vereinbarung einer erfolgsorientierten Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich gefördert.

Der Wortlaut der aktuellen Entsprechenserklärung sowie alle vorhergehenden Erklärungen zum Kodex sind auf der Website des Unternehmens unter [www.suss.com/investor\\_relations](http://www.suss.com/investor_relations) veröffentlicht.

Des Weiteren erfüllt die SÜSS MicroTec AG freiwillig auch die nicht obligatorischen Anregungen des Kodex mit den folgenden Einschränkungen:

- Abweichend von Ziffer 2.3.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex ist der Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung nicht erreichbar, da sich dies mit vertretbarem finanziellen Aufwand nicht mit der rechtlich erforderlichen Sicherheit gewährleisten lässt.

- In Ziffer 2.3.4 regt der Kodex an, den Aktionären der Gesellschaft die Verfolgung der Hauptversammlung über moderne Kommunikationsmedien (z. B. Internet) zu ermöglichen. Im Hinblick auf die zusätzlichen Kosten, die durch die Nutzung dieser Technologie entstehen können, wird derzeit von der Umsetzung dieser Anregung abgesehen.

- Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG nicht mitbestimmt ist, findet abweichend von Ziffer 3.6 Abs. 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex keine getrennte Vorbereitung der Aufsichtsratsitzungen statt.

- Außerdem werden die sich auf Ausschüsse des Aufsichtsrats und die erfolgsabhängige Vergütung des Aufsichtsrats beziehenden Anregungen des Kodex nicht befolgt, da den diesbezüglichen Empfehlungen nicht entsprochen wird.

## HAUPTVERSAMMLUNG

Die Hauptversammlung ist das zentrale Forum, auf dem sich Aktionäre mit ihren Fragen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf direkt an Vorstand und Aufsichtsrat wenden können. SÜSS bereitet die jährliche Hauptversammlung mit dem Ziel vor, den Aktionären vor, während und nach der Versammlung alle für sie relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Hauptversammlung beschließt darüber hinaus unter anderem über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Gewinnverwendung.

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den anstehenden Tagesordnungspunkten sowie die Erläuterung der Teilnahmebedingungen werden in der Regel fünf bis sechs Wochen vor dem Hauptversammlungstermin bekannt gemacht. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung und können ebenfalls in Kopie bei der IR-Abteilung angefordert werden. Zudem ist SÜSS MicroTech bemüht, den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern. Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selbst ausüben oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Die Weisungen zur Stimmrechtsausübung können vor oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden. Die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung veröffentlichen wir direkt im Anschluss an die Veranstaltung im Internet.

## KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ

SÜSS unterrichtet seine Aktionäre viermal im Jahr über die Geschäftsentwicklung sowie über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Um größtmögliche Transparenz und gleiche Chancen für alle zu gewährleisten, folgt die Unternehmenskommunikation bei SÜSS MicroTec dem Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu informieren. Dazu nutzt das Unternehmen verschiedene Medien. Neben Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten sowie Telefongesprächen, Konferenzen und Roadshows nutzen wir insbesondere die Website des Unternehmens, um Aktionäre, institutionelle Investoren, Analysten und sonstige Interessierte über Entwicklungen im Konzern zu informieren. So können unter [www.suss.com/investor\\_relations](http://www.suss.com/investor_relations) neben allen Pflichtpublikationen, die dort in deutscher und englischer Sprache zum Download bereitgestellt sind, Präsentationen wesentlicher Veranstaltungen sowie Vorstandsinterviews im Video- oder Audioformat frei eingesehen bzw. abgerufen werden. Über die wiederkehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung oder die Veröffentlichungszeitpunkte der Zwischenberichte unterrichten wir unsere Aktionäre, Analysten und Medien sowie die interessierte Öffentlichkeit zeitnah und regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist.

## ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

SÜSS MicroTec unterliegt als deutsche Aktiengesellschaft („AG“) dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Vorstand und Aufsichtsrat verfolgen eine zielgerichtete und effiziente Zusammenarbeit, die – unter Einhaltung der Interessen unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre – der nachhaltigen Wertsteigerung dient. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Ihnen obliegt die Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, sie stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren verantwortungsvolle Umsetzung.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. Wesentliche Vorstandsentscheidungen – zum Beispiel Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an seine Zustimmung gebunden. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt. Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet, daher ist über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse nicht zu berichten.

Die Unternehmensführung der SÜSS MicroTec AG ist durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt. Beide Organe arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, eng zusammen.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen werden dabei erläutert, diskutiert und begründet.

Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex vorsieht, gehört dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG mit Herrn Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied an, womit eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands gewährleistet ist. Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden auch im Berichtsjahr 2010 nicht. Interessenskonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen sind, traten im Geschäftsjahr 2010 nicht auf.

### ZIELE DES AUFSICHTSRATS HINSICHTLICH SEINER ZUSAMMENSETZUNG

Ziel der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG ist es, die Unternehmensentwicklung zu nachhaltiger Ertragskraft und permanenter Anpassung an sich schnell wandelnde Anforderungen durch konstruktive Beratung und Überwachung des Vorstands auf der Basis relevanter Kompetenzen abzusichern. Durch eine ausreichende Kompetenzvielfalt der Mitglieder sollen ein breites Erfahrungsspektrum und unterschiedliche Sichtweisen zum Nutzen des Unternehmens eingebracht werden.

Die SÜSS MicroTec AG ist ein auf den Weltmarkt ausgerichtetes, technologieorientiertes Unternehmen, das sich in einem sehr dynamischen und technologisch anspruchsvollen Umfeld behaupten und entwickeln muss. Daher sind im Aufsichtsrat technologisches Beurteilungsvermögen und einschlägige Marktkenntnisse im internationalen Maßstab erforderlich.

Folglich ist es das Ziel des Aufsichtsrats, neben dem Financial Expert erfahrene Persönlichkeiten zu gewinnen, die diese Bereiche abdecken. Für die technologische Expertise sind relevante Kenntnisse der Halbleiter- und halbleiternahen Industrie und deren Equipment-Industrie von besonderer Bedeutung. Um Trends und Entwicklungen in unseren sehr dynamischen Märkten vorausschauend und zuverlässig beurteilen zu können, sollten im Aufsichtsrat internationale Erfahrung und möglichst aktive Verbindungen vertreten sein.

Zusätzlich zu diesen genannten wichtigen Kompetenzen erwartet das Unternehmen von erfolgreichen Aufsichtsratsmitgliedern und -kandidaten eine breite Erfahrung in anderen Bereichen, die möglichst ergänzend zu einer optimalen Besetzung des Aufsichtsrats beitragen. Dazu gehören Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich strategischer Unternehmensentwicklung inkl. Mergers & Acquisitions, des Kapitalmarktes und der Kapitalmarktkommunikation, der Rekrutierung von Führungskräften und moderner Vergütungsmodelle für alle Ebenen sowie eine erhöhte Sensibilität für ökonomisch-ökologische Grundsatzfragen.

Abhängig von der aktuellen Unternehmenssituation kann es sinnvoll sein, die Gewichte der einzelnen Kriterien neu zu bewerten und der Hauptversammlung entsprechende Veränderungen im Aufsichtsrat vorzuschlagen. Dazu beobachtet der Aufsichtsrat die Unternehmenssituation, bewertet die Aufsichtsratsbesetzung einmal jährlich im Vorfeld der Hauptversammlung und gibt der Hauptversammlung eine Einschätzung zur kompetenten Besetzung des Aufsichtsrats.

Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollen zukünftig Frauen mit größerer Aufmerksamkeit berücksichtigt werden, um eine angemessene Frauenbeteiligung zu erreichen, ohne dass Aufsichtsrat und Vorstand die Festschreibung einer Quote derzeit für sinnvoll halten.

Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder liegt bei 71 Jahren.

Interessenkonflikte werden bei der Besetzung des Aufsichtsrats vermieden, indem die Kandidaten bereits im Vorfeld einer Wahl Negativerklärungen abgeben. Sollte es während einer Wahlperiode zu potentiellen oder tatsächlichen Konflikten kommen, dann führen entsprechende Regelungen zu deren Offenlegung und zu einer angemessenen Behandlung im Plenum des Aufsichtsrats.



## VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat es weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat Veränderungen gegeben.

## AKTIENGESCHÄFTE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach §15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 Euro erreicht oder übersteigt.

Der SÜSS MicroTec AG wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr folgende vorgenommene Geschäfte gemeldet:

Sämtliche Geschäfte wurden auch auf der Website des Unternehmens unter [www.suss.com](http://www.suss.com) > *Investor Relations* > *Corporate Governance* > *Directors Dealings* veröffentlicht.

### DIRECTOR'S DEALINGS 2010

Datum der Transaktion	Käufer / Verkäufer	Funktion / Status	Art und Ort der Transaktion	Anzahl in Stück	Kurs / Preis in €	Gesamtvolumen in €
24.08.2010	Frank Averdung	Vorstandsvorsitzender	Kauf über XETRA	9.258	4,45	41.198,10
23.08.2010	Frank Averdung	Vorstandsvorsitzender	Kauf über XETRA	1.386	4,45	6.167,70
16.08.2010	Frank Averdung	Vorstandsvorsitzender	Kauf über XETRA	4.356	4,40	19.166,40
12.08.2010	Michael Knopp	Finanzvorstand	Kauf über XETRA	7.500	4,448	33.360,95
06.08.2010	Michael Knopp	Finanzvorstand	Kauf über XETRA	7.500	4,499	33.745,99

## AKTIENOPTIONSPROGRAMME

Die SÜSS MicroTec AG sieht in der Aufstellung von Aktienoptionsplänen ein wichtiges Element in der Mitarbeiterbeteiligung an dem Erfolg des Unternehmens sowie die Möglichkeit, Führungskräfte langfristig an das Unternehmen zu binden. Die Gesellschaft verfügt derzeit über zwei Aktienoptionsprogramme. Die Optionen können an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von nachgeordneten verbundenen Unternehmen i.S. der §§ 15 ff. AktG sowie an Führungskräfte der SÜSS MicroTec AG und mit ihr verbundener nachgeordneter Unternehmen i.S. der §§ 15 ff. AktG ausgegeben werden.

### Aktienoptionsprogramm 2005

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 standen unter dem von der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2005 insgesamt 403.900 Optionen aus. Im Berichtsjahr 2010 wurden 0 Optionen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Insgesamt sind 109.100 Optionen des Aktienoptionsprogramms 2005 im Geschäftsjahr 2010 verfallen. Optionen aus diesem Programm wurden im Geschäftsjahr 2010 nicht ausgeübt. Die Anzahl der noch ausstehenden Optionen betrug zum Ende des Geschäftsjahres 294.800 Stück, davon wurden insgesamt 70.000 an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Die ausgegebenen Optionen können nach Ablauf der zweijährigen Wartezeit ausgeübt werden, sofern eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wird: (i) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 Prozent p. a. gestiegen und der Börsenkurs der Gesellschaft hat sich in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt als der TecDax oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 10 Prozent p. a. gestiegen. Die Ausübungs- bzw. Bezugspreise betragen 4,95 Euro für 81.500 am 31. August 2005 ausgegebene Optionen, 7,35 Euro für 103.000 am 8. Juni 2006 ausgegebene Optionen sowie 8,39 Euro für 189.400 am 23. Mai 2007 und 8,42 Euro für 30.000 am 22. August 2007 ausgegebene Optionen.

### Aktienoptionsprogramm 2008

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 standen unter dem von der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2008 insgesamt 435.750 Optionen aus. Im Berichtsjahr 2010 wurden 0 Optionen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Insgesamt sind 33.750 Optionen des Aktienoptionsprogramms 2008 im Geschäftsjahr 2010 verfallen. Am Ende des Geschäftsjahres 2010 standen noch 402.000 Optionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2008 aus. Die ausgegebenen Optionen können nach Ablauf der zweijährigen Wartezeit ausgeübt werden, sofern folgende Erfolgsziele erfüllt sind: (i) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabebetrag und dem ersten Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 Prozent pro vollem Kalendermonat gestiegen und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt hat oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabebetrag und dem ersten Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,833 Prozent pro vollem Kalendermonat gestiegen ist. Zusätzlich zu den Erfolgszielen (i) und (ii) muss der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie für die Ausübungszeiträume, die innerhalb der ersten 36 Monate der Laufzeit der Aktienoptionen liegen, während der Laufzeit bis zum ersten Tag des Ausübungszeitraumes mindestens einmal bei 5,00 Euro, für die Ausübungszeiträume, die zwischen dem 37. Monat bis zum 48. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei 5,75 Euro und für Ausübungszeiträume, die zwischen dem 49. Monat und dem 60. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei 6,60 Euro gelegen haben. Die Ausübungs- bzw. Bezugspreise betragen 1,30 Euro für 438.250 am 14. April 2009 ausgegebene Optionen.

## RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 23. Juni 2010 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2010 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben.

### Besitz von Aktien und Bezugsrechten

Die im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2010 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

## VERGÜTUNGSBERICHT

### Vergütung des Vorstands

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS ist es, einen Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergütet werden, aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen, darüber hinaus muss sich die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Der Aufsichtsrat hat sich mehrfach eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungsberater hinzugezogen. Nach ausführlicher Beratung hat der Aufsichtsrat das Vorstandsvergütungssystem zum 1. Januar 2010 an die gesetzlichen Neuerungen angepasst.

### BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

	Anzahl der Aktien zum 31.12.2010	Veränderung gegenüber 31.12.2009	Anzahl der Aktienoptionen zum 31.12.2010	Veränderung gegenüber 31.12.2009
<b>Aufsichtsrat</b>				
Dr. Stefan Reineck	9.600	-	40.000	-
Jan Teichert	0	-	0	-
Sebastian Reppegather	0	-	0	-
<b>Vorstand</b>				
Frank Averdung	42.500	+ 15.000	67.500	-
Michael Knopp	37.500	+ 15.000	97.500	-

### Vergütungsstruktur

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen.

#### Feste Vergütung

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darüber hinaus sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden. Weitere geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

#### Erfolgsbezogene Vergütung

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung und einer aktienbasierten Vergütung.

#### Variable Vergütung

Die variable Vergütung beträgt maximal 100 Prozent der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres. 70 Prozent der variablen Vergütung bestimmen sich nach quantitativen und 30 Prozent qualitativen Kriterien.

#### An quantitativen Zielen orientierte variable Vergütung (variable Vergütung A)

Die quantitativen Kriterien (Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow) werden für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese Ziele zu 70 Prozent oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 130 Prozent ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 Prozent und 130 Prozent, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln.

Die an quantitativen Kriterien orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. Die andere Hälfte steht als sog. Vorbehaltshälfte unter dem Vorbehalt der Überprüfung anhand der Zahlen des folgenden Geschäftsjahres. Der Betrag der Vorbehaltshälfte kann dabei herabgesetzt oder heraufgesetzt werden. Die endgültige Bemessung dieser Vorbehaltshälfte erfolgt wiederum in Abhängigkeit vom Grad der Erreichung des entsprechenden Ziels (Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow), das für das nachfolgende Geschäftsjahr gilt. Wird das für dieses (nachfolgende) Geschäftsjahr geltende Ziel nur zu 70 Prozent oder weniger erreicht, verfällt der Betrag der Vorbehaltshälfte endgültig. Beträgt der Zielerreichungsgrad für das entsprechende Ziel 130 Prozent oder mehr, verdoppelt sich der Betrag der Vorbehaltshälfte des entsprechenden Vergütungsanteils für das vorausgegangene Geschäftsjahr. Bei Zielerreichungsgraden zwischen 70 Prozent und 130 Prozent ist der Betrag der Vorbehaltshälfte im Verhältnis zum jeweiligen Zielerreichungsgrad des (nachfolgenden) Geschäftsjahres zu bestimmen.

#### **An qualitativen Zielen orientierte variable Vergütung (variable Vergütung B)**

30 Prozent der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige, nachhaltige und qualitative Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden. Dabei sind für die jeweiligen Geschäftsjahre Zwischenziele („Milestones“) zu definieren, die in den einzelnen Geschäftsjahren erreicht werden sollen. Erstmals erfolgte eine Festlegung der Milestones für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012. Der Aufsichtsrat legt nach Abschluss eines Geschäftsjahres und nach Anhörung des Vorstands durch Beschluss den Zielerreichungsgrad in Bezug auf die für die Ziele vereinbarten jeweiligen Milestones zwischen 70 und 130 Prozent vorläufig fest. Abhängig vom festgelegten Zielerreichungsgrad für die jeweiligen Milestones wird der Anteil an der variablen Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr festgelegt. Dieser Anteil wird zu 50 Prozent als Vorschuss ausgezahlt und zu 50 Prozent auf das Verrechnungskonto für die variable Vergütung als vorläufiges Guthaben vorgetragen. Nach Ablauf der Gesamtlaufzeit der mehrjährigen Ziele wird der Aufsichtsrat für diese Ziele insgesamt in einer Bandbreite von 70 bis 130 Prozent den Grad der Zielerreichung für die jeweiligen Ziele abschließend feststellen. Für die endgültige Berechnung der variablen Vergütungsanteile für die in die Gesamtlaufzeit fallenden Geschäftsjahre sind nur diese abschließend festgestellten Zielerreichungsgrade maßgeblich, bezogen auf den Mittelwert der Maximalbeträge der betreffenden Geschäftsjahre. Die zuvor festgestellten Zielerreichungsgrade hinsichtlich der Milestones dienen nur der Bemessung der entsprechenden Vorschusszahlung.

#### **Aktienbasierte Vergütung**

Zweites Element der erfolgsabhängigen Vergütung ist eine am langfristigen Erfolg des Unternehmens ausgerichtete aktienbasierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen. Die Aktienoptionsprogramme sind auf der Seite 38 dieses Geschäftsberichts beschrieben.

#### **Abfindungen**

In Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung des Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels („Change of control“-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

Im Geschäftsjahr 2010 hat die SÜSS MicroTec AG folgende Vergütungen an die Vorstandsmitglieder gezahlt:

#### VORSTANDSVERGÜTUNG 2010

Vorstand	Grundgehalt in €*	Variable Vergütung für 2009 in €	Aktioptionen in Stück	Sonstige Leistungen in €**	Aufwand für Altersversorgung in €
Frank Averdung	262.272,72	97.492,33	-	6.567,00	2.148,00
Michael Knopp	217.981,12	85.084,22	-	6.567,00	2.148,00

\* Im Grundgehalt enthalten sind jeweils Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie ein Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit

\*\* Zuschuss zur freiwilligen Rentenversicherung

Ergänzend verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

#### Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500,00 Euro pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 Euro, sein Stellvertreter 40.000,00 Euro und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 Euro pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

Im Geschäftsjahr 2010 haben weder die ausgeschiedenen noch die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergütungen bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

#### AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG 2010

Aufsichtsrat	Vergütung in €	Sitzungsgeld in €	Auslagenersatz in €	Abzug für anteilige D&O- Versicherungsprämie in €
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	45.000,00	13.500,00	7.370,82	1.827,00
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	40.000,00	13.500,00	201,75	914,00
Sebastian Reppegather	35.000,00	13.500,00	6.931,99	609,00

## ORGANE

### Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats und deren Mandate:

#### Frank Averdung

- VDMA Fachverband Productronic, Frankfurt am Main (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)

#### Michael Knopp

#### Dr. Stefan Reineck

- AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- NanoScape AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, OR / USA (Mitglied im Board)
- Bosch Solar CISTech GmbH, Brandenburg an der Havel (Mitglied im Beirat)
- VHF-Technologies SA, Yverdon-les-Bains, Schweiz (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
- und Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchartd

#### Jan Teichert

- Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau an der Isar

#### Sebastian Reppgather

- Zürich, Investment Director bei der Fidinam S.A., Lugano, Schweiz
- Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands (Mitglied im „Board of Directors“)
- IED Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main (Mitglied der Geschäftsführung bis zum 29. Dezember 2010)
- International Equity Development S.L., Barcelona, Spanien (Mitglied der Geschäftsführung seit 6. August 2010)

# KONZERNLAGEBERICHT

und Lagebericht der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2010

## **45 GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN**

- 45 Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit
- 47 Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie
- 47 Forschung und Entwicklung
- 49 Überblick über den Geschäftsverlauf

## **53 ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE**

- 53 Ertragslage
- 55 Finanz- und Vermögenslage
- 58 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage
- 58 Investitionen
- 59 Die Holding – SÜSS MicroTec AG
- 61 Mitarbeiter im Konzern

## **61 ANGABEN GEMÄSS § 315 ABS. 4 HGB**

## **62 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄSS § 289A HGB**

## **62 NACHTRAGSBERICHT**

## **63 RISIKOBERICHT**

- 63 Risikomanagement-System
- 65 Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken
- 66 Betriebliche Risiken
- 67 Finanzmarktrisiken

## **70 PROGNOSEBERICHT**

- 70 Halbleiterindustrie
- 70 Halbleiter-Equipment-Industrie
- 70 Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten
- 72 Endogene Indikatoren
- 72 Gesamtaussage zur voraussichtlichen  
Entwicklung des Konzerns

## **72 VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN**



## GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN

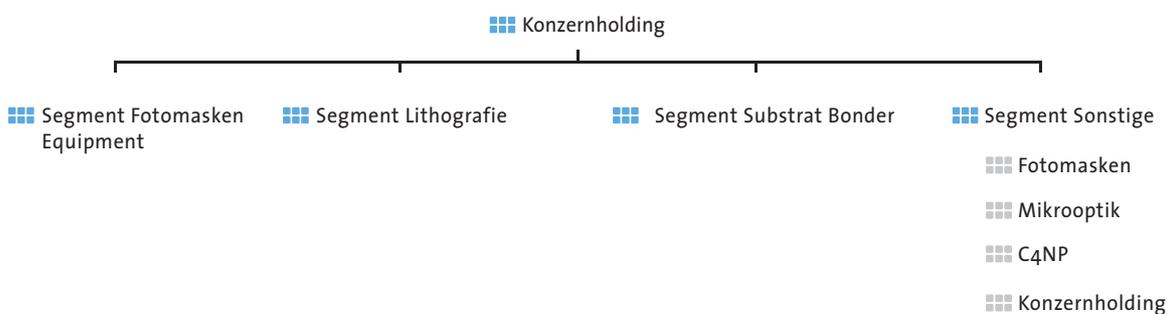
### KONZERNSTRUKTUR UND GESCHÄFTS-TÄTIGKEIT

#### Geschäftstätigkeit und Geschäftsfelder

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigen Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2010 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch die Akquisition der HamaTech APE wurde ein neues Segment – Fotomasken Equipment – geschaffen. Im Januar 2010 hat die SÜSS MicroTec den Bereich Test Systeme veräußert, in Folge dessen wurde auch das Segment Test Systeme aufgelöst.

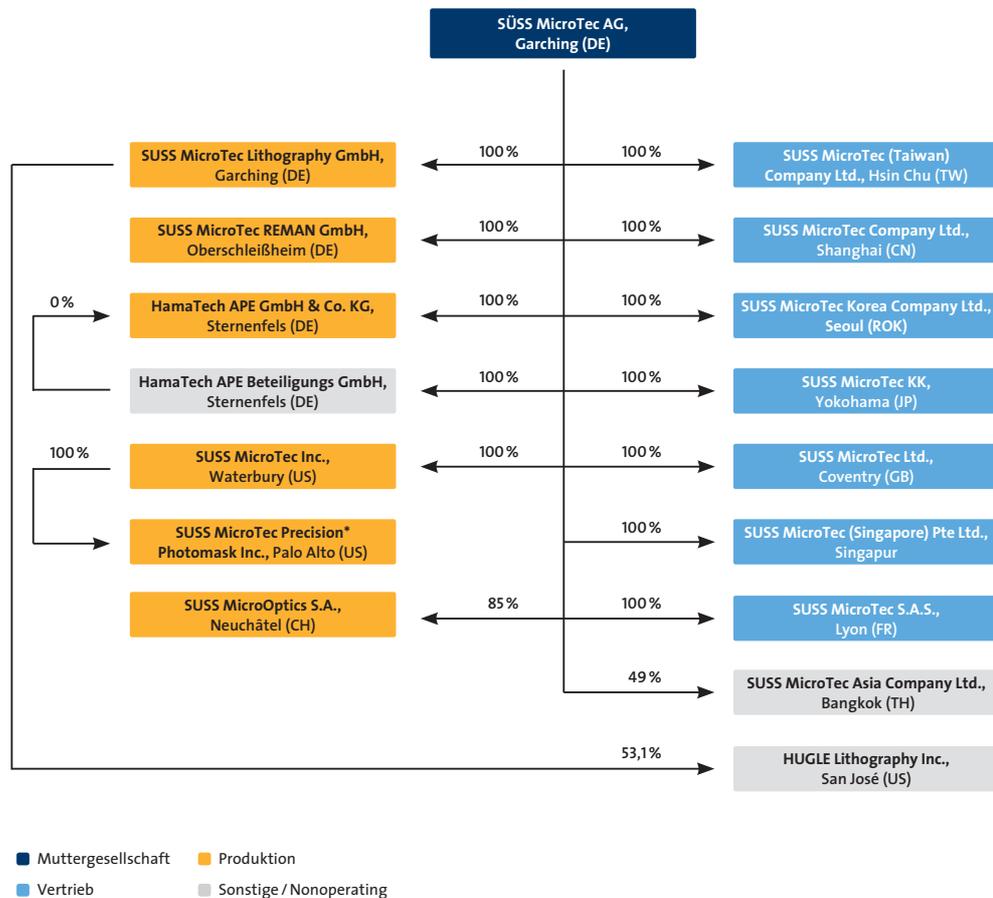


### Rechtliche Konzernstruktur

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebstätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, England, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea, Thailand und Taiwan.

Daneben besteht noch eine geringfügige Beteiligung von 10% an der ELECTRON MEC S.R.L., Mailand (IT).

Diese geringfügige Beteiligung hat nur unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft sowie die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns.



## Leitung und Kontrolle

### Vergütungsstruktur für die Organmitglieder

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden. Neben diesen festen und variablen Vergütungskomponenten erhalten die Mitglieder des Vorstands eine dritte, am langfristigen Unternehmenserfolg orientierte aktienbasierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen gemäß dem jeweils gültigen Aktienoptionsprogramm.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000 €, sein Stellvertreter 40.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

## UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND STRATEGIE

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top-3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

## FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Bereich Forschung und Entwicklung der SÜSS MicroTec wesentliche Veränderungen vorgenommen. Sämtliche Entwicklungsbereiche wurden unter eine einheitliche Leitung gestellt. Das Ziel dieser neuen Struktur ist die Hebung von gruppenweitem Synergiepotenzial, wie beispielsweise durch ein konsequentes Plattformengineering und ein gruppenweites Innovationsmanagement. Die Entwicklung von Equipment und Prozesslösungen sowie die produktübergreifende Standardisierung sind somit auch weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie, um die Marktanteile der SÜSS MicroTec-Geschäftsfelder in den adressierten Märkten zu erhöhen beziehungsweise um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Im Folgenden werden die wesentlichen neuen Produkte und Entwicklungen der jeweiligen Segmente dargestellt und erläutert.

### Lithografie

Im Geschäftsjahr 2010 wurde neben einem speziell für den LED-Markt entwickelten Mask Aligner MA100e, eine neue Version des sehr erfolgreichen 200 mm Belackungs- und Entwickler Clusters Gamma, sowie der neue Einsteigerbelacker Labspin erfolgreich in den Markt eingeführt.

Bei den beiden neuen Produktionstools MA100e Gen 2 und Gamma Gen 2 lag das Hauptaugenmerk der Neuentwicklung auf einem deutlich gesteigerten Durchsatz und damit einer für den Kunden stark verbesserten „Cost-Of-Ownership“. Die MA100e zielt auf den stark wachsenden High-Brightness Mid Range LED-Markt ab. Um in diesem Markt konkurrenzfähig zu sein, erfordert es die Fähigkeit, zuverlässig sehr große Stückzahlen mit hohem Durchsatz bei gleichzeitig günstigem Systempreis herzustellen. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat das neue Gerät, neben zahlreichen Verbesserungen im Detail, einen um 50% schnelleren Durchsatz.

Die neue Version des Produktionsbelackungs- und Entwickler Clusters Gamma Gen 2 adressiert hauptsächlich den MEMS-Markt. Das System für die Belackung, Aushärtung und Entwicklung von Wafern bis 200 mm Durchmesser eignet sich hierfür insbesondere dank seiner Fähigkeit, extrem dicke Fotolackschichten bearbeiten zu können. Das neue Produktionssystem Gamma ist mit einem neuen Doppelarmroboter, einer neuen Videozentrierung und einem neuen Autoloadport ausgestattet. Diese Neuerungen ermöglichen einen erhöhten Durchsatz bei gleichzeitig hoher Flexibilität innerhalb der einzelnen Prozesse.

Das neu entwickelte Belackungsgerät „Labspin“ adressiert insbesondere Universitäten und Forschungsinstitute. Es handelt sich hier um eine vollständige Neuentwicklung, die unseren Kunden einen kostengünstigen Einstieg bei gleichzeitig nochmals deutlich verbesserter Bedienungs-freundlichkeit ermöglicht.

#### Substrat Bonder

Hauptfokus der Entwicklungsaktivitäten des Segments Substrat Bonder im Geschäftsjahr 2010 war die Fertigstellung erster Versionen des Produktionsclusters XBC 300 sowie der dazugehörigen Module für permanente und temporäre Bond- sowie De-Bond-Prozesse für das Marktsegment 3D-Integration. Erste Systeme und Module des XBC Clusters, der Debonder DB12T und DB12S, der Low-Force-Bond-Kammer LF 300, des Bond-Aligners BA300, des High-Force-Bond-Moduls HF300 und des Plasma-Activation-Moduls PL300 konnten bereits an unsere Entwicklungspartner, es handelt sich hier um zwei Forschungsinstitute, ausgeliefert werden.

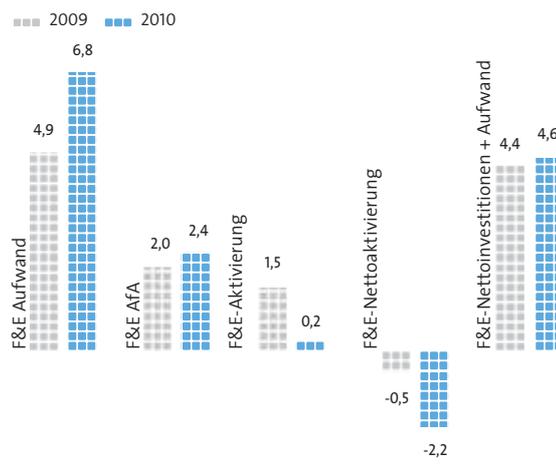
#### Fotomasken Equipment

Im Segment Fotomaskenreinigung konnte in der ersten Jahreshälfte die Beta-Phase der neuen Produktionsplattform Mask-Track-Pro erfolgreich abgeschlossen werden. Das neuartige High-End-System ermöglicht die Reinigung, Temperaturbehandlung und Entwicklung von Masken und Vorlagen für alle relevanten, technologisch führenden Strukturierungsverfahren zur Herstellung der kleinsten Strukturen im Halbleiter Frontend. Aktuell ist die 193 nm Immersions Lithografie-Technologie am weitesten verbreitet. Der Mask-Track-Pro ermöglicht daneben aber auch die Prozessierung von Masken bzw. Vorlagen für die zukünftigen Lithografiertechniken EUV & NIL. Das System konnte direkt nach dem Verkaufsstart die Marktführerschaft im Halbleitersegment Frontend-Fotomaskenreinigung fortführen.

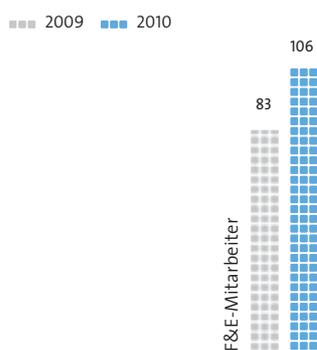
Der Aufwand für Forschung und Entwicklung aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten stieg im Jahresvergleich von 4,9 Mio. € auf 6,8 Mio. €. Im Berichtsjahr übertrafen die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte den Aktivierungsbetrag. Dies hat zu einer Nettobelastung der Gewinn- und Verlustrechnung von 2,2 Mio. € geführt (Belastung im Vorjahr: 0,5 Mio. €).

#### F&E-AUSGABEN IM JAHRESVERGLEICH

in Mio €



## F&E-MITARBEITER



## ÜBERBLICK ÜBER DEN GESCHÄFTSVERLAUF

### Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das im Rahmen des ifo World Economic Survey erhobene Weltwirtschaftsklima zeigte nach einem insgesamt starken Geschäftsjahr 2010 lediglich im vierten Quartal 2010 eine Abschwächung der weltwirtschaftlichen Dynamik an. Der Indikator befand sich allerdings weiterhin über seinem langfristigen Durchschnitt. Die Entwicklung in den jeweiligen Wirtschaftsräumen ist sehr unterschiedlich. Während sich die Expansion in den Schwellenländern bereits seit Jahresbeginn abgeflacht hatte, haben die Industrieländer erst seit Jahresmitte 2010 zunehmend an Dynamik eingebüßt. Trotz der erneut gewachsenen Weltwirtschaft war die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten allerdings weiterhin angespannt. Die Sorgen um die stark gestiegenen Budgetdefizite und Schuldenstände der Industrieländer und die damit einhergehenden Zweifel an der Zahlungsfähigkeit insbesondere einiger Länder im Euroraum bestimmten besonders am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres das Geschehen. Angesichts der stark gestiegenen öffentlichen Schuldenstände und der hohen Budgetdefizite wurden die finanzpolitischen Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung in vielen Ländern nicht mehr ausgeweitet. In China sind diverse staatliche Programme zur Unterstützung der Investitionstätigkeit im Jahresverlauf zurückgeführt worden.

Die Weltwirtschaft ist 2010 insgesamt um etwa 3,7% gewachsen. Am stärksten war das Wachstum erneut in China und Hongkong mit rund 10% gegenüber dem Vorjahr. Aber auch Indien und das restliche Asien (ohne China) haben 2010 mit Wachstumsraten von 8,3% und 7,2% wieder deutlich an Dynamik zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist mit 2,7% gewachsen und lag damit über dem Durchschnitt der EU-27-Länder, die ein Wachstum von 1,6% verzeichneten. Auch das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und lag 2010 um etwa 3,5% über dem Vorjahr (Quelle: Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2010).

### Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Dem Marktforschungsinstitut iSuppli zufolge verzeichnete die weltweite Halbleiterbranche 2010 einen Umsatzanstieg von mehr als 30% auf rund 304 Mrd. US-Dollar (2009: 230 Mrd. \$). Dies ist somit der größte Anstieg, gemessen in US-Dollar, in der Geschichte der Halbleiterindustrie. Insgesamt fiel die Jahresentwicklung deutlich besser aus, als noch zu Beginn des Jahres erwartet. Der Halbleiter-Equipment Markt ist laut Gartner prozentual noch stärker gewachsen, nämlich von 16,6 Mrd. \$ in 2009 auf 38,4 Mrd. \$ in 2010, dies entspricht einem Anstieg von rund 131%. Das Wachstum speziell im Bereich Halbleiter-Verpackung und Montage lag bei rund 119%.

Nach Angaben des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. verzeichnete der deutsche Halbleitermarkt 2010 einen Umsatzanstieg von rund 38% auf 9,5 Mrd. € (Vorjahr: 6,9 Mrd. €). Grund hierfür sind neben der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung besonders Umsatzsteigerungen in den Treibersegmenten Automobil- und Industrie-Elektronik sowie der Datentechnik. Der übrige europäische Markt ist 2010 mit rund 27% deutlich schwächer als der deutsche Markt gewachsen. Nach wie vor hält jedoch die Region Asien / Pazifik ihren Platz als umsatzstärkste Region mit einem Marktanteil von über 50%, wovon allein China die Hälfte beisteuert.

### Unternehmensentwicklung

Wie bereits zu Jahresbeginn 2010 prognostiziert, verzeichnete das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl beim Auftragseingang als auch im Umsatz einen Anstieg. Die SÜSS MicroTec-Gruppe erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 139,1 Mio. € und übertraf damit deutlich den Vorjahreswert von 103,9 Mio. € um 34%. Auch der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich um 97% auf 189,3 Mio. € (Vorjahr: 96,3 Mio. €).

Trotz des signifikanten Umsatzanstiegs schaffte es das Unternehmen im Geschäftsjahr 2010 die Break-even-Schwelle stabil zu halten und konnte somit am Ende ein deutlich verbessertes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 14,3 Mio. € erwirtschaften. Im Vorjahr betrug das EBIT 2,8 Mio. €. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen die in den Vorjahren eingeleiteten operativen und strukturellen Maßnahmen konsequent weitergeführt. Im Rahmen der allgemeinen Erholung konnte auch die Liquiditätssituation der SÜSS MicroTec-Gruppe deutlich verbessert werden. Die liquiden Mittel und verzinslichen Wertpapiere beliefen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2010 auf 50,1 Mio. €. Die Nettoliquidität erhöhte sich zum Jahresende 2010 signifikant auf 34,6 Mio. € (31. Dezember 2009: 18,4 Mio. €). Der Free Cashflow für das Gesamtjahr belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen sowie Sondereffekten aus den getätigten M&A-Aktivitäten auf 14,1 Mio. € (Vorjahr: 8,9 Mio. €).

Der Auftragsbestand betrug zum Stichtag 116,1 Mio. € und lag damit etwa doppelt so hoch wie im Vorjahr (57,0 Mio. €).

Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) belief sich 2010 für die fortgeführten Aktivitäten auf 1,36 nach 0,93 im Vorjahr.

### Umsätze und Auftragslage in den Regionen

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser

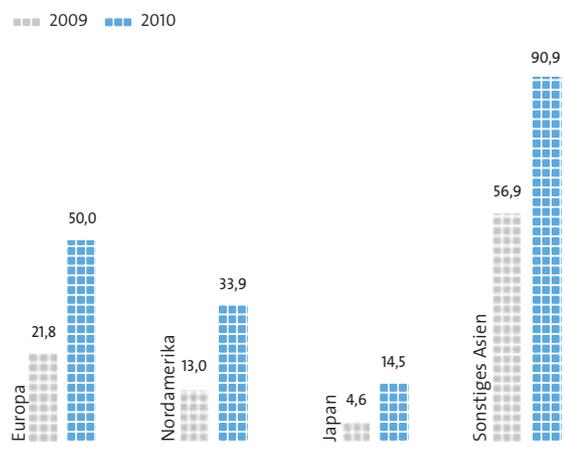
Markt ist allerdings auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MEMS.

### Auftragseingänge nach Regionen

Nach dem äußerst schwierigen Jahr 2009 haben 2010 alle Regionen zum starken Anstieg des Auftragseingangs beigetragen. In Europa erhöhte sich der Auftragseingang deutlich um mehr als 100% auf 50,0 Mio. € nach nur 21,8 Mio. € im Vorjahr. Auch die Region Nordamerika verzeichnete einen starken Anstieg im Auftragseingang und konnte im Gesamtjahr 2010 Aufträge in Höhe 33,9 Mio. € verzeichnen. Sie übertraf damit den Vorjahreswert von 13,0 Mio. € um 161%. Die Region Japan erreichte im Jahr 2010 einen Auftragseingang von 14,5 Mio. €, was ein Plus von 216% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die SÜSS MicroTec-Gruppe hat in der Region Asien (ohne Japan) ein Auftragsplus von 60% auf 90,9 Mio. € nach 56,9 Mio. € im Vorjahr erreicht.

Die positive Entwicklung der Auftragseingänge ist generell der verbesserten gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet. Aber auch unsere speziell auf Kundenbedürfnisse und wachstumsstarke Märkte ausgerichteten Produkte haben zum Auftragswachstum beigetragen. War noch im ersten Halbjahr 2010 die Region „Sonstiges Asien“ der Treiber des hohen Auftragseingangs, so hat sich dies im zweiten Halbjahr zu Gunsten der Regionen Europa und Nordamerika verschoben.

AUFTRAGSEINGANG NACH REGIONEN in Mio. €

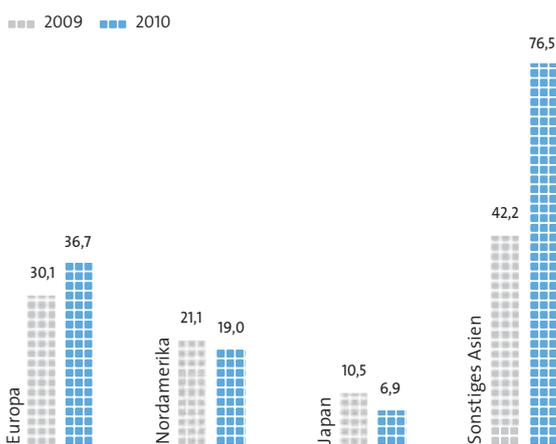


### Umsätze nach Regionen

Ein gemischtes Bild zeichnet sich bei der Entwicklung des Umsatzes nach Regionen. In Europa erhöhte sich der Umsatz um 22 % auf 36,7 Mio. € nach 30,1 Mio. € im Vorjahr. Die Region Nordamerika verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 11 % auf 19,0 Mio. € (Vorjahr: 21,1 Mio. €). Auch Japan erreichte mit 6,9 Mio. € nicht den Wert des Vorjahres (10,5 Mio. €). Eine deutliche Umsatzsteigerung konnte jedoch in der Region „Sonstiges Asien“ erzielt werden, hier lag der Umsatz 2010 bei 76,5 Mio. € und lag damit 81 % über dem Vorjahreswert von 42,2 Mio. €.

#### UMSÄTZE NACH REGIONEN

in Mio. €



### Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten

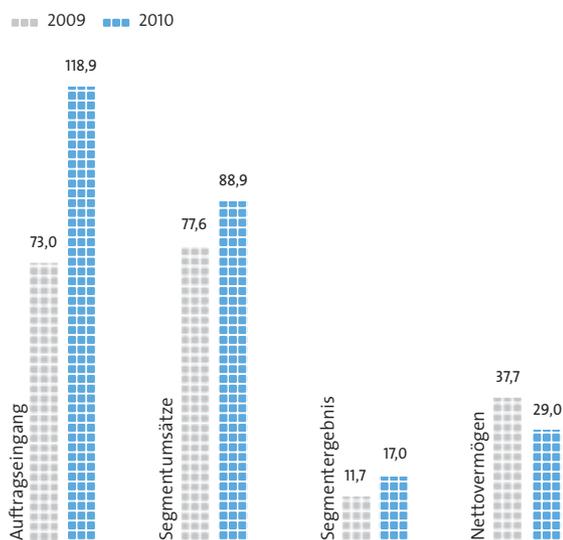
#### Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, Developer und Coater. Die Entwicklung und Produktion dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und seit Mai 2010 in Sternenfels angesiedelt. Der Umzug der Coater- und Developer-Fertigung von Vaihingen an der Enz in das neu erworbene Produktionsgebäude im benachbarten Sternenfels ist ohne Komplikationen erfolgt. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von 64 % der größte Bereich der SÜSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D Integration und das Advanced Packaging.

Im Geschäftsjahr 2010 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 118,9 Mio. € sowie einen Umsatz von 88,9 Mio. €, dies entspricht einem Zuwachs von 63 % bzw. 15 % gegenüber dem Vorjahr. Treiber der starken Nachfrage waren insbesondere asiatische Produktionskunden. Das Segmentergebnis (EBIT) verbesserte sich von 11,7 Mio. € im Vorjahr auf 17,0 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr, dies entspricht einem Zuwachs von 45 %. Die Bruttomarge hat sich erneut gegenüber dem Vorjahr kaum verändert und lag 2010 bei 43,8 % (Vorjahr: 44,4 %). Der Grund für die positive Entwicklung im Auftragseingang und auch im Umsatz liegt in der erhöhten Nachfrage nach allen Produktlinien des Segments, insbesondere aber nach der Produktlinie Mask Aligner. Allgemein hat die Rückkehr zu weltweitem Wirtschaftswachstum das Investitionsverhalten der Produktionskunden verändert. Wurden 2009 noch Investitionen gekürzt oder gar gestrichen, so wurden diese in weiten Teilen 2010 nachgeholt.

#### SEGMENTÜBERSICHT LITHOGRAFIE

in Mio. €



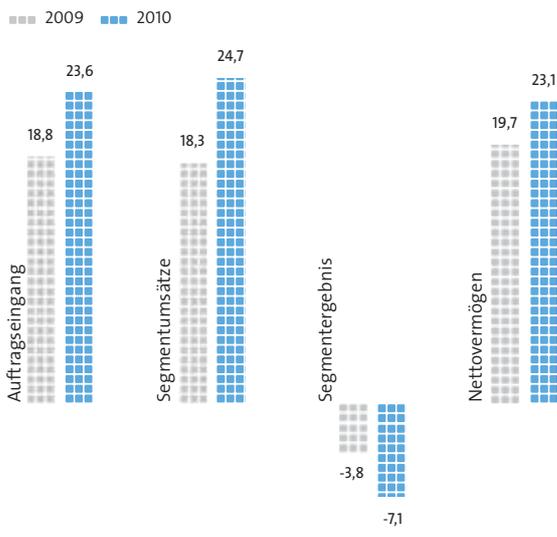
#### Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder und ist derzeit noch in Waterbury im US-Bundesstaat Vermont angesiedelt. Die bereits im Juni 2010 angekündigte Verlagerung der Bonder-Entwicklung und -Fertigung nach Sternenfels wurde bereits begonnen bzw.

teilweise umgesetzt und wird im zweiten Quartal 2011 vollständig abgeschlossen sein. Der Bonder-Vertrieb sowie das nordamerikanische Service- und Applikationscenter werden in diesem Zuge nach Kalifornien verlegt. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 23,6 Mio. € (Vorjahr: 18,8 Mio. €) als auch im Umsatz mit 24,7 Mio. € (Vorjahr: 18,3 Mio. €) weiterhin positiv. Grund für die gute Entwicklung ist die steigende Bedeutung von Bondingsystemen im Fertigungsprozess für zukünftig dreidimensionale Chipstrukturen (3D-Integration). Trotz der guten Umsatzentwicklung fiel das Segmentergebnis (EBIT) von vormals -3,8 Mio. € auf -7,1 Mio. €. Grund für die schwächere Ergebnisentwicklung waren insbesondere Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Geschäftsbereichsverlagerung nach Deutschland in Höhe von 3,9 Mio. € und darüber hinaus die sehr niedrigen Margen für einige große Produktionssysteme, die im zweiten Quartal 2010 an strategische Forschungs- und Entwicklungspartner ausgeliefert wurden. Die Bruttomarge verschlechterte sich entsprechend von 14,7% auf 3,6%.

SEGMENTÜBERSICHT SUBSTRAT BONDER in Mio €

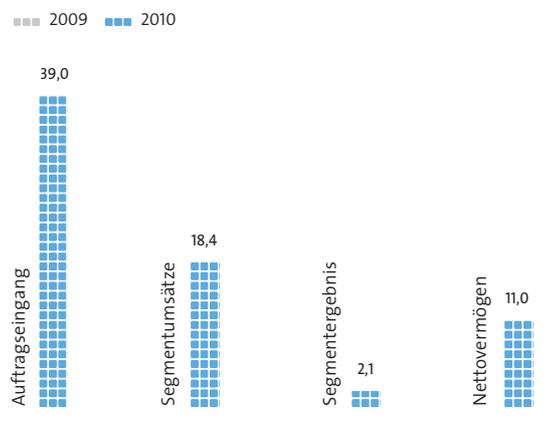


### Fotomasken Equipment

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produktlinien der am 15. Februar 2010 akquirierten HamaTech APE GmbH & Co. KG. Die Entwicklung und Produktion der auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisierten Systeme ist am Standort Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomasken Equipment zählt die Halbleiterindustrie, hier ist SÜSS im Frontend tätig.

Das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich in dem für die Erstkonsolidierung herangezogenen Zeitraum von zehn Monaten sehr positiv. Der Auftragseingang lag Ende Dezember 2010 bei erfreulichen 39,0 Mio. €. Der Segmentumsatz belief sich auf 18,4 Mio. €. Zum Vergleich dazu: Im Geschäftsjahr 2009 hat die HamaTech APE einen Jahresumsatz von rund 11 Mio. € erwirtschaftet. Das Segmentergebnis (EBIT) weist im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits einen Gewinn von 2,1 Mio. € aus. Die Bruttomarge lag bei 36,9%. Die Integration dieses Segments in die SÜSS MicroTec-Gruppe verlief reibungslos. Mit der Akquisition der HamaTech APE wurden auch der Produktionsstandort sowie alle Mitarbeiter in Sternenfels übernommen.

SEGMENTÜBERSICHT FOTOMASKEN EQUIPMENT in Mio €





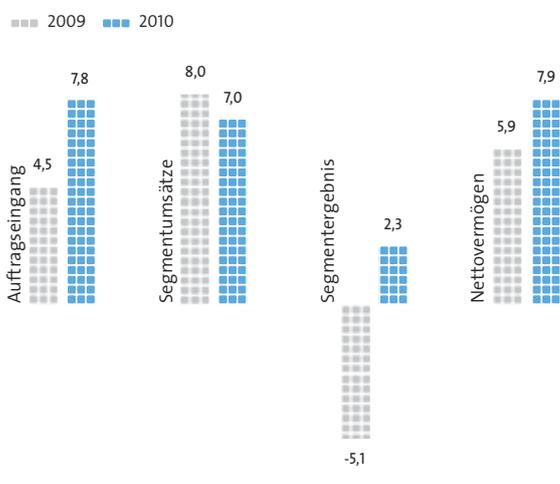
## Sonstige

Das Segment Sonstige umfasst neben dem Maskengeschäft für die Halbleiterindustrie (Palo Alto, Kalifornien, USA) auch die MikroOptik-Aktivitäten am Standort Neuchâtel, Schweiz, sowie das Geschäftsfeld C4NP und die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen.

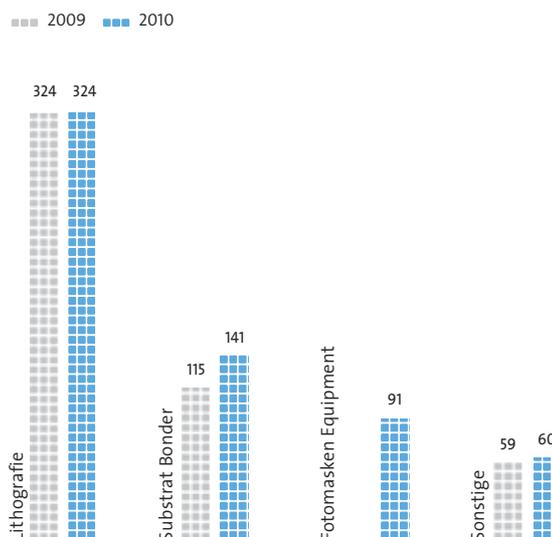
Das Segment Sonstige entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl im Auftragseingang als auch im Umsatz positiv. Der Auftragseingang verbesserte sich von 4,5 Mio. € 2009 auf 7,8 Mio. € 2010. Der Segmentumsatz belief sich auf 7,0 Mio. € nach 8,0 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hierbei erzielte das Geschäftsfeld MikroOptik im Auftragseingang einen Zuwachs um 2,9 Mio. € auf 5,1 Mio. € sowie eine Steigerung im Umsatz um 2,5 Mio. € auf 4,3 Mio. €. Im Maskengeschäft verringerte sich der Umsatzbeitrag von 2,7 Mio. € im Vorjahr auf 2,4 Mio. €. Der Auftragseingang stieg um 9 % auf 2,4 Mio. €. Hintergrund der verbesserten Entwicklung des Maskengeschäfts war das allgemein freundlichere Marktumfeld. Das Segmentergebnis wurde durch einen einmaligen Währungseffekt in Höhe von 1,8 Mio. € sowie den im Rahmen der Erstkonsolidierung der HamaTech APE festgestellten Badwill in Höhe von insgesamt 2,7 Mio. € positiv beeinflusst und belief sich im Gesamtjahr auf 2,3 Mio. € nach -5,1 Mio. € im entsprechenden Vergleichszeitraum 2009.

### SEGMENTÜBERSICHT SONSTIGE

in Mio. €



### MITARBEITER NACH SEGMENTEN



## ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

### ERTRAGSLAGE

Im Geschäftsjahr 2010 verbesserte sich die Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns im Vergleich zum Vorjahr sehr deutlich. Aufgrund der weltweit positiven Konjunktur-entwicklung konnte SÜSS MicroTec außerordentlich hohe Auftragseingänge und erfreuliche Umsatzzuwächse verzeichnen. So stiegen die Umsätze von 103,9 Mio. € im Vorjahr auf 139,1 Mio. € 2010, was einem Umsatzzuwachs von 33,9 % entspricht. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) aus fortgeführten Aktivitäten verfünffachte sich von 2,8 Mio. € im Jahr 2009 auf 14,3 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Das EBIT für das Geschäftsjahr 2010 (fortgeführte Aktivitäten) ist von mehreren Sondereffekten beeinflusst. Positiv wirkte sich die Erstkonsolidierung der HamaTech APE GmbH & Co. KG zum 1. März 2010 aus, die zu einem Badwill in Höhe von 2,7 Mio. € führte. Ein weiterer positiver Effekt ergab sich durch die Rückführung von konzerninternen Fremdwährungskrediten durch die Süss MicroTec Inc., Waterbury – dadurch konnten Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,8 Mio. € realisiert werden. Im Gegenzug belasteten Restrukturierungsaufwendungen in Höhe

von 3,9 Mio. € das Ergebnis, die im Zusammenhang mit der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs und der nordamerikanischen Vertriebs- und Service-Organisation von Waterbury / Vermont (USA) nach Sternenfels bzw. Kalifornien anfielen. Darüber hinaus entstanden durch die Zusammenlegung der Standorte Vaihingen und Sternenfels zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. €.

Bereinigt um diese Sondereffekte lag das EBIT 2010 bei 14,0 Mio. € (nach 2,8 Mio. € im Vorjahr).

Der Anstieg der Umsatzerlöse aus den fortgeführten Aktivitäten um 35,2 Mio. € auf 139,1 Mio. € resultiert aus einer gestiegenen Nachfrage nach unseren Produkten in nahezu allen Segmenten des Konzerns. So kletterten die Umsätze im umsatzstärksten Bereich Lithografie um 11,3 Mio. € auf 88,9 Mio. € und im Segment Substrat Bonder um 6,4 Mio. € auf 24,7 Mio. €. Das neue Segment Fotomasken Equipment trug mit 18,4 Mio. € zum Konzernumsatz bei. Besonders erfreulich entwickelten sich auch die Umsätze im Bereich MikroOptik, die sich von 1,8 Mio. € im Vorjahr auf nun 4,3 Mio. € mehr als verdoppelten. Die Umsätze des Bereichs Fotomasken verringerten sich im Berichtsjahr leicht von 2,7 Mio. € im Vorjahr auf 2,4 Mio. €. Im Segment C4NP wurden – da die an IBM gelieferten Tools bereits im Vorjahr erfolgreich abgenommen wurden – mit 0,2 Mio. € kaum noch Umsätze erzielt (2009: 3,4 Mio. €).

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 2,4 Mio. € enthalten. Damit sind die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten um rund 2,2 Mio. € höher als die Neu-Aktivierungen, die sich im Berichtsjahr auf lediglich 0,2 Mio. € summierten. 2009 beliefen sich die Aktivierungen von Entwicklungskosten noch auf 1,6 Mio. €, während die Abschreibungen rund 2,0 Mio. € betragen (fortgeführte Aktivitäten).

Im Berichtsjahr konnte aus den fortgeführten Aktivitäten ein Rohertrag von 51,1 Mio. € erzielt werden, was einer Rohertragsmarge von 36,7% entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag 38,8 Mio. €, die Rohertragsmarge 2009 belief sich auf 37,4%. Der absolute Anstieg des Rohertrags resultiert aus Umsatzzuwächsen in den Bereichen Lithografie

und MikroOptik und dem positiven Beitrag des neuen Segments Fotomasken Equipment. Der leichte Rückgang der durchschnittlichen Konzern-Rohertragsmarge ist vor allem dem Bereich Substrat Bonder geschuldet, da 2010 einige große Bonder-Produktionssysteme an die strategischen Forschungs- und Entwicklungspartner IMEC und ITRI ausgeliefert wurden, die – belastet durch hohe Aufwendungen für diese Kooperationen – sehr niedrige Margen aufwiesen.

Infolge der konsequenten Fortführung des implementierten Sparkurses sind sowohl die Vertriebs- als auch die Verwaltungskosten – trotz der erstmaligen Einbeziehung des Bereichs Fotomasken Equipment – nur unterproportional angestiegen. Die Vertriebskosten erhöhten sich von 16,7 Mio. € im Vorjahr auf 17,4 Mio. €, was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 12,5% (2009: 16,1%) entspricht. Die Verwaltungskosten stiegen von 13,9 Mio. € auf 17,8 Mio. € und entsprechen damit 2010 einer Aufwandsquote von 12,8% (2009: 13,4%). Im Bereich der Vertriebskosten wirkten die gestiegenen Provisionen für Vertriebsmitarbeiter aufgrund des erhöhten Umsatz- und Ergebnisniveaus. In den Verwaltungskosten sind Sonderaufwendungen für die Verlagerung des Bereichs Substrat Bonder von Waterbury / USA nach Sternenfels in Höhe von 1,2 Mio. € sowie die Kosten für die Verlagerung des Werks Vaihingen nach Sternenfels in Höhe von 0,3 Mio. € enthalten.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich von 4,9 Mio. € auf 6,8 Mio. € und betrafen im Wesentlichen die Bereiche Lithografie (4,1 Mio. €) und Substrat Bonder (2,2 Mio. €). Für das neue Segment Fotomasken Equipment fielen Entwicklungsaufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. € an.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 10,0 Mio. € ist die erfolgswirksame Vereinnahmung des Badwills in Höhe von 2,7 Mio. € enthalten, der aus der Erstkonsolidierung der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der nachträglichen Kaufpreisanpassung resultiert. Außerdem ist hier der positive Fremdwährungseffekt aus der Rückführung des US-Dollar-Darlehens der Süss Microtec Inc., Waterbury, in Höhe von 1,8 Mio. € erfasst.

Der Bereich Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 17,0 Mio. € (2009: 11,7 Mio. €) zum Konzern-EBIT aus fortgeführten Aktivitäten (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für den Bereich Lithografie eine Umsatzrendite von 19,1%, die sich im Vergleich zum Vorjahr (2009: 15,1%) deutlich verbessert hat.

Im Bereich Substrat Bonder ergibt sich ein EBIT von -7,1 Mio. € nach -3,8 Mio. € im Vorjahr. Neben margschwachen Aufträgen für die strategisch wichtigen Kooperationspartner IMEC und ITRI ist das Ergebnis auch belastet durch hohe Entwicklungskosten im Zusammenhang mit Thin Wafer Handling. Darüber hinaus sind hier auch Restrukturierungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs in Höhe von 3,9 Mio. € erfasst.

Sehr erfreulich hat sich die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des neuen Segments Fotomasken Equipment dargestellt. In den zehn Monaten seit der Erstkonsolidierung trug das Segment Fotomasken Equipment mit 2,1 Mio. € zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite liegt damit bei 11,5%.

Das Finanzergebnis belief sich 2010 auf -0,3 Mio. € (nach -0,1 Mio. € im Vorjahr) und resultierte im Wesentlichen aus gestiegenen Zinsaufwendungen, während bei den Zinserträgen im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen war.

Die Belastung des Konzerns mit Ertragsteuern in Höhe von 1,0 Mio. € fiel deutlich geringer aus als im Vorjahr (2009: 2,1 Mio. €). Der am Vorsteuerergebnis gemessen unverhältnismäßig geringe Ertragsteueraufwand resultiert im Wesentlichen aus positiven Effekten aus der Aktivierung von latenten Steueransprüchen, die sich im Zusammenhang mit der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs von den USA nach Deutschland ergeben. Die tatsächlich anfallenden laufenden Steueraufwendungen betragen rund 4,8 Mio. €, während aus den latenten Steuern ein Steuerertrag in Höhe von rund 3,8 Mio. € resultiert.

Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten von 13,0 Mio. €. Dem steht im Vorjahr ein Gewinn von 0,5 Mio. € gegenüber.

Aus nicht fortgeführten Aktivitäten erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von 0,3 Mio. € (Vorjahr: -5,4 Mio. €), das ausschließlich dem nicht fortgeführten Bereich Test Systeme zuzuschreiben ist. Darin enthalten ist das operative Ergebnis von -1,3 Mio. €, das zum einen aus der laufenden Geschäftstätigkeit der Suss MicroTec Test Systems GmbH von Jahresbeginn bis zum Entkonsolidierungszeitpunkt am 27. Januar 2010 resultierte. Zum anderen fielen nachlaufende Kosten für die Abwicklung des Bereichs Test Systeme an. Im Bereich Test Systeme ist außerdem der Gewinn aus Entkonsolidierung abgebildet, der sich auf 1,6 Mio. € belief. Im Vorjahr war das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten belastet mit negativen Bewertungseffekten in Höhe von 4,7 Mio. €, die mit 4,2 Mio. € den Geschäfts- oder Firmenwert und in Höhe von 0,5 Mio. € die immateriellen Vermögenswerte und die Sachanlagen des Segments Test Systeme betrafen.

Insgesamt erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von 13,4 Mio. € (Vorjahr: -4,9 Mio. €). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten betrug 0,73 € nach -0,28 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 8,1% von 209 T€ auf 226 T€ (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

## FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Dem Konzern ist es gelungen, seine Net Cash Position – der Saldo aus flüssigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlichkeiten – von 18,4 Mio. € im Vorjahr auf 34,6 Mio. € deutlich auszubauen. Der Bestand an liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren erhöhte sich von 31,1 Mio. € im Vorjahr auf 50,1 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 16,1 Mio. € (2009: 12,1 Mio. €). Hier machte sich vor allem der signifikante Anstieg der erhaltenen Kundenanzahlungen (von 11,8 Mio. € zum Jahresende 2009 auf nun 23,5 Mio. €) und der Aufbau der Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen (verminderter Mittelabfluss von 3,4 Mio. €) bemerkbar. Der Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen konnte weiter reduziert werden (bereinigt um Wechselkurseffekte) und generierte einen Mittelzufluss in Höhe von 2,0 Mio. €. Gegenläufig wirkte sich der Aufbau des Konzernlagerbestandes aus, aus dem ein Mittelabfluss in Höhe von 16,5 Mio. € resultierte. Großen Anteil am Anstieg des Lagerbestandes hatten Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die Endabnahme jedoch noch aussteht. Der Bestand dieser Maschinen ist von 7,1 Mio. € zum Jahresende 2009 auf nun 15,8 Mio. € angestiegen. Darüber hinaus sind zum Bilanzstichtag sehr hohe Bestände an unfertigen Maschinen vorhanden, die dem hohen Auftragsbestand Rechnung tragen. Die Bestände an unfertigen Maschinen erhöhten sich von 14,1 Mio. € zum Jahresende 2009 auf nun 23,8 Mio. €.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung des Erwerbs der HamaTech APE GmbH & Co. KG sowie Grundstück und Gebäude Sternenfels, der Veräußerung des Test Business und der Investitionen in Wertpapiere -2,8 Mio. € (nach -3,2 Mio. € 2009). Investiert wurde im Wesentlichen in Sachanlagen.

Der freie Cashflow belief sich damit – bereinigt um Sondereffekte (Erwerb der HamaTech inklusive Grundstück und Gebäude Sternenfels und Veräußerung des Test-Business) und vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben – auf 14,1 Mio. €, nachdem im Vorjahr ein freier Cashflow von 8,9 Mio. € erzielt wurde.

Im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit spiegelt sich der Mittelzufluss aus der im Mai 2010 durchgeführten Kapitalerhöhung wider, aus der ein Nettozufluss von 6,6 Mio. € resultierte. Darüber hinaus wurde ein Darlehen zur Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstücks in Sternenfels aufgenommen, das zu einem Mittelzufluss von 4,5 Mio. € führte.

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Höhe von 50,1 Mio. € (Vorjahr: 31,1 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 9,5 Mio. € (Vorjahr: 9,0 Mio. €). Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil

davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 5,6 Mio. €.

Das bisherige Bankenkonsortium unter Führung der Fortis Bank wurde zum 31. März 2010 durch ein neues Konsortium unter der Führung der BayernLB abgelöst. Die SÜSS MicroTec AG hat im März 2010 mit dem neuen Bankenkonsortium Kreditverträge unterzeichnet, mit denen eine Kreditlinie in Höhe von 6 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft vorerst bis zum 31. März 2011 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Im Mai 2010 hat die HamaTech APE GmbH & Co. KG mit der BW Bank Mannheim einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatsklärung für die HamaTech APE GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Bürgschaftsrahmen von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zum Bilanzstichtag ist diese Linie in Höhe von 1,9 Mio. € genutzt. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die aktivierten Entwicklungskosten die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert betrug wie im Vorjahr 13,6 Mio. € und ist ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen.

Die aktivierten Entwicklungskosten entwickelten sich im Berichtsjahr rückläufig: nach 9,3 Mio. € im Vorjahr betragen sie zum Bilanzstichtag noch 7,6 Mio. €. Die planmäßigen Abschreibungen auf die aktivierten Entwicklungsprojekte übertrafen im abgelaufenen Geschäftsjahr

die getätigten Investitionen um 2,2 Mio. €, was zu einer entsprechenden Belastung in der Gewinn- und Verlustrechnung führte. Gegenläufig wirkte sich ein aus Wechselkurseffekten resultierender Anstieg der in US-Dollar aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von 0,5 Mio. € aus. Mit Übertragung des gesamten Substrat-Bonder-IPs von der Süss MicroTec Inc., Waterbury, an die Süss MicroTec Lithography GmbH werden nun sämtliche aktivierten Entwicklungskosten in Euro geführt. In den folgenden Jahren sind deshalb keine weiteren Wertveränderungen aufgrund sich verändernder Wechselkurse mehr zu erwarten. Die zum Bilanzstichtag aktivierten Entwicklungsleistungen entfielen in Höhe von 2,6 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €) auf das Segment Lithografie und in Höhe von 4,9 Mio. € (Vorjahr: 6,0 Mio. €) auf das Segment Substrat Bonder.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente in Höhe von 3,8 Mio. € (Vorjahr: 4,5 Mio. €) sowie aktivierte Leasinggegenstände (SAP-Lizenzen). Der Restbuchwert von 3,8 Mio. € entfällt in Höhe von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment sowie in Höhe von 2,2 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €) auf das Segment Sonstige.

Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der HamaTech-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 0,6 Mio. € aufweist.

Das Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 7,4 Mio. € im Vergleich zu 0,4 Mio. € im Vorjahr. Als größte Investition ist die Anschaffung der Immobilie und des Grundstücks Sternenfels zu nennen, das im Zuge der HamaTech-Akquisition erworben wurde und im Geschäftsjahr Anschaffungskosten von 4,5 Mio. € aufwies. Im Investitionsbetrag des Berichtsjahres ist auch der Zugang des Sachanlagevermögens der HamaTech APE GmbH & Co. KG enthalten, der sich im Erstkonsolidierungszeitpunkt auf 0,4 Mio. € belief. Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Mio. € gestiegen.

Die latenten Steueransprüche erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund höherer temporärer Differenzen im Bereich der immateriellen Vermögenswerte um 1,1 Mio. € und betragen zum Bilanzstichtag 8,9 Mio. €.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr deutlich angestiegen: Sie erhöhten sich von 96,5 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 137,2 Mio. €. Dieser Anstieg resultierte im Wesentlichen aus den Vorräten und dem Bestand an Wertpapieren und liquiden Mitteln.

Die Vorräte erhöhten sich von 40,8 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 64,4 Mio. €. Dabei entfielen 5,6 Mio. € auf den Vorratsbestand der HamaTech APE GmbH & Co. KG, der durch Akquisition zum Konzernvermögen hinzugefügt wurde. Ein weiterer Anstieg in Höhe von 1,5 Mio. € resultierte aus Umbewertungen der in Fremdwährung bilanzierten Vorratsbestände aufgrund veränderter Wechselkurse. Darüber hinaus sind die Bestände an Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen jedoch die Endabnahme noch aussteht, um rund 7,1 Mio. € auf nun 15,8 Mio. € angestiegen. Auch die Bestände an unfertigen Maschinen sind – aufgrund des hohen Auftragsbestands – zum Bilanzstichtag außergewöhnlich hoch: Sie beliefen sich auf 23,8 Mio. € (nach 14,1 Mio. € zum Jahresende 2009).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten im Vergleich zum Vorjahr leicht von 14,8 Mio. € auf 15,7 Mio. €. Der Anstieg resultierte zum einen aus Forderungen in Höhe von 1,6 Mio. €, die durch die Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG erworben wurden. Zum anderen wirkten auch hier veränderte Wechselkurse bei den Fremdwährungsforderungen mit 1,1 Mio. € werterhöhend. Bereinigt um Wechselkurs- und Sondereffekte ist jedoch der Bestand an Forderungen um 1,8 Mio. € gesunken, was vor allem einem effizienten Forderungsmanagement geschuldet ist.

Der Bestand an Wertpapieren des SÜSS MicroTec-Konzerns erhöhte sich 2010 von 10,5 Mio. € auf 16,0 Mio. €. Zum einen erhielt die SÜSS MicroTec AG mit Veräußerung der Anteile an der Süss MicroTec Test Systems GmbH 747.530 Aktien an Cascade Microtech Inc., Beaverton / Oregon (USA), die zum Bilanzstichtag mit 2,4 Mio. € bilanziert waren. Zum anderen wurden 2010 – unter Verwendung

des erwirtschafteten freien Cashflows – Wertpapiere für rund 6,1 Mio. € erworben. Bei den bilanzierten Wertpapieren handelt es sich um Unternehmens- und Staatsanleihen.

Der Anstieg der sonstigen Vermögenswerte von 1,6 Mio. € im Vorjahr auf 3,4 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf hohe Umsatzsteuerforderungen zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden erhöhten sich von 20,0 Mio. € auf 20,8 Mio. €. Die Finanzschulden sind – im Wesentlichen durch die Aufnahme eines Darlehens für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels – von 11,0 Mio. € auf 14,4 Mio. € gestiegen. Im Gegenzug sind die latenten Steuerschulden von 5,2 Mio. € auf 2,7 Mio. € zurückgegangen. Wesentlicher Grund für diesen Rückgang war der Verkauf des Substrat-Bonder-IPs, das auch sämtliche aktivierte Entwicklungskosten des Bereichs Substrat Bonder enthielt, von der SÜSS MicroTec Inc., Waterbury, an die SÜSS MicroTec Lithography GmbH. Damit konnten in den USA passivierte latente Steuern auf die temporären Differenzen im Zusammenhang mit den aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von rund 3,3 Mio. USD aufgelöst werden.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein deutlicher Anstieg von 30,4 Mio. € im Vorjahr auf 54,4 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Größten Anteil an diesem Anstieg hatten die erhaltenen Kundenanzahlungen, die sich von 12,1 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 23,6 Mio. € erhöhten. Auch der hohe Stand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die zum Bilanzstichtag mit 9,7 Mio. € passiviert waren (nach 4,5 Mio. € zum Jahresende 2009), trug zu dem Anstieg bei. In den Rückstellungen, die sich von 1,8 Mio. € im Vorjahr auf nun 4,6 Mio. € erhöhten, ist die Restrukturierungsrückstellung für die Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs in Höhe von 1,5 Mio. € enthalten. In den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind außerdem die aufgrund der positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung hohen Bonus- und Provisionsrückstellungen in Höhe von 2,8 Mio. € (2009: 1,8 Mio. €) passiviert.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2009 um 20,3 Mio. € auf 106,4 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote verringerte sich jedoch

aufgrund der deutlich gestiegenen Bilanzsumme im Jahresvergleich von 63,1% auf 58,6%.

Mit der am 10./11. Mai 2010 durchgeführten Kapitalerhöhung wurden 1.701.912 Aktien zum Preis von 4,00 € pro Aktie ausgegeben. Der Bruttomittelzufluss betrug 6,8 Mio. €. Das gezeichnete Kapital erhöhte sich dadurch um 1,7 Mio. €. In die Kapitalrücklage wurden 5,1 Mio. € eingestellt. Die Transaktionskosten für die Durchführung der Kapitalerhöhung betragen rund 0,2 Mio. €. Sie wurden von der Kapitalrücklage in Abzug gebracht.

## GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

Die Umsatz- und Ergebnissituation von SÜSS MicroTec hat sich im Berichtsjahr sehr erfreulich dargestellt und übertraf alle Erwartungen. Da der in den beiden vergangenen Jahren begonnene Sparkurs konsequent fortgeführt wurde, konnte SÜSS MicroTec ein EBIT von 14,3 Mio. € (fortgeführte Aktivitäten) und eine EBIT-Marge von 10,3% erzielen.

Durch die deutlich ausgebaute Net Cash Position von 34,6 Mio. € (Vorjahr: 18,4 Mio. €) verfügt der Konzern über ausreichend finanziellen Spielraum, um Investitionen in neue Produktentwicklungen zu forcieren sowie andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

## INVESTITIONEN

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2% des Umsatzes bewegen werden. Ausnahmen stellen nur die in dem Segment Sonstige enthaltenen Produktlinien „Masken“ und „Mikrooptik“ dar. In beiden Fällen wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in diesen Bereichen führen unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg der Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Im Berichtsjahr hat die SÜSS MicroTec AG das neue Betriebsgrundstück und Gebäude in Sternenfels für einen Kaufpreis von rund 4,5 Mio. € erworben, an dem die HamaTech mit dem Produktbereich Fotomaschinen Equipment und die Suss MicroTec Lithography GmbH mit einem Teil des Lithografie-Bereichs ansässig sind. Seit Beginn des Jahres 2011 ist auch der Bereich Substrat Bonder – als ein weiterer Bereich der Suss MicroTec Lithography GmbH – in Sternenfels angesiedelt. Daneben wurden im Berichtsjahr – bedingt durch die Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG – die gesamten Sachanlagen der HamaTech im Erstkonsolidierungszeitpunkt als „Zugang aus Unternehmenszusammenschlüssen“ im Anlagespiegel dargestellt.

Ein Teil der Investitionen ist dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen, da für Entwicklungskosten unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach IFRS eine Aktivierungspflicht besteht. Dominierende Projekte im Berichtsjahr waren die Erweiterungen der Produktpalette im Segment Substrat Bonder. Wir gehen langfristig davon aus, dass rund 25 bis 35 % der Ausgaben für Entwicklungskosten aktiviert werden und der verbleibende Betrag aufwandswirksam erfasst wird.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der weitere Rollout des bei den ersten Konzerngesellschaften erfolgreich eingeführten ERP-Systems SAP fortgeführt. So wurde das SAP-System erfolgreich bei der Suss MicroTec (Taiwan) Company Ltd. eingeführt und im Mai 2010 produktiv gesetzt. 2011 wird die Suss MicroTec Inc. an ihrem neuen Standort in Sunnyvale / Kalifornien in das konzernweite SAP-System eingebunden werden. Im Vorjahr konnte über eine Sale-and-lease-back-Transaktion ein Teil des Projektes von 3,0 Mio. € refinanziert werden.

## DIE HOLDING – SÜSS MICROTEC AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch

bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

### Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding

#### Wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage

Die immateriellen Vermögensgegenstände sanken im abgelaufenen Geschäftsjahr um 1,0 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag auf 2,7 Mio. €. Der Rückgang beruht ausschließlich auf planmäßigen Abschreibungen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen verringerten sich im Berichtsjahr wegen des Verkaufs der Suss MicroTec Test Systems GmbH um 5,1 Mio. € und belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 56,1 Mio. €.

Der Rückgang der Ausleihungen an verbundene Unternehmen resultiert aus außerplanmäßigen Tilgungen der Suss MicroTec Inc. in Höhe von 10,5 Mio. € und planmäßigen Tilgungen in Höhe von 0,3 Mio. €. Bei den Zugängen spiegelt sich der Erwerb der HamaTech APE GmbH & Co. KG und eines im Zusammenhang mit der Akquisition erworbenen Gesellschafterdarlehens in Höhe von 4,3 Mio. € wider.

Die kurzfristigen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen erhöhten sich um 3,3 Mio. €. Der Anstieg der kurzfristigen Forderungen ist hauptsächlich auf die Erhöhung kurzfristiger Darlehen gegenüber der Suss MicroTec KK zurückzuführen.

Die SÜSS MicroTec AG konnte im Berichtsjahr ihre Liquiditätsposition weiter ausbauen. Der Ausbau resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Free Cashflow der über das Konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen

Tochtergesellschaften. Die Erhöhung der Liquiditätsposition wird sowohl im Anstieg der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 14,8 Mio. € als auch in der Erhöhung des Bestands von Wertpapieren in Höhe von 5,5 Mio. € sichtbar. Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Unternehmens- und Staatsanleihen. Unter den Wertpapieren sind außerdem 747.530 Aktien an der Cascade Microtech Inc. ausgewiesen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Süss MicroTec Test Systems GmbH zugegangen sind.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sanken im Berichtsjahr um 2,5 Mio. €. Der Rückgang resultierte aus der Süss MicroTec Lithography GmbH.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich im Verlauf des Jahres 2010 um 4,5 Mio. €. Zur Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstücks in Sternenfels hat die SÜSS MicroTec AG einen Darlehensvertrag mit einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen beläuft sich auf 4,5 Mio. € und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Weiterhin unverändert besteht das im Dezember 2012 fällige Schuldscheindarlehen.

Das erhöhte Eigenkapital (+13,2 Mio. €) resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres (6,2 Mio. €) und der im Mai 2010 durchgeführten Kapitalerhöhung (6,8 Mio. €).

### Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2010 ein Jahresüberschuss von 6,2 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -18,0 Mio. €).

Aufgrund des bis 27. Januar 2010 gültigen Gewinnabführungsvertrages mit der Süss MicroTec Test Systems GmbH, Sacka, wurde bei der Holding ein Aufwand aus Verlustübernahme in Höhe von 0,3 Mio. € (Vorjahr: -0,8 Mio. €) ergebniswirksam gebucht. Aufgrund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Gewinnabführungsvertrages mit der Süss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, wurde bei der Holding ein Aufwand aus Verlustübernahme in Höhe von 1 T€ (Vorjahr: 92 T€ Gewinn) ergebniswirksam erfasst.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 4,0 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) und der Gewinn aus dem Abgang der Beteiligung der Süss MicroTec Test Systems GmbH, Sacka, in Höhe von 4,8 Mio. € enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – die Kosten der Kapitalerhöhung (0,2 Mio. €), Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Verkauf der Süss MicroTec Test Systems und dem Kauf der HamaTech APE (0,8 Mio. €), die Kosten der SAP-Einführung in Taiwan (0,3 Mio. €) und die aus einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Forschungsinstitut

Gesellschaft	SMT AG (HGB)				
	in T€	2010	2009	Änderung	in %
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		6.217	-18.030	24.247	>100%
Eigenkapital		91.843	78.623	13.220	17%
Bilanzsumme		126.414	110.694	15.720	14%
EK-Quote in %		73%	71%		
Anlagevermögen		68.422	76.501	- 8.079	-11%
...% der Bilanzsumme		54%	69%		
Umlaufvermögen		57.992	34.193	23.799	70%
...% der Bilanzsumme		46%	31%		



IMEC im Bereich Waferbonding Lösungen zu Applikationen für die 3D-Integration resultierenden Aufwendungen (0,8 Mio. €). Die Fremdwährungsverluste betragen im Geschäftsjahr 1,5 Mio. € (nach 1,3 Mio. € im Vorjahr).

Die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 0,6 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €) enthalten eine Ausschüttung der Tochtergesellschaft Süss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu.

Die Zinsaufwendungen sanken im Geschäftsjahr um 0,08 Mio. €, was im Wesentlichen auf die ausgebaute Liquiditätsposition der Gesellschaft zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2010 durchschnittlich 19 (Vorjahr: 19) Mitarbeiter tätig.

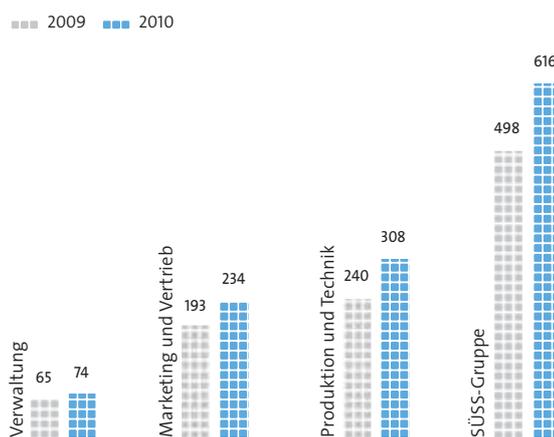
Neben der Entwicklung des US-Dollars hängt die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft.

## MITARBEITER IM KONZERN

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2010 waren 616 (Vorjahr: 498) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt. Die Mitarbeiterzahl des Vorjahres ist bezogen auf die fortgeführten Aktivitäten.

## MITARBEITER BEREICHE



## ANGABEN GEMÄSS § 315 ABS. 4 HGB

Infolge der im Mai 2010 durchgeführten Kapitalerhöhung, unter Nutzung des genehmigten Kapitals, die am 20. Mai 2010 in das Handelsregister eingetragen wurde, hat sich das gezeichnete Kapital der SÜSS MicroTec AG auf 18.721.038 € erhöht. Es ist aufgeteilt in 18.721.038 nennwertlose, stimmberechtigte Stückaktien. Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen.

Es bestehen keine Beschränkungen bezüglich der Stimmrechte oder der Übertragung von Aktien.

Zum Bilanzstichtag gibt es keine direkten oder indirekten Beteiligungen am Kapital der SÜSS MicroTec AG, die 10 % überschreiten.

Sonderrechte von Aktionären, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. Über die bestehenden Aktienoptionspläne sind Arbeitnehmer nach Ausübung ihrer Optionen am Kapital der Gesellschaft beteiligt. Die ihnen hieraus entstehenden Kontrollrechte üben sie unmittelbar aus.

Die Regelungen zur Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern der SÜSS MicroTec AG ergeben sich aus den §§ 84 f. AktG. Die Satzung enthält diesbezüglich keine weitergehenden Regelungen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt gemäß § 7 der Satzung der Aufsichtsrat. Dieser kann auch ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

Satzungsänderungen sind in den §§ 133, 179 AktG geregelt. Die Befugnis zu Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, wurde gemäß § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG an den Aufsichtsrat delegiert.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 19. Juni 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt € 2.552.863 durch Ausgabe von bis zu 2.552.863 neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und / oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Die bestehenden Schuldscheinverträge beinhalten eine Change-of-Control-Klausel. Demzufolge haben die Darlehensgeber die Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung, wenn eine oder mehrere Personen, die nicht dem Kreis der bestehenden Hauptaktionäre zuzurechnen sind, eine Anzahl von Aktien an der SÜSS MicroTec AG halten oder erworben haben, auf die 50 % oder mehr der Stimmrechte entfallen.

Mit den zwei Banken des bestehenden Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse / ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z. B.

hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Weitere wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

Entschädigungsvereinbarungen o.Ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können mit Ausnahme des Schuldscheindarlehens im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende Change-of-Control-Klauseln nicht wegfallen.

## **ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄSS § 289A HGB**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum vom 11. März 2011 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach §289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.suss.com/de/investor-relations/corporate-governance/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html> veröffentlicht.

## **NACHTRAGSBERICHT**

### **AKTUELLE EREIGNISSE NACH DEM STICHTAG**

Am 11. März 2011 wurde Japan von einem schweren Erdbeben und einer Tsunami-Welle getroffen. Die Infrastruktur und zahlreiche Produktionsstandorte in Japan wurden

teilweise massiv geschädigt. Zudem wird Japan von weiteren Nachbeben und den negativen Folgen einer atomaren Katastrophe bedroht. Die wirtschaftlichen Folgen, die sich daraus für die Weltwirtschaft im Jahr 2011 ergeben werden, sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

SÜSS MicroTec erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 5 % seiner Umsätze mit japanischen Kunden. Für 2011 gehen wir von einem Umsatzanteil von 5 bis 7 % in der Region Japan aus. Es ist denkbar, dass sich die Naturkatastrophe in Japan in diesem Maße auf die Erreichung unserer Ziele für 2011 (Umsatz, Auftragseingang) auswirken könnte. Möglicherweise ist auch unsere Lieferkette von den wirtschaftlichen Auswirkungen in Japan betroffen, obwohl SÜSS MicroTec selbst nur einige unmittelbare Lieferbeziehungen mit japanischen Herstellern unterhält. Eine Bezifferung der denkbaren Auswirkungen ist jedoch zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich.

#### STIMMRECHTSMITTEILUNGEN NACH DEM STICHTAG

Am 13. Januar 2011 hat uns die Süssvest SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte).

Am 13. Januar 2011 hat uns die Stichting Vest, Amsterdam, Niederlande, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte). Davon sind der Stichting Vest 2,3078 % (432.049 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Am 13. Januar 2011 hat uns die Crest Capital S.A., Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte). Davon sind der Crest Capital S.A. 2,3078 % (432.049 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Am 1. Februar 2011 hat uns die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 1. Februar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,94 % beträgt (550.000 Stimmrechte).

Die Credit Suisse Fund Management S.A, Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. März 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. Februar 2011 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,35 % beträgt (627.435 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,99 % (185.380 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

## RISIKOBERICHT

### RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

#### Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikofrüherkennungs-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

#### **Risikoidentifikation**

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

#### **Risikobewertung**

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12 bzw. 24 Monate.

Risiken werden für das Unternehmen als „wesentlich“ eingestuft, wenn sie bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von mehr als 50 % eine Schadenshöhe von 0,5 Mio. € erreichen oder übertreffen.

#### **Risikohandhabung**

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

#### **Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB**

Das Risikomanagement-System im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelungskonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Wirksamkeit des internen Kontroll- und Risikofrüherkennungssystems wird im Rahmen der Abschlussprüfung zum Jahresende durch den Abschlussprüfer überprüft. Dabei werden ausgewählte interne Kontrollen untersucht und deren Effektivität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte der eingesetzten IT-Systeme geprüft. Eine absolute Sicherheit kann jedoch auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Bei den deutschen Gesellschaften wurde bereits 2008 SAP eingeführt. Im aktuellen Geschäftsjahr wurde SAP bei der SÜSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (Taiwan), implementiert. Weitere Tochtergesellschaften werden im nächsten Jahr folgen. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssoftware „MIS Package“. Die Einzelabschlüsse werden schließlich in ein zentrales Konsolidierungssystem eingelesen. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurückberichtet. Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

## ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN UND BRANCHENRISIKEN

### Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Unser Geschäftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Die Weltwirtschaft hat sich 2010 nach der vorangegangenen tiefen Rezession schneller erholt, als noch vor einem Jahr erwartet. Insbesondere im 1. Halbjahr 2010 ist das Welt-Bruttoinlandsprodukt kräftig gewachsen. Die wirtschaftliche Dynamik war dabei insbesondere von den Schwellenländern geprägt, die von der Finanzkrise nicht oder deutlich weniger stark betroffen waren, sodass sie schnell zu alten Wachstumsraten zurückfanden. Impulse kamen außerdem von der zum Teil sehr expansiven Geld- und Fiskalpolitik einiger Länder sowie vom kräftig anziehenden Welthandel, von dem insbesondere die deutsche Wirtschaft stark profitieren konnte. Im weiteren Jahresverlauf hat sich der konjunkturelle Aufschwung in vielen Ländern allerdings verlangsamt. In Summe dürfte die Weltwirtschaft 2010 – nach einem Rückgang um 1% im Jahr zuvor – mit einer Rate von etwa 3,7% gewachsen sein.

Das verbesserte gesamtwirtschaftliche Umfeld hat sich auf die Auftragslage und die Umsatz- und Ergebnisentwicklung aller unserer Produkte sehr positiv ausgewirkt. Insbesondere die steigende Nachfrage nach unseren Produkten in Taiwan und China trug entscheidend zu dem erzielten Umsatz- und Ergebnisanstieg bei.

### Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Diesen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

**Marktpositionierung**

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

**Abhängigkeit von einzelnen Know-how-Trägern**

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

**BETRIEBLICHE RISIKEN****Vermögens- und Ertragslage**

Angesichts der äußerst positiven Entwicklung des Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, überschaubar. Der Break-even-Umsatz liegt aktuell deutlich unter dem 2010 erwirtschafteten Umsatz. Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2010 vorhandenen Auftragsbestands werden wir auch 2011 einen Umsatz deutlich über dem Break-even-Umsatz erwirtschaften.

Zum 31. Dezember 2010 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 13,6 Mio. € aus, der ausschließlich dem Bereich Lithografie zuzuordnen ist. Der Bereich Lithografie erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und trägt ganz wesentlich zu einem positiven Konzernergebnis bei. Wir erwarten auch für 2011 weiter steigende Umsätze und ein nachhaltig positives Ergebnis im Segment Lithografie und sehen daher keine Anzeichen für Wertminderungen in diesem Bereich.

**Preisdruck**

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise

nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

**Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken**

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

**Änderungen der Konzernstruktur**

Im Februar 2010 hat die SÜSS MicroTec AG die HamaTech APE GmbH & Co. KG übernommen. Akquisitionen sind von sich aus riskant, da sie Risiken aus der Integration von Mitarbeitern, Prozessen, Technologien und Produkten beinhalten. Grundsätzlich besteht das unternehmerische Risiko, dass sich das erworbene Unternehmen wirtschaftlich nicht wie erwartet im Markt entwickelt und die mit seinem Erwerb verfolgten Umsatz- und Ertragsziele nicht erreicht oder dass die beabsichtigten Synergieeffekte nicht erzielt werden können. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2010 sowie die äußerst positive Auftragslage der HamaTech APE GmbH & Co. KG zeigen jedoch, dass unsere Erwartungen erfüllt wurden und die Integration der HamaTech in die SÜSS-Gruppe sehr erfolgreich umgesetzt wurde.

**Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs nach Deutschland**

Im Zusammenhang mit der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs und der nordamerikanischen Vertriebs- und Serviceorganisation von Waterbury / Vermont (USA) nach Sternenfels bzw. Kalifornien wurden folgende mögliche Risiken identifiziert:

Für eine erfolgreiche Verlagerung und Fortführung des Substrat-Bonder-Bereichs ist SÜSS MicroTec darauf angewiesen, dass das bei den nordamerikanischen Mitarbeitern vorhandene Know-how bewahrt und auf die zukünftig in

Sternenfels bzw. Kalifornien tätigen Mitarbeiter übertragen wird. Voraussetzung für einen adäquaten Wissenstransfer ist zum einen, dass ein großer Teil der Mitarbeiter, die bisher in Waterbury beschäftigt sind, zumindest bis Jahresende 2010 bzw. bis zum Ende des ersten Quartals 2011 bei SÜSS MicroTec verbleiben. Zum anderen beschäftigt SÜSS MicroTec gezielt ausgewählte Mitarbeiter aus Waterbury temporär über das Jahresende 2010 hinaus weiter in Sternenfels, um so möglichst viel Know-how abzugreifen. Der SÜSS MicroTec-Konzern sieht das Risiko, dass dieser Know-how-Transfer nicht in ausreichendem Maß stattfinden könnte. Einerseits könnten Mitarbeiter der Süss MicroTec Inc. bereits vorzeitig das Unternehmen verlassen und würden damit für einen Wissenstransfer nicht mehr zur Verfügung stehen. Andererseits könnte bei den ausgewählten Mitarbeitern der Süss MicroTec Inc. in Waterbury keine ausreichende Bereitschaft bestehen, temporär nach Sternenfels bzw. Kalifornien umzusiedeln, um bei der Weitergabe des Know-hows aktiv zu unterstützen. Um dieses Risiko zu minimieren, wurden Teams aus Deutschland zusammengestellt, die über mehrere Monate in Waterbury tätig waren, um den Know-how-Transfer zu begleiten und um sich möglichst viel der vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen anzueignen.

Gleichzeitig wurden den ausgewählten Mitarbeitern in Waterbury attraktive Angebote unterbreitet, um Anreize zu schaffen und die Bereitschaft zu fördern, bis zur endgültigen Schließung des Standortes Waterbury bei SÜSS MicroTec zu bleiben bzw. (temporär) nach Sternenfels überzusiedeln und auch über das Jahr 2010 hinaus bei der Neuorganisation und dem Ausbau des Substrat-Bonder-Segments mitzuarbeiten. Im Januar 2011 sind zehn Mitarbeiter aus Waterbury für einen Zeitraum von 6 bis 15 Monaten nach Sternenfels übersiedelt, um die Neuorganisation des Substrat-Bonder-Bereichs in Deutschland mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen aktiv zu unterstützen.

Der SÜSS MicroTec Konzern hat (per Ad-hoc-Mitteilung vom 10. Juni 2010) frühzeitig über die Details und den Zeitplan der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs und der nordamerikanischen Vertriebs- und Serviceorganisation informiert. Es könnte das Risiko auftreten, dass Kunden durch diese Pläne verunsichert werden und bei einer erneuten Auftragsvergabe Zurückhaltung üben werden. Diesem Risiko begegnet SÜSS MicroTec mit einer offenen und transparenten Kommunikation gegenüber den Kunden, die damit über alle anstehenden Maßnahmen und

deren Auswirkungen informiert werden. Gleichzeitig wurden sowohl das aus Deutschland bereitgestellte Transfer-Team als auch die noch in Waterbury tätigen Mitarbeiter auf dieses Risiko aufmerksam gemacht und sensibilisiert. Darüber hinaus zeigen die gerade umgesetzten Investitionen und Maßnahmen, die einen erheblichen Umfang aufweisen, dass SÜSS MicroTec in den nächsten Monaten und Jahren deutliche Zuwächse im Bereich Substrat Bonder erwartet und ein großes Interesse daran hat, bestehende Kunden zu halten und neue Kunden zu gewinnen. Bisher sind weder Stornierungen noch Verzögerungen bei den Auftragseingängen im Segment Substrat Bonder zu verzeichnen. Stattdessen haben sogar einige Kunden die eingeleitete Verlagerung begrüßt, da sie durch die geplanten Maßnahmen von einer Stärkung der Lieferbeziehungen zu SÜSS MicroTec ausgehen. Damit ist dieses Risiko als eher gering einzuschätzen.

Auch nach der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs von Waterbury nach Sternenfels plant SÜSS MicroTec, die bestehenden Lieferantenbeziehungen (vorwiegend zu US-Lieferanten) – aufgrund der positiven Erfahrungen in der Vergangenheit – aufrechtzuerhalten. Es besteht das Risiko, dass die Lieferkette – angesichts der geographischen Entfernung und grenzüberschreitender Unterschiede – gestört werden könnte. Verzögerungen bei der Auftragsbearbeitung und in der Produktion könnten die Folge sein. SÜSS MicroTec wirkt dem entgegen, indem die nordamerikanischen Lieferanten laufend über alle Schritte des Umzugs informiert werden und aktiv in den Prozess der Verlagerung eingebunden werden. Gleichzeitig bietet SÜSS MicroTec den Lieferanten Unterstützung bei der Abwicklung von Exportgeschäften und grenzüberschreitender Formalitäten.

## FINANZMARKTRISIKEN

### Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebsseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und

länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sog. „Risk Countries“ angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sog. „Non Risk Countries“ ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 16,4 Mio. € (Vorjahr: 15,2 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 6,8 Mio. € (Vorjahr: 11,9 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2010 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar (in T€):

<b>Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung</b>		
in T€	2010	2009
1 – 30 Tage	2.164	1.134
31 – 60 Tage	1.645	652
61 – 90 Tage	2.211	541
<b>Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung</b>	<b>6.020</b>	<b>2.327</b>

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 3,6 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt (in T€):

<b>Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigung</b>		
in T€	2010	2009
91 – 180 Tage	1.802	579
181 – 360 Tage	1.239	210
> 360 Tage	557	224
<b>Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung</b>	<b>3.598</b>	<b>1.013</b>

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

#### Liquiditätsrisiken

Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec-Konzern einen Net-Cash-Bestand von 34,6 Mio. € aus (Vorjahr: 18,4 Mio. €). Der Free Cashflow belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 14,1 Mio. € (Vorjahr: 8,9 Mio. €). Aufgrund der aktuell sehr positiven Finanz- und Ertragslage und der positiven Planung für das Jahr 2011 wird SÜSS MicroTec die geltenden Covenants aus dem bestehenden Schuldscheindarlehen, das in 2007 in Höhe von 9 Mio. € gegeben wurde, auch im Jahr 2011 einhalten können.

Derzeit stellen zwei Banken im Rahmen eines Bankenkonsortiums eine Kreditlinie von 6,0 Mio. €, die zunächst bis zum 31. März 2011 befristet ist. Darüber hinaus besteht eine Avallinie in Höhe von 2,5 Mio. € bei einer Versicherungsgesellschaft. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € steht der HamaTech APE GmbH & Co. KG zur Verfügung. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Sollte es nicht gelingen, die Kreditlinie des Bankenkonsortiums über den 31. März 2011 hinaus zu verlängern, müssten wir zukünftig bei einzelnen Kunden, die auf solche Bürgschaften bestehen, auf Anzahlungen verzichten. Dies wiederum würde die vollständige Vorfinanzierung von Kundenaufträgen bedingen sowie die Wahrscheinlichkeit für Stornierungen von Aufträgen erhöhen.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (24) des Konzernanhangs.

#### Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.



SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungsicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Darüber hinaus wird ein Sockelbetrag auf eine Laufzeit von zwölf Monaten gesichert. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (29).

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer 10%igen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von T€ 501 (Vorjahr: T€ 421) und einer entsprechenden Verminderung des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag (in T€):

in T€	2010		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.573	374	5.947
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.694	1.344	5.038
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-683	-58	-741
Kundenanzahlungen	-4.729	0	-4.729
<b>Netto-Exposure</b>	<b>3.855</b>	<b>1.660</b>	<b>5.515</b>
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	-350	-151	-501

in T€	2009		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.450	703	2.153
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.887	1.680	4.567
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-678	-111	-789
Kundenanzahlungen	-1.303	0	-1.303
<b>Netto-Exposure</b>	<b>2.356</b>	<b>2.272</b>	<b>4.628</b>
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	-214	-207	-421

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf die im Geschäftsjahr 2007 platzierten variablen Teile des Schuldscheindarlehens laufzeitkongruente Zinsswaps gelegt wurden. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht. Auch das variabel verzinsten Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Sternenfels wurde mit einem laufzeitkongruenten Zinsswap gesichert.

Alle weiteren wesentlichen Finanzschulden von SÜSS basieren auf Darlehensverträgen mit festen Zinssätzen und unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko.

#### Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2010 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

## PROGNOSEBERICHT

Das Jahr 2010 hat sich deutlich besser entwickelt, als es am Anfang des Jahres erwartet worden war. Die bislang beobachteten Folgen der Krise für Deutschland sind geringer als für andere Industrieländer. Damit stehen die Chancen für Deutschlands Unternehmen gut, an die Entwicklung vor der Krise anzuknüpfen. Nicht vergessen werden darf jedoch, dass zum einen die realwirtschaftlichen Krisenfolgen immer noch beträchtlich sind und dass sich das weltwirtschaftliche Umfeld nach wie vor in unsicherem Fahrwasser bewegt. In ihrer Jahresprojektion für 2011 rechnet die Bundesregierung mit einer Fortsetzung des Aufschwungs und einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 2,0 %. Für die gesamte Weltwirtschaft rechnet man für 2011 sogar mit einem Wachstum von rund 2,8 %.

Auch SÜSS MicroTec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr im Auftragseingang und auch im Umsatz einen deutlichen konjunktur- und branchenbedingten Aufschwung erlebt. Die angestiegene Nachfrage nach Halbleiter-Equipment wurde nicht zuletzt auch durch die positive Stimmung auf den Weltmärkten weiter angetrieben. Vor dem Hintergrund der allgemein positiven Erwartungshaltung seitens der Markt- und Branchenbeobachter, aber dennoch unter Beachtung der weiterhin angespannten Stimmung an den Finanzmärkten geht SÜSS MicroTec für das Jahr 2011 von einer positiven Auftragseingangs-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus.

In diesem Prognosebericht gehen wir kurz erläuternd auf die exogenen und endogenen Faktoren ein, die wir ebenso wie führende Branchenbeobachter als maßgeblich für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens ansehen.

## HALBLEITERINDUSTRIE

Die weltweite Erholung der Wirtschaft spiegelt sich auch in der rapide angestiegenen Nachfrage nach Halbleiterprodukten wider. Die Branche konnte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 % zulegen und liegt damit bei einem Umsatzvolumen von rund 304 Mrd. \$. Insgesamt fiel auch hier die Jahresentwicklung erheblich besser aus, als zu Beginn des Jahres erwartet worden war.

Für 2011 geht das Marktforschungsinstitut iSuppli von einem weiteren weltweiten Umsatzwachstum gegenüber

dem Vorjahr, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau, aus. Es wird erwartet, dass der Markt mit etwa 5 % gegenüber dem Vorjahr wächst und somit Ende 2011 ein Gesamtvolumen von etwa 320 Mrd. \$ erreichen kann. Als Grund für das verlangsamte Wachstum wurde der Wegfall der Multiplikatoren aus 2010 genannt, gemeint sind unter anderem der in 2010 erfolgte Lageraufbau und der „positive“ Preisdruck aufgrund der sprunghaft angestiegenen Nachfrage.

## HALBLEITER-EQUIPMENT-INDUSTRIE

Laut dem Marktforschungsinstitut Gartner verzeichnete die Halbleiter-Equipment-Industrie 2010 ein Marktwachstum von mehr als 130 %. Diese rapide Entwicklung, die zu einem Großteil den sehr schwachen Investitionen 2009 geschuldet ist, wird sich erwartungsgemäß in 2011 nicht fortsetzen. Für 2011 wird ein eher stagnierender Markt für Halbleiter-Equipment-Hersteller erwartet. Für den Spezialbereich Verpackung und Montage erwartet Gartner jedoch ein weiteres Marktwachstum in Höhe von rund 7 %.

## ERWARTETE ENTWICKLUNG IN DEN HAUPTMÄRKTEN

### Markt für Mikrosystemtechnik

Der Markt für Mikrosystemtechnik (MEMS) hat nach einem Jahr ohne nennenswertes Wachstum wieder deutlich an Dynamik gewonnen, insbesondere die Bereiche Konsumelektronik, Mobilfunk und Automobilelektronik haben dieses Wachstum getrieben. 2010 hat das Marktwachstum nach Aussage von iSuppli rund 18 % erreicht. Das erwartete durchschnittliche MEMS-Wachstum soll von 2011 bis 2014 bei rund 10 % pro Jahr liegen.

Als Grund für das erwartete Wachstum sind vor allem die Bereiche Konsumelektronik, Mobilfunk und zukünftig auch verstärkt die sogenannten Tablet Computer zu nennen. iSuppli erwartet für die Bereiche Konsumelektronik und Mobilfunk 2011 ein Wachstum von mehr als 25 %, ähnlich der Wachstumsrate des Jahres 2010. Ein weiterer Wachstumsmarkt sind Industrieanwendungen, auch hier wird zukünftig der Einsatz von MEMS-Sensoren bei der Prozesssteuerung und Automatisierung eine bedeutende Rolle spielen. In einigen derzeit noch recht kleinen Anwendungsbereichen, wie zum Beispiel der Medizintechnik oder der Energiewirtschaft, werden zukünftig gerade im



## ENDOGENE INDIKATOREN

Neben dem Zustand der Märkte ist für unseren Erfolg auch das Innovationspotenzial unseres Produktangebotes entscheidend. Das Unternehmen ist auch im Geschäftsjahr 2010 weitere Entwicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus Industrie und Forschung eingegangen. So wurde erst im Dezember eine Kooperation mit der Rolith Inc. abgeschlossen, bei der es um die Entwicklung neuartiger Nanolithografie-Technologien geht. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST hat SÜSS MicroTec „SELECT“ in den Markt eingeführt, es handelt sich hierbei um eine Technologieerweiterung für Bond Aligner und Mask Aligner, die eine selektive Plasmaaktivierung von Wafer-Oberflächen ermöglicht. Darüber hinaus erhofft sich SÜSS MicroTec durch die Zusammenführung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Sternenfels weitere Innovations- und Wachstumsimpulse.

## GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DES KONZERNES

Die Weltwirtschaft hat die Krise in dem Jahr 2010 endgültig überwunden und hat eine deutliche konjunkturelle Belebung erlebt. Die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten haben der Nachfrageentwicklung bislang nichts anhaben können. Allerdings bestimmen die Sorgen um die stark gestiegenen Schulden der Industrieländer und die damit einhergehenden Zweifel an der Zahlungsfähigkeit, insbesondere einiger Länder im Euroraum, häufig das Denken und Handeln in Politik und Wirtschaft. Vor dem Hintergrund einer allgemein positiven Stimmung an den Weltmärkten, aber unter Beachtung der nicht unerheblichen Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft des europäischen Wirtschaftsraums sehen unsere Prognosen im Vergleich zum Vorjahr optimistisch aus. Abgesehen von den makroökonomischen Gegebenheiten, sehen wir, dass die Trends, die das Geschäft von SÜSS MicroTec treiben, weiterhin intakt sind.

Für 2011 rechnet Gartner mit einem eher stagnierenden Markt für Halbleiter-Equipment-Hersteller. Für den Spezialbereich Verpackung und Montage erwartet Gartner jedoch ein Marktwachstum von rund 7%.

Insgesamt rechnen wir für das Geschäftsjahr 2011 mit einem Umsatz von mehr als 170 Mio. € und einer gegenüber 2010 erneut verbesserten EBIT-Marge. Der freie Cashflow kann aus heutiger Sicht einen zweistelligen Millionenbetrag erreichen.

Entwickeln sich die von uns adressierten Märkte in der oben beschriebenen Form und gelingt es dem SÜSS MicroTec-Konzern, seine Produktpalette weiterhin konsequent an den Marktbedürfnissen auszurichten, gehen wir auch für 2012 von steigenden Auftragseingängen und Umsätzen aus. Je nach Umsatzwachstum erscheint das Erreichen einer EBIT-Marge zwischen 10% und 15% möglich. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

## VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Dieser Geschäftsbericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 18. März 2011

Der Vorstand

Frank Averdung  
Vorstandsvorsitzender

Michael Knopp  
Finanzvorstand

# KONZERNABSCHLUSS

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2010

## **74 KONZERNABSCHLUSS NACH IFRS**

- 74 Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung (IFRS)
- 75 Gesamtergebnisrechnung (IFRS)
- 76 Konzernbilanz (IFRS)
- 78 Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)
- 80 Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS)
- 82 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2010
- 84 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2009
- 86 Segmentberichterstattung

## **88 KONZERNANHANG**

- 101 Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung
- 108 Erläuterungen zu den AKTIVA
- 111 Erläuterungen zu den PASSIVA
- 113 Aktienoptionspläne der SÜSS MicroTec AG
- 124 Sonstige Angaben

## **138 VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER**

## **139 BESTÄTIGUNGSVERMERK**

# KONZERNABSCHLUSS

## KONZERN-GEWINN-UND-VERLUSTRECHNUNG (IFRS)

in T€	Anhang	01.01.2010 – 31.12.2010	01.01.2009 – 31.12.2009
Umsatzerlöse	(3)	139.085	103.901
Umsatzkosten	(4)	-88.000	-65.058
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>		<b>51.085</b>	<b>38.843</b>
Vertriebskosten		-17.408	-16.674
Forschungs- und Entwicklungskosten		-6.824	-4.871
Verwaltungskosten		-17.826	-13.939
Sonstige betriebliche Erträge	(5)	9.996	2.941
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-4.709	-3.520
<b>Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT):</b>			
EBITDA		20.515	7.567
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(10)	-6.201	-4.787
<b>Operatives Ergebnis (EBIT)</b>		<b>14.314</b>	<b>2.780</b>
Finanzergebnis	(7)	-286	-139
<b>Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern</b>		<b>14.028</b>	<b>2.641</b>
Ertragsteuern	(8)	-993	-2.105
<b>Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten</b>		<b>13.035</b>	<b>536</b>
<b>Gewinn / Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern)</b>	(2f)	<b>332</b>	<b>-5.393</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>		<b>13.367</b>	<b>-4.857</b>
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		13.230	-4.811
Davon Minderheitsanteile		137	-46
<b>Ergebnis je Aktie (unverwässert)</b>	(9)		
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten in €		0,71	0,03
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		0,02	-0,31
<b>Ergebnis je Aktie (verwässert)</b>	(9)		
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten in €		0,70	0,03
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		0,02	-0,31

## GESAMTERGEBNISRECHNUNG (IFRS)

in T€	01.01.2010 – 31.12.2010	01.01.2009 – 31.12.2009
<b>Periodenergebnis</b>	<b>13.367</b>	<b>-4.857</b>
Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere	-19	379
Fremdwährungsanpassung	320	-80
Absicherung künftiger Zahlungsströme	101	-202
Effekt aus Entkonsolidierung Süss MicroTec Test Systems	-253	0
Latente Steuern	-5	-49
<b>Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen</b>	<b>144</b>	<b>48</b>
<b>Summe der in der Periode erfassten Erträge und Aufwendungen</b>	<b>13.511</b>	<b>-4.809</b>
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre	13.314	-4.763
Davon Minderheitsanteile	197	-46

## KONZERNBILANZ (IFRS)

AKTIVA in T€	Anhang	31.12.2010	31.12.2009
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		<b>44.312</b>	<b>39.954</b>
Immaterielle Vermögenswerte	(11)	11.891	13.837
Geschäfts- oder Firmenwert	(12)	13.599	13.599
Sachanlagen	(13)	9.356	4.081
Steuererstattungsansprüche	(19)	108	121
Sonstige Vermögenswerte	(14)	485	554
Latente Steueransprüche	(8)	8.873	7.762
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		<b>137.248</b>	<b>96.480</b>
Vorräte	(15)	64.431	40.790
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(16)	15.659	14.842
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(17)	640	355
Wertpapiere	(18)	15.977	10.489
Steuererstattungsansprüche	(19)	620	265
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		36.525	20.621
Sonstige Vermögenswerte	(20)	3.396	1.595
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte		0	7.523
<b>BILANZSUMME</b>		<b>181.560</b>	<b>136.434</b>



<b>PASSIVA</b> in T€	Anhang	31.12.2010	31.12.2009
<b>EIGENKAPITAL</b>		<b>106.404</b>	<b>86.060</b>
Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG		106.006	85.859
Gezeichnetes Kapital	(21)	18.721	17.019
Rücklagen	(21)	87.944	69.583
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(21)	-659	-743
Minderheitsanteile		398	201
<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>		<b>20.775</b>	<b>19.988</b>
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(22)	2.919	3.003
Rückstellungen	(23)	508	711
Finanzschulden	(24)	14.367	10.962
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		240	67
Latente Steuerschulden	(8)	2.741	5.245
<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>		<b>54.381</b>	<b>30.386</b>
Rückstellungen	(25)	4.613	1.772
Steuerschulden	(28)	5.412	595
Finanzschulden	(24)	1.119	1.747
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(26)	6.458	4.536
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.746	4.458
Sonstige Verbindlichkeiten	(27)	27.033	14.906
Zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten		0	2.372
<b>BILANZSUMME</b>		<b>181.560</b>	<b>136.434</b>

## KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS)

in T€	01.01.2010 – 31.12.2010	01.01.2009 – 31.12.2009
Gewinn /Verlust (nach Steuern)	13.367	-4.857
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	4.225	4.052
Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert	0	4.168
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.990	1.506
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	237	14
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	-484	448
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	301	-555
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplänen	187	252
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-29	-629
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-2.854	432
Badwill aus dem Erwerb HamaTech	-2.678	0
Entkonsolidierungserfolg aus dem Verkauf von Suss MicroTec Test Systems	-1.641	0
Veränderung des Vorratsvermögens	-16.544	8.297
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.039	6.638
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	-2.230	609
Veränderung der Pensionsrückstellungen	31	-23
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.446	-139
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	20.150	-9.204
Veränderung der latenten Steuern	-3.419	1.092
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>16.094</b>	<b>12.101</b>
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>16.094</b>	<b>11.999</b>

in T€	01.01.2010 – 31.12.2010	01.01.2009 – 31.12.2009
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-2.597	-417
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-391	-2.831
Auszahlungen für den Erwerb von kurzfristigen zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	-6.059	-6.730
Einzahlungen aus Einlösung von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	3.000	0
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	201	12
Auszahlungen für den Erwerb HamaTech	-8.031	0
Einzahlungen aus dem Verkauf des Test-Business	3.315	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>-10.562</b>	<b>-9.966</b>
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>-10.562</b>	<b>-9.843</b>
Aufnahme von Bankdarlehen	4.500	0
Tilgung von Bankdarlehen	0	-79
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-808	-4.601
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-915	2.613
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung	6.808	0
Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhung	-227	0
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>9.358</b>	<b>-2.067</b>
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>9.358</b>	<b>-2.067</b>
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	836	128
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>15.726</b>	<b>196</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang*</b>	<b>20.799</b>	<b>20.603</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode</b>	<b>36.525</b>	<b>20.799</b>
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	742	722
Zinseinnahmen während der Periode	588	978
Steuerzahlungen während der Periode	391	796
Steuererstattungen während der Periode	151	-42

\* Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2010 beinhaltet auch die flüssigen Mittel der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte und der nicht fortgeführten Aktivitäten (178 T€).

## KONZERNEIGENKAPITAL-VERÄNDERUNGSRECHNUNG (IFRS)

in T€	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage
<b>Stand 01.01.2009</b>	17.019	92.842
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		252
Periodenergebnis		
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen		
<b>Stand 31.12.2009</b>	17.019	93.094
<b>Stand 01.01.2010</b>	17.019	93.094
Kapitalerhöhung	1.702	4.944
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		187
Periodenergebnis		
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen		
<b>Stand 31.12.2010</b>	18.721	98.225

	Gewinnrücklage	Bilanzgewinn / -verlust	Kumuliertes übriges Eigenkapital	Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG	Minderheitsanteile	Eigenkapital
	433	-19.133	-791	90.370	247	90.617
				252		252
		-4.811		-4.811	-46	-4.857
			48	48	0	48
	433	-23.944	-743	85.859	201	86.060
	433	-23.944	-743	85.859	201	86.060
				6.646		6.646
				187		187
		13.230		13.230	137	13.367
			84	84	60	144
	433	-10.714	-659	106.006	398	106.404

## ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS

### Anlagespiegel 2010

in T€	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					
	01.01.10	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Zugang aus dem Erwerb HamaTech	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang
<b>I. Immaterielle Vermögenswerte</b>						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.560	83	235	386	0	0
2. Entwicklungskosten	31.370	914	157	0	0	3.989
3. Aktivierte Leasinggegenstände						
Software	3.138	40	0	0	0	0
4. Andere immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	960	0	0
	<b>49.068</b>	<b>1.037</b>	<b>392</b>	<b>1.346</b>	<b>0</b>	<b>3.989</b>
<b>II. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>32.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	3.749	290	301	4.469	68	1.682
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.277	1.002	944	1	135	277
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.743	333	1.269	377	-203	1.072
4. Fahrzeuge	464	12	8	0	0	7
5. Anlagen im Bau	0	0	67	0	0	
6. Aktivierte Leasinggegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	423	35	0	0	-458	0
Technische Anlagen und Maschinen	338	52	0	0	455	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	759	7	0	0	0	0
	<b>25.753</b>	<b>1.731</b>	<b>7.058</b>	<b>378</b>	<b>-3</b>	<b>3.038</b>
<b>IV. Finanzanlagen</b>						
Sonstige Finanzanlagen	2.263	0	0	0	0	0
	<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kumulierte Abschreibungen							Restbuchwerte		
31.12.10	01.01.10	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.10	31.12.09	31.12.10	
15.264	12.768	48	543	0	0	13.359	1.792	1.905	
28.452	22.060	425	2.383	0	3.999	20.869	9.310	7.583	
3.178	403	40	887	0	0	1.330	2.735	1.848	
960	0	0	405	0	0	405	0	555	
<b>47.854</b>	<b>35.231</b>	<b>513</b>	<b>4.218</b>	<b>0</b>	<b>3.999</b>	<b>35.963</b>	<b>13.837</b>	<b>11.891</b>	
32.436	18.837	0	0	0	0	18.837	13.599	13.599	
7.195	3.129	229	312	0	1.526	2.144	620	5.051	
12.082	8.780	843	892	0	173	10.342	1.497	1.740	
10.447	8.004	279	712	0	872	8.123	1.739	2.324	
477	415	8	9	0	5	427	49	50	
67	0	0	0	0	0	0	0	67	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	330	27	0	-357	0	0	93	0	
845	267	53	54	355	0	729	71	116	
766	747	7	4	0	0	758	12	8	
<b>31.879</b>	<b>21.672</b>	<b>1.446</b>	<b>1.983</b>	<b>-2</b>	<b>2.576</b>	<b>22.523</b>	<b>4.081</b>	<b>9.356</b>	
2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0	
<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS

## Anlagespiegel 2009

in T€	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					
	01.01.09	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Umklassi- fizierung in „Held for sale“	Abgang
<b>I. Immaterielle Vermögenswerte</b>						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.970	-29	1.242	14	3.931	3.706
2. Entwicklungskosten	30.959	-335	1.589	0	843	0
3. Aktivierte Leasinggegenstände						
Software	191	-10	2.957	0	0	0
	<b>52.120</b>	<b>-374</b>	<b>5.788</b>	<b>14</b>	<b>4.774</b>	<b>3.706</b>
<b>II. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>36.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.168</b>	<b>0</b>
<b>III. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	3.903	-87	73	76	200	16
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.168	-218	135	509	273	44
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.154	-90	157	46	1.548	976
4. Fahrzeuge	516	-4	0	0	6	42
5. Anlagen im Bau	138	-2	0	-136	0	0
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	436	-13	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	815	-20	52	-509	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	761	-2	0	0	0	0
	<b>28.891</b>	<b>-436</b>	<b>417</b>	<b>-14</b>	<b>2.027</b>	<b>1.078</b>
<b>IV. Finanzanlagen</b>						
1. Sonstige Beteiligungen	2.095	0	0	-2.095	0	0
2. Sonstige Finanzanlagen	173	0	0	2.095	5	0
	<b>2.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

\* Die Zugänge zu den kumulierten Abschreibungen entfallen in Höhe von T€ 4.787 auf fortgeführte und in Höhe von T€ 4.939 auf nicht fortgeführte Aktivitäten. Die Zugänge zu den kumulierten Abschreibungen bei den nicht fortgeführten Aktivitäten enthalten Abschreibungen wegen Wertminderungen in Höhe von T€ 4.690.



Kumulierte Abschreibungen							Restbuchwerte		
31.12.09	01.01.09	Währungs differenz	Zugang*	Umbuchungen / Umgliederungen	Umklassi- fizierung in „Held for sale“	Abgang	31.12.09	31.12.08	31.12.09
14.560	16.202	-16	1.386	0	3.931	873	12.768	4.768	1.792
31.370	20.614	-155	2.444	0	843	0	22.060	10.345	9.310
3.138	191	-10	222	0	0	0	403	0	2.735
49.068	37.007	-181	4.052	0	4.774	873	35.231	15.113	13.837
32.436	18.837	0	4.168	0	4.168	0	18.837	17.767	13.599
3.749	3.198	-70	149	0	132	16	3.129	705	620
10.277	8.645	-216	400	267	273	43	8.780	1.523	1.497
9.743	9.640	-78	857	0	1.444	971	8.004	2.514	1.739
464	436	-2	11	0	6	24	415	80	49
0	0	0	0	0	0	0	0	138	0
423	271	-10	69	0	0	0	330	165	93
338	536	-17	15	-267	0	0	267	279	71
759	744	-2	5	0	0	0	747	17	12
25.753	23.470	-395	1.506	0	1.855	1.054	21.672	5.421	4.081
0	2.095	0	0	-2.095	0	0	0	0	0
2.263	168	0	0	2.095	0	0	2.263	5	0
2.263	2.263	0	0	0	0	0	2.263	5	0

## SEGMENTBERICHTERSTATTUNG (IFRS)

## Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern

in T€	Lithografie		Substrat Bonder		Fotomaschinen Equipment	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Außenumsatz	88.932	77.573	24.722	18.313	18.429	0
Innenumsatz	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamter Umsatz</b>	<b>88.932</b>	<b>77.573</b>	<b>24.722</b>	<b>18.313</b>	<b>18.429</b>	<b>0</b>
Segmentergebnis (EBIT)	16.952	11.742	-7.066	-3.848	2.113	0
Ergebnis vor Steuern	16.896	11.641	-7.072	-3.857	2.106	0
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-) / Erträge	-1.223	77	-1.212	-748	-173	0
Segmentvermögen	56.311	53.312	30.102	25.400	17.315	0
davon Geschäfts- oder Firmenwert	13.599	13.599	0	0	0	0
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen						
<b>Konzernaktiva</b>						
Segmentsschulden	-27.286	-15.646	-6.987	-5.686	-6.328	0
Nicht zugeordnete Konzernschulden						
<b>Konzernschulden</b>						
Abschreibungen	1.675	1.810	2.239	1.661	760	0
davon planmäßig	1.600	1.810	2.124	1.661	760	0
davon außerplanmäßig	75	0	115	0	0	0
Investitionen	1.450	722	501	1.062	2.178	0
Mitarbeiter zum 31.12.	324	325	141	119	91	0

## Segmentinformationen nach Regionen

in T€	Umsatzerlöse		Investitionen		Vermögen	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Europa	36.846	39.735	8.369	2.125	83.839	65.444
Nordamerika	19.582	24.152	662	1.088	27.523	26.111
Japan	7.964	12.010	59	19	1.975	2.656
Sonstiges Asien	76.468	44.381	84	16	1.414	784
Rest	0	27	0	0	0	0
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	185	-1.125
<b>Gesamt</b>	<b>140.860</b>	<b>120.305</b>	<b>9.174</b>	<b>3.248</b>	<b>114.936</b>	<b>93.870</b>

Sonstige		Fortgeführte Aktivitäten		Nicht fortgeführte Aktivitäten (Test-Business)		Konsolidierungseffekte		Summe	
2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
7.003	8.015	139.086	103.901	1.774	16.404	0	0	140.860	120.305
6.379	5.637	6.379	5.637	0	0	-6.379	-5.637	0	0
<b>13.382</b>	<b>13.652</b>	<b>145.465</b>	<b>109.538</b>	<b>1.774</b>	<b>16.404</b>	<b>-6.379</b>	<b>-5.637</b>	<b>140.860</b>	<b>120.305</b>
2.315	-5.114	14.314	2.780	331	-5.508	0	0	14.645	-2.728
2.098	-5.143	14.028	2.641	330	-5.503	0	0	14.358	-2.862
-197	592	-2.805	-79	-29	563	0	0	-2.834	484
11.208	8.584	114.936	87.296	0	6.574	0	0	114.936	93.870
0	0	13.599	13.599	0	0	0	0	13.599	13.599
								66.624	42.564
								<b>181.560</b>	<b>136.434</b>
<b>-3.291</b>	<b>-2.701</b>	<b>-43.892</b>	<b>-24.033</b>	<b>0</b>	<b>-2.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.892</b>	<b>-26.474</b>
								-31.265	-23.900
								<b>-75.157</b>	<b>-50.374</b>
1.527	1.316	6.201	4.787	14	4.939	0	0	6.215	9.726
1.527	1.316	6.011	4.787	14	249	0	0	6.025	5.036
0	0	190	0	0	4.690	0	0	190	4.690
5.045	1.341	9.174	3.125	0	123	0	0	9.174	3.248
60	54	616	498	0	116	0	0	616	614

# ANHANG

zum IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010

## (1) BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleißheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching und Sternenfels (bis Mai 2010 Vaihingen) in Deutschland sowie Waterbury und Palo Alto in den USA und Neuchâtel in der Schweiz. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbständige Vertriebsgesellschaften in Frankreich, Großbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, China und Korea. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

## (2) ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

### a) Grundlage der Darstellung

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTec AG um ein börsennotiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2010 werden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

### b) Nicht vorzeitig angewandte Standards und Interpretationen

Das IASB hat die nachfolgend dargestellten Standards, Interpretationen und Änderungen zu bestehenden Standards herausgegeben, deren Anwendung noch die Übernahme in EU-Recht („Endorsement“) erfordert:

#### IFRS 7: „Financial Instruments: Disclosures“

Am 7. Oktober 2010 veröffentlichte das IASB Änderungen des IFRS 7 „Financial Instruments: Disclosures“. Mit den Änderungen soll eine weitgehende Vereinheitlichung der korrespondierenden Angabepflichten nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) und den US generally accepted accounting principles (US-GAAP) erreicht werden. Die Änderungen an IFRS 7 betreffen erweiterte Angabepflichten bei der Übertragung finanzieller Vermögenswerte und sollen den Bilanzadressaten ein besseres Verständnis der Auswirkungen der beim Unternehmen verbleibenden Risiken ermöglichen.

IFRS 7 ist verpflichtend für Perioden anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

#### IFRS 9: „Financial Instruments“

Im November 2009 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 9 „Financial Instruments“ zur Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten. Dieser Standard ist der erste Teil des dreiteiligen Projekts zur vollständigen Ablösung von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“. Gemäß der Methodik von IFRS 9 sind finanzielle Vermögenswerte entweder zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Die Zuordnung zu einer der beiden Bewertungskategorien hängt davon ab, wie das Unternehmen seine Finanzinstrumente steuert (sog. Geschäftsmodell) und welche Produktmerkmale die einzelnen finanziellen Vermögenswerte haben.

Der Standard ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG kann derzeit noch nicht abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Standards haben wird, sofern der Standard von der EU in dieser Form übernommen wird.

Im Oktober 2010 veröffentlichte das IASB Vorschriften zur Bilanzierung finanzieller Verbindlichkeiten, die den IFRS 9 „Financial Instruments“ ergänzen und die Phase zur Klassifizierung und Bewertung des IASB-Projekts zur Ablösung von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ abschließen. Ergänzend zum IFRS 9 (2009) enthält der IFRS 9 (2010) Regelungen für die Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten sowie zur Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Ergänzung zu IFRS 9 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen. Eine frühere Anwendung ist nur zulässig, wenn gleichzeitig die in IFRS 9 (2009) für finanzielle Vermögenswerte enthaltenen Regelungen angewendet werden.

Die SÜSS MicroTec AG geht derzeit nicht davon aus, dass die Anwendung der Ergänzung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, einen wesentlichen Einfluss auf die Darstellung der Abschlüsse haben wird.

#### IAS 12: „Income Taxes“

Im Dezember 2010 veröffentlichte das IASB Änderungen des IAS 12 „Income Taxes“. Die Änderungen enthalten eine teilweise Klarstellung zur Behandlung temporärer steuerlicher Differenzen im Zusammenhang mit der Anwendung des Zeitwertmodells von IAS 40.

IAS 12 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2012 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

Das IASB hat eine Reihe weiterer Verlautbarungen in der Berichtsperiode veröffentlicht. Die Rechnungslegungsverlautbarungen, die noch nicht umgesetzt wurden, hatten keinen wesentlichen Einfluss auf den Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG.

Die nachfolgend dargestellten Standards, Interpretationen und Änderungen von Standards wurden bereits von der EU-Kommission in EU-Recht übernommen, sind jedoch im Geschäftsjahr 2010 noch nicht verpflichtend anzuwenden. Von einer vorzeitigen Anwendung der Standards wurde kein Gebrauch gemacht.

#### IAS 24 „Related Party Disclosures“

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 20. Juli 2010 wurde die Verordnung 632 / 2010 bekannt gemacht, mit der die vom IASB am 4. November 2009 veröffentlichten Änderungen des IAS 24 „Related Party Disclosures“ übernommen wurden. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen Vereinfachungen der Angabepflichten von Unternehmen, die staatlich kontrolliert oder bedeutend beeinflusst werden. Weiterhin wurde durch die Änderung des IAS 24 die Definition eines nahestehenden Unternehmens oder einer nahestehenden Person verdeutlicht.

Der geänderte Standard ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2011 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2011 keine Auswirkungen.

#### IFRIC 19 „Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments“

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 24. Juli 2010 wurde die Verordnung 662 / 2010 bekannt gemacht, mit der die vom IFRIC am 26. November 2009 unter dem Titel „Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente“ veröffentlichte Interpretation IFRIC 19 übernommen wurde. IFRIC 19 liefert Hinweise zur Bilanzierung von sogenannten debt for equity swaps und erläutert die Anforderungen der IFRS, wenn ein Unternehmen teilweise oder vollständig eine finanzielle Verbindlichkeit durch Ausgabe von Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten tilgt.

IFRIC 19 ist verpflichtend für Perioden anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2010 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2011 keine Auswirkungen.

#### IAS 32 „Financial Instruments: Presentation“

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 24. Dezember 2009 wurde die Verordnung 1293 / 2009 bekannt gemacht, mit der die am 8. Oktober 2009 vom IASB veröffentlichten Änderungen an IAS 32 übernommen wurden. Die Änderungen betreffen die Bilanzierung beim Emittenten von Bezugsrechten, Optionen und Optionsscheinen auf den Erwerb einer festen Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten, die in einer anderen Währung als der funktionalen Währung des Emittenten denominiert sind. Bisher wurden solche Fälle als derivative Verbindlichkeiten bilanziert. Solche Bezugsrechte, die zu einem festgelegten Währungsbetrag anteilig an die bestehenden Anteilseigner eines Unternehmens ausgegeben werden, sind nach der Neuregelung als Eigenkapital zu klassifizieren. Die Währung, auf die der Ausübungspreis lautet, ist dabei unbeachtlich.

Die Änderungen an IAS 32 sind erstmals verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Januar 2010 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2011 keine Auswirkungen.

#### c) Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des true and fair views sowie der fair presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zugrunde gelegt:

### Geschäfts- oder Firmenwert

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern wird einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (Triggering Events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating Units), die im SÜSS-Konzern den Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SÜSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag eines Segments auf der Basis des Nutzungswertes errechnet. Dieser Wert beruht grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

### Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswertes ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswertes zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal zehn Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt ist. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS-Gruppe nicht vor.

### Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

Grundstücke, Gebäude, Einbauten	10–40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4–5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3–5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwertes aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

#### Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

#### Vorräte

Die Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswertes.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

#### Finanzinstrumente

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.



Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option“ werden nicht genutzt.

#### Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie Kredite und Forderungen zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

#### Wertpapiere

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

#### Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monate haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

#### Aktienbasierte Vergütungen

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den bestehenden Aktienoptionsplänen gemäß IFRS 2. Der Zeitwert der ausgegebenen Aktienoptionen wird unter Berücksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die Ermittlung des Zeitwerts erfolgt dabei auf Grundlage des Black-Scholes-Modells.

#### Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert. Die Verpflichtungen werden mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (Planvermögen). Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden erst erfolgswirksam verrechnet, wenn sie außerhalb einer Bandbreite von 10 % des Verpflichtungsumfangs liegen. In diesem Fall werden sie über die künftige durchschnittliche Restdienstzeit der Belegschaft verteilt. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen werden als Bestandteil der jeweiligen Funktionskosten ausgewiesen.

#### Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrages zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

### Finanzschulden

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus einem Schuldscheindarlehen und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und aus dem Schuldscheindarlehen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

### Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

### Nicht fortgeführte Aktivitäten

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt.

### Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 mit dem Eigentums- bzw. Gefahrenübergang an den Kunden erfasst, wenn ein Preis vereinbart oder bestimmbar ist und von dessen Bezahlung ausgegangen werden kann.

Ist in Verträgen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und Endabnahme mit dem Kunden vereinbart, werden Umsatzerlöse erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

### Umsatzkosten

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

### Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

### Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf

temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

#### Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

#### Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder, sofern es sich um einen Cashflow Hedge handelt, nach der Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

#### Cashflow Hedges

Der effektive Teil der Marktwertänderungen derivativer Instrumente, die als Cashflow Hedges bestimmt sind, wird nach Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

#### Bilanzierung von Zuschüssen

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden aktivisch abgesetzt.

#### Transaktionen in Fremdwährung

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

#### d) Verwendung von Schätzungen

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

### Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunktorentwicklungen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Rückgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum 31. Dezember 2010 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen T€ 740 (2009: T€ 383).

### Wertminderungen

Die SÜSS MicroTec AG überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderung. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, ist mit Schätzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert, abzüglich der Verkaufskosten, und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsätzlich mit Bewertungsmethoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ermittelt. Dabei werden für die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Durchschnittlich errechnet sich dabei ein jährliches Wachstum von 18,9 % (2009: 4,8 %). Die hohe Wachstumsrate ist zurückzuführen auf die außerordentlich hohen Umsatzzuwächse, die im Bereich Substrat Bonder erwartet werden. Ohne den Bereich Substrat Bonder beträgt die durchschnittlich angenommene Wachstumsrate 2,9 %. Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 10,4 % (2009: 9,9 %) durchgeführt. Diese Prämissen sowie die zugrunde liegende Methodik können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermögenswerte gleichermaßen mit Schätzungen des Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben kann.

### Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Verpflichtungen für Pensionen und damit zusammenhängende Aufwendungen und Erträge werden in Übereinstimmung mit versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf Schlüsselprämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermögens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender Laufzeit erzielt werden.

Aufgrund schwankender Markt- und Wirtschaftslage können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen haben kann.

### Rückstellungen

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

### Purchase Price Allocation

Bei Unternehmenserwerben nach IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) ist der Kaufpreis für den Unternehmenserwerb auf die beim Kauf erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden vorzunehmen. Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden sind mit einzelnen Ausnahmen (z. B. Steuerschulden, Pensionsverpflichtungen, anteilsbasierte Vergütungen) zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Hierbei sind nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

## e) Konsolidierung

### Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

### Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

in T€	2010		2009	
	Bilanz	G&V	Bilanz	G&V
1 EUR vs 1 USD	1,339	1,330	1,440	1,397
1 EUR vs 1 JPY	108,820	116,688	133,070	130,272
1 EUR vs 1 GBP	0,862	0,858	0,889	0,896
1 EUR vs 1 CHF	1,253	1,379	1,484	1,507
1 EUR vs 1 TWD	38,964	41,793	46,208	46,112
1 EUR vs 1 SGD	1,717	1,812	2,018	2,026
1 EUR vs 1 CNY	8,763	9,004	9,800	9,543
1 EUR vs 1 KRW	1.502,610	1.541,242	1.670,940	1.783,230
1 EUR vs 1 THB	40,525	42,563	47,975	48,247

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

### Angaben zum Konsolidierungskreis

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 ergaben sich folgende Veränderungen im Konsolidierungskreis:

Mit Kaufvertrag vom 27. Januar 2010 hat die SÜSS MicroTec AG das Segment Test Systeme veräußert. Wesentlicher Bestandteil der Transaktion waren 100% der Anteile an der Suss MicroTec Test Systems GmbH, Sacka bei Dresden, die komplett verkauft wurden. Die Suss MicroTec Test Systems GmbH wurde zum 27. Januar 2010 entkonsolidiert. Aus der Entkonsolidierung ergab sich im Geschäftsjahr 2010 ein Entkonsolidierungsgewinn in Höhe von 1,6 Mio. €, der gemäß IFRS 5 als Gewinn aus nicht fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen wird.

Gleichzeitig mit der Suss MicroTec Test Systems GmbH ist auch deren 10-%ige Beteiligung an der ZTS-Zentrum für Technologiestrukturentwicklung Region Riesa-Großenhain GmbH, Glaubitz, aus dem SÜSS-Konzern ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 15. Februar 2010 hat die SÜSS MicroTec AG 100 % der Anteile an der HamaTech APE GmbH & Co. KG, Sternenfels, von der Singulus Technologies AG erworben. Die HamaTech APE GmbH & Co. KG wurde gemäß IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) erstmals in den Konzernabschluss zum 31. März 2010 einbezogen; der Erstkonsolidierungszeitpunkt war der 1. März 2010. Aus der Erstkonsolidierung resultiert ein Badwill in Höhe von 2,7 Mio. €, der gemäß IFRS 3.34 erfolgswirksam unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen wird.

Gleichzeitig mit der HamaTech APE GmbH & Co. KG hat die SÜSS MicroTec AG auch 100 % der Anteile an der HamaTech APE Beteiligungs GmbH, Sternenfels, erworben. Die HamaTech APE Beteiligungs GmbH fungiert als Komplementärin der HamaTech APE GmbH & Co. KG. Ihr Anteil am Kapital der HamaTech APE GmbH & Co. KG beträgt 0 %.

Weitere Veränderungen im Konsolidierungskreis ergaben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht.

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung):

Gesellschaft	Währung	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MicroTec AG, Garching	EUR	18.721.038,00	Holding	91.843.441,42	6.216.893,56	voll
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching	EUR	2.000.100,00	100 %	40.726.473,25	11.783.212,91	voll
HamaTech APE GmbH & Co. KG, Sternenfels	EUR	3.000.000,00	100 %	-4.278.601,89	1.521.065,58	voll
HamaTech APE Beteiligungs GmbH, Sternenfels	EUR	25.000,00	100 %	18.543,16	-1.459,12	voll
SUSS MicroTec Ltd., Coventry	GBP	10.000,00	100 %	1.160.915,34	171.635,40	voll
Suss MicroTec KK, Yokohama	JPY	30.000.000,00	100 %	-296.350.918,00	-332.869.034,00	voll
SUSS MicroTec S.A.S., Lyon	EUR	114.750,00	100 %	455.438,00	336.758,00	voll
SUSS MicroOptics S.A., Neuchâtel	CHF	500.000,00	85 %	3.674.389,09	1.266.319,43	voll
SUSS MicroTec Inc., Waterbury	USD	105.000,00	100 %	37.018.635,63	15.446.837,34	voll
SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu	TWD	5.000.000,00	100 %	90.398.367,00	28.620.994,00	voll
SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai	CNY	1.655.320,00	100 %	8.037.369,09	762.152,17	voll
SUSS MicroTec Precision Photomask Inc., Palo Alto <sup>(1)</sup>	USD	24.287,00	100 %	1.898.115,41	-385.439,69	voll
HUGLE Lithography Inc., San Jose <sup>(2)</sup>	USD	1.190.442,00	53,1 %	-39.579,00	-2.871,00	at cost
SUSS MicroTec Company Ltd, Bangkok <sup>(3)</sup>	THB	4.000.000,00	49 %	1.166.762,00	0,00	voll
SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim <sup>(4)</sup>	EUR	25.564,59	100 %	204.520,29	-1.351,77	voll
SUSS MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur	SGD	25.000,00	100 %	246.892,35	906.215,92	voll
SUSS MicroTec Korea Co. Ltd., Seoul	KRW	50.000.000,00	100 %	306.576.926,00	345.106.602,00	voll
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand <sup>(5)</sup>	EUR	52.000,00	10 %	1.163.313,00	-12.847,00	at cost

<sup>(1)</sup> vormals Image Technology Inc., Palo Alto

<sup>(2)</sup> aufgrund Unwesentlichkeit keine Konsolidierung

<sup>(3)</sup> Vollkonsolidierung über Kontrollausübung

<sup>(4)</sup> Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages mit der SÜSS MicroTec AG

<sup>(5)</sup> Zahlen laut Jahresabschluss 31.12.2009

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

### Unternehmenserwerbe

Die SÜSS MicroTec AG erwarb mit Wirkung vom 15. Februar 2010 100 % der Anteile an der HamaTech APE GmbH & Co. KG, Sternenfels, sowie der HamaTech APE Beteiligungs GmbH, Sternenfels, von der Singulus Technologies AG. Daneben hat die SÜSS MicroTec AG auch das Betriebsgrundstück und die Firmengebäude am Standort Sternenfels sowie ein Gesellschafterdarlehen mit einem Nennwert von rund 10,1 Mio. € erworben.

Die HamaTech APE GmbH & Co. KG hat sich als weltweit führender Ausrüster für die Reinigung von Fotomasken in der Halbleiterindustrie etabliert und beschäftigt am Standort Sternenfels und in den Auslandsgesellschaften etwa 80 Mitarbeiter.

Der Kaufpreis für das Betriebsgrundstück und die Firmengebäude belief sich auf 4,5 Mio. €. Der Kaufpreis für die Anteile an der HamaTech APE GmbH & Co. KG und das Gesellschafterdarlehen setzte sich zusammen aus einer fixen Komponente in Höhe von rund 3,5 Mio. € und einer Earn-Out-Komponente in Höhe von 1 Mio. €. Darüber hinaus hat die SÜSS MicroTec AG weitere Intercompany-Forderungen der Singulus Technologies AG in Höhe von rund 1,0 Mio. € abgelöst, die aus der laufenden Geschäftstätigkeit der HamaTech APE GmbH & Co. KG seit dem 1. Januar 2010 resultierten. Bereits im ersten Quartal 2010 hat die SÜSS MicroTec AG den kompletten (fixen) Kaufpreis von rund 9,0 Mio. € bezahlt.

Der Erwerb der Anteile und Vermögenswerte bzw. Schulden wird im Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG nach den International Financial Reporting Standards als Unternehmenszusammenschluss gemäß IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) abgebildet. In diesem Zusammenhang sind die erworbenen Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden (mit einzelnen Ausnahmen) zu ihrem beizulegenden Zeitwert im Erwerbszeitpunkt anzusetzen (IFRS 3.18). Hierbei sind – nach den Vorschriften des IFRS 3 in Verbindung mit IAS 38 – nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

Vor diesem Hintergrund wurde für die erworbenen Vermögenswerte und Schulden eine Purchase Price Allocation durchgeführt. Die erworbenen Vermögenswerte und Schulden wurden im Erstkonsolidierungszeitpunkt wie folgt angesetzt:

in Mio.€	Buchwert nach IFRS per 28.02.2010	Bei Erwerb angesetzt (gemäß PPA)
Immaterielle Vermögenswerte	3,1	1,3
Sachanlagen	0,3	0,4
Kurzfristige Vermögenswerte	7,6	7,6
<b>Summe Vermögenswerte</b>	<b>11,0</b>	<b>9,3</b>
Langfristige Schulden	0,0	0,0
Kurzfristige Schulden	2,6	2,6
<b>Summe Schulden</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Nettovermögen	8,4	6,7
Anschaffungskosten		4,5
Rückstellungen für Earn-Out		0,8
Badwill		1,4

Die bisher unter den immateriellen Vermögenswerten angesetzten aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von 2,7 Mio. € wurden im Erwerbszeitpunkt mit 0 € bewertet. Stattdessen wurden bislang noch nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 0,9 Mio. € aktiviert, die zum größten Teil die erworbene Technologie betreffen. Die Bewertung der Technologie basiert auf einer Planung für die Jahre 2010 bis 2013 und den daraus resultierenden Zahlungsströmen. Darüber hinaus wurden stille Reserven in den Sachanlagen in Höhe von 0,1 Mio. € aufgedeckt.

Da die Summe der beizulegenden Zeitwerte der angesetzten identifizierten Vermögenswerte und Schulden die Anschaffungskosten übersteigt, ergibt sich aus dem Unternehmenszusammenschluss ein Badwill, der gemäß IFRS 3 erfolgswirksam zu erfassen ist.

Im Rahmen des Kaufs der HamaTech APE GmbH & Co. KG ist eine Eigenkapitalgarantie des Verkäufers, der Singulus Technologies AG, dahingehend abgegeben worden, dass das Eigenkapital der HamaTech APE GmbH & Co. KG nach HGB zum Zeitpunkt des Closings einen bestimmten Betrag nicht unterschreiten wird. Die Eigenkapitalgarantie wurde verfehlt. Im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung haben sich Käufer und Verkäufer auf einen Ausgleich in Form einer nachträglichen Kaufpreisanpassung geeinigt. Zum einen hat die Singulus Technologies AG vom bereits erhaltenen Kaufpreis 0,7 Mio. € an die SÜSS MicroTec AG zurückerstattet. Zum anderen wurde die Earn-Out-Komponente von bisher 1 Mio. € auf einen Betrag von 0,3 Mio. € reduziert.

Durch die mit Singulus Technologies AG geschlossene Vergleichsvereinbarung reduzierte sich die Rückstellung für die Earn-Out-Komponente auf 0,3 Mio. €. Der Badwill erhöhte sich auf 2,7 Mio. €. Der Badwill wird gemäß IFRS 3.34 erfolgswirksam unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Das der Earn-Out-Komponente zugrunde liegende Umsatzziel der HamaTech APE GmbH & Co. KG wurde im Geschäftsjahr 2010 erreicht. Damit ist die SÜSS MicroTec AG verpflichtet, der Singulus Technologies AG den vereinbarten Earn-Out in Höhe von 0,3 Mio. € auszahlen. Im Konzernabschluss ist eine Verbindlichkeit in entsprechender Höhe passiviert.

In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind die Erträge und Aufwendungen der HamaTech APE GmbH & Co. KG der Monate März bis Dezember 2010 eingeflossen. In diesem Zeitraum trug der Bereich Fotomasken Equipment mit Umsätzen in Höhe von 18,4 Mio. € und einem Ergebnis von 1,6 Mio. € zum Konzernergebnis nach Steuern bei. Hätte die SÜSS MicroTec AG die HamaTech bereits zum Beginn der Berichtsperiode erworben, betrügen die Konzernumsätze 139,4 Mio. € und das Konzernergebnis nach Steuern 12,9 Mio. €.

#### **f) Nicht fortgeführte Aktivitäten**

Am 28. Januar 2010 gab die SÜSS MicroTec AG die Veräußerung des Segments Test Systeme bekannt. Das Segment Test Systeme ist in Sacka bei Dresden beheimatet. Dort sind Entwicklung, Produktion und der Vertrieb in Europa angesiedelt. In Asien und Nordamerika erfolgt der Vertrieb über Gesellschaften des SÜSS MicroTec-Konzerns oder über externe Repräsentanten.

Wesentlicher Bestandteil der Transaktion waren die Anteile an der Süss MicroTec Test Systems GmbH. Zudem wurden einzelne Vermögenswerte von Auslandstöchtern veräußert, die ebenfalls dem Bereich Test Systeme zugeordnet waren.

Der Kaufpreis für das Segment Test Systeme besteht aus einem festen und einem treuhänderisch verwalteten Anteil. Die fixe Komponente beträgt 4,5 Mio. €, wovon 2,0 Mio. € in bar und 2,5 Mio. € in Stammaktien der Käuferin (Cascade Microtech Inc.) bezahlt wurden. Ein weiterer Betrag von 2,5 Mio. € wurde auf ein Treuhandkonto eingestellt, dessen Auszahlung von bestimmten Bedingungen abhängig ist, die nach der Transaktion von dem Verkäufer erfüllt werden müssen und zu einer entsprechenden Kaufpreisanpassung führen. Bis zum 31. Dezember 2010 sind der SÜSS MicroTec AG aus diesem Treuhandkonto 0,8 Mio. € zugeflossen. Darüber hinaus hat die SÜSS MicroTec AG aus Kaufpreisanpassungen 0,8 Mio. € erhalten. Von dem Gesamtbetrag von insgesamt 1,6 Mio. € wurden im Vorjahr bereits 1,0 Mio. € im Rahmen der Bewertung der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte und Schulden berücksichtigt. Die Treuhandkonten weisen zum Stichtag einen verbleibenden Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € aus, die – sofern die damit zusammenhängenden Bedingungen erfüllt werden – 2011 und 2012 zur Auszahlung kommen werden.

Zum 27. Januar 2010 wurde die Süss MicroTec Test Systems GmbH entkonsolidiert. Der Gewinn aus der Entkonsolidierung beläuft sich bis zum 31. Dezember 2010 auf 1,6 Mio. €. Insgesamt belief sich das EBIT des Segments Test Systeme (nicht fortgeführte Aktivitäten) im Geschäftsjahr 2010 auf 0,3 Mio. €.



Das Ergebnis des Segments Test Systeme, das in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen wird, stellt sich wie folgt dar:

in T€	2010	2009
Umsatzerlöse	1.774	16.404
Kosten und Aufwendungen	-3.085	-17.217
Verlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert abzüglich Verkaufskosten	0	-4.690
Gewinn aus Entkonsolidierung	1.641	0
<b>Gewinn / Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten vor Ertragsteuern</b>	<b>330</b>	<b>-5.503</b>
Ertragsteuern	2	110
<b>Gewinn / Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern</b>	<b>332</b>	<b>-5.393</b>

#### Risikoberichterstattung

Auf die Ausführungen zur Risikoberichterstattung im Lagebericht wird verwiesen. Diese sind als Bestandteil dieses Anhangs zu betrachten.

## ERLÄUTERUNGEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die folgenden Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung beinhalten ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns.

### (3) UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2010	2009
Maschinen	111.966	80.958
Ersatzteile	13.460	10.321
Serviceleistungen	6.754	4.873
Sonstige	6.905	7.749
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>139.085</b>	<b>103.901</b>

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus dem Maskengeschäft und aus dem Bereich Mikrooptik.

### (4) UMSATZKOSTEN

In den Umsatzkosten sind insgesamt planmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von T€ 2.383 enthalten. Die Abschreibungen betreffen mit T€ 809 (2009: T€ 629) Entwicklungsprojekte im Bereich Lithografie und mit T€ 1.574 (2009: T€ 1.358) den Bereich Substrat Bonder. Darüber hinaus sind in den Umsatzkosten planmäßige Abschreibungen auf die erworbene Technologie der HamaTech in Höhe von T€ 213 enthalten.

Des Weiteren sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Lagerbestände (Demogeräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige und unfertige Erzeugnisse) von T€ 2.278 (2009: T€ 3.531) eingeflossen. Dabei entfallen T€ 1.085 (2009: T€ 2.350) auf Bestände des Bereichs Lithografie und T€ 1.056 (2009: T€ 1.181) auf Bestände des Bereichs Substrat Bonder. Die Bestände des Bereichs Fotomaschinen Equipment wurden um T€ 137 abgewertet.

## (5) SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2010	2009
Fremdwährungsgewinne	5.475	2.177
Rückstellungsaufösungen	29	112
KFZ-Sachbezüge	190	223
Stornogebühren von Kunden	718	0
Sonstige Zuschüsse	76	12
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	274
Kommissionen	231	119
Ausbuchung von Verbindlichkeiten (Verzicht des Gläubigers)	464	0
Badwill Erstkonsolidierung HamaTech	2.678	0
Sonstiges	135	24
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.996</b>	<b>2.941</b>

T€ 1.821 der Fremdwährungsgewinne resultieren aus der Rückführung von konzerninternen Fremdwährungskrediten durch die Süss MicroTec Inc., Waterbury, im Zusammenhang mit der im Dezember erfolgten Übertragung von immateriellen Vermögenswerten an die Süss MicroTec Lithography GmbH. Die übrigen Fremdwährungsgewinne entstanden im Wesentlichen aus der Bewertung von konzerninternen Verrechnungskonten in Fremdwährung (vorwiegend in japanischen Yen und US-Dollar) und – durch unterjährige Veränderung der Wechselkurse – aus dem operativen Geschäft, das in den Fremdwährungen US-Dollar und japanischer Yen abgewickelt wurde. Zudem realisierte das Unternehmen Kursgewinne aus der Devisenkursicherung.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 29 resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Im Vorjahr entstanden die Erträge (T€ 112) im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für Abfindungen.

Die Stornogebühren wurden von der Süss MicroTec Inc., Waterbury, vereinnahmt.

Die sonstigen Zuschüsse betreffen – wie im Vorjahr – insbesondere erhaltene Aufwandszuschüsse aus Förderprojekten, welche ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.

Die Kommissionen wurden von unseren Tochtergesellschaften in China und Taiwan erzielt.

Die Erträge aus der Ausbuchung von bestehenden Verbindlichkeiten standen im Zusammenhang mit der Bereinigung von Verrechnungskonten zwischen der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der Singulus Technologies AG. In diesem Zusammenhang wurden auch Forderungen in Höhe von T€ 306 ausgebucht (erfasst unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen).

## (6) SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2010	2009
Fremdwährungsverluste	2.731	2.539
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	385	65
Sonstige Steuern	522	258
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	229
Aufwendungen für Mitarbeiterentsendungen	143	0
Aufwendungen für Forderungsverzicht	306	0
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	263	9
Sonstiges	359	420
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.709</b>	<b>3.520</b>

Durch die Abwertung des US-Dollars im Verhältnis zum Euro sind dem Unternehmen insbesondere im vierten Quartal Fremdwährungsverluste im operativen Geschäft entstanden. Zudem belasteten sowohl realisierte sowie noch unrealisierte Kursverluste aus Fremdwährungskontrakten im Bereich des US-Dollars vor allem im zweiten Quartal des Berichtsjahres das Währungsergebnis.

Die Aufwendungen für Forderungsverzicht stehen im Zusammenhang mit der Bereinigung von Verrechnungskonten zwischen der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der Singulus Technologies AG. In diesem Zusammenhang wurden auch Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 464 ausgebucht (erfasst unter den sonstigen betrieblichen Erträgen).

## (7) FINANZERGEBNIS

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen sowie dem sonstigen Finanzergebnis zusammen.

Die Zinsaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

in T€	2010	2009
Bankverbindlichkeiten	676	667
Zinsswaps	51	0
Bezahlte Stückzinsen	14	86
Zinsen für Finanzierungsleasing	78	13
Sonstige Zinsaufwendungen	69	31
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>888</b>	<b>797</b>

Die Zinsaufwendungen sind im Berichtsjahr leicht angestiegen. Nach T€ 797 im Vorjahr beliefen sie sich auf T€ 888. Die Erhöhung resultierte zum einen aus zusätzlichen Zinsaufwendungen für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels. Zum anderen ergaben sich per Saldo negative Marktwertveränderungen der Zinssicherungskontrakte, für die entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Die Zinserträge in Höhe von T€ 654 (2009: T€ 701) resultieren überwiegend aus Geldmarktanlagen sowie Wertpapieren. Im Vorjahr ist außerdem die Marktwertveränderung der Zinssicherungskontrakte (Zinsswaps) enthalten, die in 2009 zu einem Ertrag in Höhe von T€ 103 führte.

Das sonstige Finanzergebnis in Höhe von T€ 51 (2009: T€ 43) enthält im Berichtsjahr im Wesentlichen Avalprovisionen in Höhe von T€ 46 (2009: T€ 36).

## (8) ERTRAGSTEUERN

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

in T€	2010	2009
Laufender Steueraufwand	4.802	808
Latenter Steuerertrag / -aufwand	-3.809	1.297
davon auf temporäre Differenzen	-268	-1.094
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>993</b>	<b>2.105</b>

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

Angenommener Steuersatz in %	2010	2009
Körperschaftsteuer	15,00	15,00
Solidaritätszuschlag	5,50	5,50
Gewerbesteuer	12,43	12,43
<b>Kombinierter Steuersatz</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>

in T€	2010	2009
Ergebnis vor Steuern	14.028	2.641
Erwartete Ertragsteuern	3.963	746
Abweichende Steuersätze im Ausland	5	-641
Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	62	69
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	201	154
Steueraufwand Vorjahre	1.351	53
Veränderung in der Realisierbarkeit latenter Steueransprüche	-1.721	2.323
Veränderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern	1.238	0
Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge	-3.541	-203
Steuerfreie Erträge	-464	-13
Dem Organträger zuzurechnendes Einkommen aus nicht fortgeführten Aktivitäten	94	-266
Sonstiges	-195	-117
<b>Effektive Ertragsteuern</b>	<b>993</b>	<b>2.105</b>

Die Gegenüberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern aus den fortgeführten Aktivitäten zeigt eine Abweichung von T€ -2.970 (2009: T€ 1.359). Statt einen Steueraufwand in Höhe von T€ 3.963 auszuweisen, verbuchte das Unternehmen im Berichtsjahr einen deutlich niedrigeren Steueraufwand von T€ 993.

Der positive Effekt resultiert im Wesentlichen aus der Verlagerung des Geschäftsbereichs Substrat Bonder von den USA nach Deutschland und dem damit im Zusammenhang stehenden Verkauf der immateriellen Vermögenswerte von der SUSS MicroTec Inc., Waterbury / Vermont (USA) an die SUSS MicroTec Lithography GmbH, Sternenfels. Durch den Verkauf wurden bei der SUSS MicroTec Inc. (für die steuerliche Ergebnisrechnung) stille Reserven in Höhe von rund 22 Mio. USD aufgedeckt. Der dadurch in den USA angefallene Ertrag kann durch die Nutzung der dort vorhandenen Verlustvorträge vollständig steuerfrei vereinnahmt werden. Da die aktiven latenten Steueransprüche auf diese Verlustvorträge im Vorjahr komplett wertberichtigt waren, ergibt sich im aktuellen Geschäftsjahr ein positiver Steuereffekt von T€ 3.298. Die bisher auf die aktivierten Entwicklungskosten gebildeten passiven latenten Steuern konnten vollständig ergebniswirksam aufgelöst werden. Durch die Umstrukturierung und Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs von den USA nach Deutschland veränderte sich außerdem die Einschätzung der Realisierbarkeit latenter Steueransprüche der SUSS MicroTec Inc. in den USA. Daraus resultiert insgesamt ein positiver Steuereffekt in Höhe von T€ 1.721.

Gegenläufig wirkten sich verschiedene Vorjahresanpassungen der steuerlichen Net Operating Losses der Suss MicroTec Inc. aus, die zu einem zusätzlichen latenten Steueraufwand von T€ 1.482 führten. Die Suss MicroTec Precision Photomask Inc., Palo Alto / Kalifornien (USA), realisierte hingegen durch einen Verlustrücktrag einen positiven Steuereffekt in Höhe von T€ 305.

Die Veränderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern betrifft im Wesentlichen die SUSS MicroTec KK, Yokohama (Japan). Die im aktuellen Geschäftsjahr entstandenen Verluste erhöhen die steuerlichen Verlustvorträge. Die darauf zu bildenden aktiven latenten Steuern von T€ 1.026 wurden zu 100 % wertberichtigt.

Aus der Entkonsolidierung der SUSS MicroTec Test Systems GmbH realisierte die SÜSS MicroTec AG einen Entkonsolidierungsgewinn in Höhe von T€ 1.641, der als steuerfreier Ertrag zu einem positiven latenten Steuereffekt in Höhe von T€ 464 führt.

Der nicht fortgeführte Bereich Test Systeme bzw. die SUSS MicroTec Test Systems GmbH bildete bis zum Vollzug der Transaktion eine ertragsteuerliche Organschaft mit der SÜSS MicroTec AG. Da die dargestellte Überleitungsrechnung auf das Vorsteuerergebnis der fortgeführten Aktivitäten abstellt, entstand im Vorjahr in Höhe des der Organträgerin zuzurechnenden und aktivierungsfähigen Verlustes eine Überleitungsposition in Höhe von T€ -266. Im Geschäftsjahr 2010 resultiert aus dem Bereich Test Systeme ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 332; der darauf entfallende Steueraufwand beträgt T€ 94.

Weiterhin trugen im Geschäftsjahr nicht abzugsfähige Betriebsausgaben in Höhe von T€ 201 (2009: T€ 154) zur Abweichung der effektiven Ertragsteuern von den erwarteten Ertragsteuern bei.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

in T€	Aktiva		Passiva	
	2010	2009	2010	2009
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.173	2.194	98	3
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	687	1.101	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56	115	40	21
Langfristige Rückstellungen	376	249	0	81
Immaterielle Vermögenswerte	2.928	0	193	3.198
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1	1	108	301
Finanzschulden	5	5	0	69
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	1.571	1.334
Passiver Ausgleichsposten HamaTech	0	0	542	0
Vorräte	809	721	58	49
Sachanlagen	0	87	46	147
Sonstiges	0	20	85	42
Verlustvorträge	2.838	3.269	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>8.873</b>	<b>7.762</b>	<b>2.741</b>	<b>5.245</b>

In den latenten Steuern auf die immateriellen Vermögenswerte zeigt sich der positive Steuereffekt aus der Verlagerung der immateriellen Vermögenswerte des Substrat-Bonder-Bereichs von Waterbury / USA nach Deutschland. Die passiven latenten Steuern, die die Süss MicroTec Inc. auf die aktivierten Entwicklungskosten gebildet hat, wurden aufgelöst. Darüber hinaus hat die Süss MicroTec Litography GmbH aktive latente Steuern gebildet auf temporäre Differenzen, die sich durch einen unterschiedlichen Ansatz der erworbenen immateriellen Vermögenswerte in der Steuerbilanz und der Konzernbilanz ergeben. Der positive Steuereffekt beläuft sich auf rund Mio. € 4,5.

Der Konzern verfügt über steuerliche Verlustvorträge in Höhe von T€ 25.220 (2009: T€ 39.557). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2017 insgesamt T€ 6.154. Im Zeitraum von 2022 bis 2029 verfallen insgesamt T€ 9.039. Verlustvorträge in Höhe von T€ 10.027 sind unbegrenzt nutzbar.

Der Rückgang der Verlustvorträge im Vergleich zum Vorjahr resultiert zum einen aus dem Verkauf der immateriellen Vermögenswerte des Substrat-Bonder-Bereichs von der SUSS MicroTec Inc. an die SUSS MicroTec Lithography GmbH und die damit verbundene Nutzung steuerlicher Verlustvorträge in den USA in Höhe von rund 11,8 Mio. €. Zum anderen erwirtschaftete die SUSS MicroTec Lithography GmbH ein deutlich positives Ergebnis und nutzte damit vollständig die noch verbliebenen steuerlichen Verlustvorträge in Höhe von T€ 1.480. Gegenläufig wirkte sich vor allem der laufende Verlust der SUSS MicroTec KK, Yokohama aus, der zu einer Erhöhung des Verlustvortrags in Japan um rund 3,3 Mio. € führte. Verlustvorträge in Höhe von rund 1,0 Mio. € in Japan sind zum 31.12.2010 verfallen.

Für Verlustvorträge in Höhe von T€ 15.336 (2009: T€ 24.742) und temporäre Differenzen in Höhe von T€ 1.588 (2009: T€ 2.210) wurden keine latenten Steuern angesetzt.

## (9) ERGEBNIS JE AKTIE

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

in T€	2010	2009
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten	13.035	536
Abzüglich: Minderheitsanteile	-137	-46
<b>Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten, der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt</b>	<b>12.898</b>	<b>490</b>
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien	18.072.913	17.019.126
Effekt aus der (potenziellen) Ausübung von Aktienoptionen	402.000	0
<b>Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien</b>	<b>18.474.913</b>	<b>17.019.126</b>
<b>Ergebnis je Aktie in € aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert</b>	<b>0,71</b>	<b>0,03</b>
<b>Ergebnis je Aktie in € aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert</b>	<b>0,70</b>	<b>0,03</b>

In die Berechnung des Ergebnisses je Aktie (verwässert) wurde der gewichtete Durchschnitt von 390.214 Aktien (2009: 831.613 Aktien) nicht mit einbezogen, da die Ausübungsvoraussetzungen im Berichtsjahr nicht erfüllt waren.

Weitere Informationen zu den Aktienoptionsprogrammen finden sich im Anhang unter Textziffer 21.

## (10) SONSTIGE ANGABEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### Personalaufwand

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

in T€	2010	2009
Löhne und Gehälter	34.294	30.689
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.904	3.283
Aufwendungen für Altersvorsorge	2.339	1.871
<b>Personalaufwand</b>	<b>40.537</b>	<b>35.843</b>

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

### Materialaufwand

Die Materialaufwendungen betragen in 2010 T€ 70.590 (2009: T€ 40.938).

**Abschreibungen**

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2010	2009
Immaterielle Vermögenswerte	4.218	3.571
Sachanlagen	1.983	1.216
<b>Abschreibungen</b>	<b>6.201</b>	<b>4.787</b>

Neben aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von T€ 2.383 (2009: T€ 1.987) wurden im Geschäftsjahr Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von T€ 543 (2009: T€ 1.362) abgeschrieben. Außerdem wurden Abschreibungen auf die zum 1. Oktober 2009 an eine Leasinggesellschaft verkaufte und zurückgeleaste SAP-Software in Höhe von T€ 887 (2009: T€ 222) vorgenommen. Darüber hinaus entstanden Abschreibungen auf die im Rahmen der Unternehmensakquisition HamaTech erworbene Technologie und weiterer erworbener immaterieller Vermögenswerte in Höhe von T€ 405.

In den Abschreibungen auf Sachanlagen sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 190 enthalten, die Mietereinbauten an den aufgegebenen Standorten Vaihingen und Waterbury betreffen.

Die auf aktivierte Entwicklungsleistungen vorgenommenen Abschreibungen betreffen ausschließlich planmäßige Abschreibungen.

**ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AKTIVA**

Die folgenden Erläuterungen zur Konzernbilanz beinhalten für das Berichtsjahr ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns.

**(11) IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE**

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von T€ 4.308 (2009: T€ 4.527) Entwicklungsleistungen von T€ 7.583 (2009: T€ 9.310) ausgewiesen.

In den Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten ist das geleaste SAP-System mit einem Restbuchwert von T€ 1.848 (2009: T€ 2.735) enthalten.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen in den Segmenten Lithografie und Substrat Bonder.

**(12) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT**

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von T€ 13.599 (2009: T€ 13.599) entfällt in voller Höhe auf das Segment Lithografie und enthält keinen Fremdwährungsanteil.



### (13) SACHANLAGEN

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermögen sind mit einem Restbuchwert in Höhe von T€ 124 (2009: T€ 176) auch geleaste technische Anlagen und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleaste Grundstücke, Gebäude und Einbauten enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen zugrunde liegenden Leasingverträge („Finance Lease“) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind.

### (14) SONSTIGE (LANGFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen, und von Zeitkontenrückdeckungen sowie geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

in T€	2010	2009
Rückdeckungsversicherung	305	421
Kautionen	179	132
Sonstiges	1	1
<b>Sonstige langfristige Vermögenswerte</b>	<b>485</b>	<b>554</b>

### (15) VORRÄTE

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

in T€	2010	2009
Materialien und Hilfsstoffe	23.175	17.858
Unfertige Erzeugnisse	23.802	14.075
Fertigerzeugnisse	17.842	9.473
Demonstrationsgeräte	10.991	9.241
Handelswaren	130	256
Wertberichtigungen	-11.509	-10.113
<b>Vorratsvermögen</b>	<b>64.431</b>	<b>40.790</b>

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2010 bilanzierten Vorräte in Höhe von T€ 64.431 (2009: T€ 40.790) sind T€ 19.723 (2009: T€ 22.422) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

Der Anstieg der Vorräte entfällt in Höhe von T€ 13.729 auf das neu hinzugekommene Segment Photomask Equipment. In der Vorjahreszahl sind diese Vorräte nicht enthalten.

## (16) FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

in T€	2010	2009
Forderungen gegen Dritte	16.399	15.225
Wertberichtigungen	-740	-383
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>15.659</b>	<b>14.842</b>

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder.

in T€	2010	2009
Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres	383	994
Nicht fortgeführte Aktivitäten	0	-259
Ausbuchung von Forderungen	-27	-78
Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen	-82	-383
Zuführung	466	109
<b>Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende</b>	<b>740</b>	<b>383</b>

## (17) SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

in T€	2010	2009
Aktivierter Stückzinsen	273	229
Positive Marktwerte aus Devisentermingeschäften	150	43
Förderprojekte	144	0
Sonstiges	73	83
<b>Sonstige finanzielle Vermögenswerte</b>	<b>640</b>	<b>355</b>

Unter den aktivierten Stückzinsen werden geleistete Vorauszahlungen auf Zinsforderungen aus erworbenen Wertpapieren dargestellt.

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten die positiven Marktwerte aus den Devisentermingeschäften aus. Weitere Einzelheiten zu den Devisentermingeschäften finden sich in der Textziffer 29 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

## (18) WERTPAPIERE

Die SÜSS MicroTec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Teil ihrer Liquidität in zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere investiert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen. Die Bewertung der Wertpapiere erfolgt zu Marktpreisen. Etwaige Marktpreisschwankungen werden erfolgsneutral im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

Zum Bilanzstichtag verfügte die Gesellschaft über Wertpapiere in Höhe von T€ 15.977 (2009: T€ 10.489). Neben den Unternehmens- und Staatsanleihen sind hier auch 747.530 Aktien der Cascade Microtech Inc. erfasst, die die SÜSS MicroTec AG im Zusammenhang mit dem Verkauf des Test-Business erhalten hat. Etwaige Marktpreisschwankungen der Cascade-Aktien werden ebenfalls erfolgsneutral im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

## (19) STEUERERSTATTUNGSANSPRÜCHE

Die langfristigen Steuerforderungen resultieren ausschließlich aus der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Guthabens deutscher Konzerngesellschaften in Höhe von T€ 108 (2009: T€ 121) in Folge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 3,77% p.a. zugrunde gelegt.

Die kurzfristigen Steuerforderungen bestehen aus geleisteten Steuervorauszahlungen in Höhe von T€ 620 (2009: T€ 265).

## (20) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

in T€	2010	2009
Aktive Rechnungsabgrenzung	837	490
Geleistete Anzahlungen	404	796
Umsatzsteuer	1.272	309
Kauttionen	187	0
Forderungen aus Förderprojekten	365	0
Sonstiges	331	0
<b>Sonstige kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>3.396</b>	<b>1.595</b>

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PASSIVA

### (21) EIGENKAPITAL

#### Gezeichnetes Kapital

Im Mai 2010 hat die SÜSS MicroTec AG eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital beschlossen, die am 11. Mai 2010 abgeschlossen wurde. Platziert wurden 1.701.912 Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 zum Preis von 4,00 € pro Aktie.

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG wurde von 17.019.126,00 € (eingeteilt in 17.019.126 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 €) um einen Betrag von 1.701.912,00 € erhöht und betrug zum Bilanzstichtag 18.721.038,00 €. Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag T€ 2.553 (2009: T€ 4.255).

Am 31. Dezember 2010 verfügt die Gesellschaft über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt T€ 1.695 (2009: T€ 1.695). Es ist für die Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte des Konzerns vorgesehen. Dabei sind T€ 45 dem Aktienoptionsplan 2002, T€ 750 dem Aktienoptionsplan 2005 und T€ 900 dem Aktienoptionsplan 2008 zuzuordnen.

in T€	2010	2009
Grundkapital	18.721	17.019
Genehmigtes Kapital	2.553	4.255
Bedingtes Kapital	1.695	1.695

### Rücklagen

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2010	2009
Kapitalrücklage	98.225	93.094
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzverlust	-10.714	-23.944
<b>Rücklagen</b>	<b>87.944</b>	<b>69.583</b>

Der Kapitalrücklage wurden aus der Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne T€ 187 (2009: T€ 252) ergebniswirksam zugeführt. Ausübungen von Aktienoptionen gab es im Berichtsjahr nicht.

Im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhung wurden der Kapitalrücklage T€ 5.106 (brutto) zugeführt. Die Transaktionskosten für die Durchführung der Kapitalerhöhung betragen T€ 227. Sie wurden – unter Berücksichtigung von latenten Steuern in Höhe von T€ 64 – von der Kapitalrücklage in Abzug gebracht.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Bilanzverlust verringerte sich durch das positive Jahresergebnis von T€ 13.230 vor Berücksichtigung von Minderheiten auf T€ -10.714.

### Kumuliertes übriges Eigenkapital

Die Entwicklung des kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in T€	2010	2009
Fremdwährungsanpassungen	-833	-753
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-202	0
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	326	-53
<b>Steuereffekte</b>		
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	-91	15
Absicherung künftiger Zahlungsströme	57	0
<b>Stand zu Beginn der Periode</b>	<b>-743</b>	<b>-791</b>
<b>Veränderungen vor Steuern</b>		
Fremdwährungsanpassungen	262	-80
Absicherung künftiger Zahlungsströme	101	-202
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	-19	379
Auflösung Other Comprehensive Income „Test“ (Entkonsolidierung)	-253	0
<b>Steuereffekte</b>		
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	-7	-106
Absicherung künftiger Zahlungsströme	0	57
<b>Stand am Ende der Periode</b>	<b>-659</b>	<b>-743</b>

Die SÜSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr einen Zinsswap als Sicherungsinstrument für das variabel verzinsliche Darlehen, das der Finanzierung des neu erworbenen Grundstücks in Sternenfels dient, abgeschlossen. Für diesen Zinsswap wurde Hedge Accounting angewendet. Anstelle der Abbildung in der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Marktwertänderungen im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

Im Vorjahr hat die SÜSS MicroTec AG für ihre bestehenden Zinsswaps, die im Geschäftsjahr 2007 als Sicherungsinstrument für die variabel verzinslichen Schuldscheine abgeschlossen wurden, Hedge Accounting angewendet. Anstelle der Abbildung in der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Marktwertänderungen im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet. Die Durchführung von Hedge Accounting erfolgte allerdings nur im ersten Quartal 2009, da die Sicherungsbeziehung ab 1. April 2009 nicht mehr effektiv war.

### Eigenkapitalmanagement

Der Vorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus, im kommenden Geschäftsjahr aus dem operativen Geschäft einen positiven Cashflow zu erwirtschaften. Unabhängig davon besteht bei einer Verfehlung der Planung die Gefahr, dass sich das Eigenkapital in Folge eines Jahresfehlbetrags verringern könnte.

## AKTIENOPTIONSPÄNE DER SÜSS MICROTEC AG

### Aktienoptionsplan 2002

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 500 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Die Bezugsrechte können nach Ablauf einer Wartefrist von zwei Jahren zu 100 % ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- der Börsenkurs der Aktien zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts den Basispreis um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts (entspricht 7,5 % für 12 Monate) übersteigt und zusätzlich sich im selben Zeitraum der Börsenkurs prozentual gleich oder besser entwickelt hat als der Nemax Technology Index oder ein eventuell an seine Stelle tretender vergleichbarer Nachfolgeindex

oder

- der Börsenkurs der Aktien zum Zeitpunkt der Ausübung den Basispreis um mindestens durchschnittlich 0,833 % pro vollem Kalendermonat (10 % pro Jahr) zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung übersteigt.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. drei Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

#### **Aktienoptionsplan 2005**

In der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 750 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund zwei Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt hat

oder

- der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. am Ende der Laufzeit. Die Laufzeit der Aktienoptionen beginnt mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von fünf Jahren.

#### **Aktienoptionsplan 2008**

In der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 900 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 900.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund zwei Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt hat

oder

- der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Zusätzlich zu diesen Erfolgszielen muss der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie für die Ausübungszeiträume, die innerhalb der ersten 36 Monate der Laufzeit der Aktienoptionen liegen, während der Laufzeit bis zum ersten Tag des Ausübungszeitraums mindestens einmal bei € 5,00, für Ausübungszeiträume, die zwischen dem 37. Monat bis zum 48. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei € 5,75 und für Ausübungszeiträume, die zwischen dem 49. Monat und 60. Monat liegen mindestens einmal während der Laufzeit bei € 6,60 gelegen haben.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von T€ 187 (2009: T€ 252) für diese Pläne vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden keine Bezugsrechte ausgegeben. Im Vorjahr wurden aus dem in der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 genehmigten Kapital insgesamt 438.250 Bezugsrechte mit einem Bezugspreis von € 1,30 ausgegeben.

Am 31. Dezember 2010 bestanden insgesamt 461.750 Bezugsrechte (2009: 461.950 Bezugsrechte).

Die von der Gesellschaft gewährten Bezugsrechte zum Aktienerwerb haben sich wie folgt entwickelt:

	Anzahl	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis in €
<b>01.01.2008</b>	<b>668.950</b>	<b>7,26</b>
gewährt 2008	0	0,00
ausgeübt 2008	0	0,00
verfallen 2008	81.300	7,30
<b>31.12.2008</b>	<b>587.650</b>	<b>7,26</b>
gewährt 2009	438.250	1,30
ausgeübt 2009	0	0,00
verfallen 2009	170.700	7,04
<b>31.12.2009</b>	<b>855.200</b>	<b>4,25</b>
gewährt 2010	0	0,00
ausgeübt 2010	0	0,00
verfallen 2010	158.400	4,59
<b>31.12.2010</b>	<b>696.800</b>	<b>4,18</b>
<b>noch begebbar</b>	<b>461.750</b>	

Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals zusammen:

BEREICH DES BEZUGSPREISES	Anzahl Bezugsrechte	gewichteter durchschnittl. Bezugspreis in €	gewichtete durchschnittl. Restlaufzeit in Monaten
unter € 2,50	402.000	1,30	40
€ 2,50 – € 4,99	0	0,00	0
€ 5,00 – € 7,49	0	0,00	0
€ 7,50 – € 9,99	294.800	8,11	13
	696.800	4,18	29

## (22) PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2010	2009
Inländische Verpflichtungen	1.823	1.752
Ausländische Verpflichtungen	1.096	1.251
Gesamt	2.919	3.003

### Leistungsorientierte Pläne („Defined benefit plans“)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne.

Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2010	2009
Abzinsungsfaktor	4,50 %	4,85 % – 5,03 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	3,90 % – 5,20 %	4,30 % – 5,30 %
Gehaltssteigerung	0,00 %	0,00 %
Rentensteigerung	2,00 %	2,00 %

Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005 G



Beim Gehalt wurden nur in der Schweiz Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2010	2009
Abzinsungsfaktor	2,75%	3,50%
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	2,75%	3,50%
Gehaltssteigerung	1,50%	1,50%
Rentensteigerung	0,50%	0,80%

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und die Marktwerte des Fondsvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2010 und 2009 wie folgt entwickelt:

in T€	2010	2009
<b>Anwartschaftsbarwert am 01.01.</b>	<b>5.014</b>	<b>4.819</b>
Dienstzeitaufwand	283	128
Zinsaufwand	209	191
Pensionszahlungen	-819	-277
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust	573	202
Währungsveränderungen	350	-49
<b>Anwartschaftsbarwert am 31.12.</b>	<b>5.610</b>	<b>5.014</b>

Der versicherungsmathematische Verlust des Geschäftsjahres beruht maßgeblich auf dem niedrigeren Abzinsungsfaktor.

in T€	2010	2009
<b>Planvermögen am 01.01.</b>	<b>1.645</b>	<b>1.664</b>
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	76	61
Geleistete Fondsdotierungen	-65	-81
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn / (-) Verlust	179	0
Währungsveränderungen	78	1
<b>Planvermögen am 31.12.</b>	<b>1.913</b>	<b>1.645</b>

Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

in T€	2010	2009
Barwert der Pensionsverpflichtungen	5.610	5.014
Zeitwert des Planvermögens	-1.913	-1.645
Errechnete Pensionsverbindlichkeit	3.697	3.369
Nicht realisierte versicherungsmathematische (+) Gewinne und (-) Verluste	-778	-366
Rückstellung	2.919	3.003

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von T€ 3.538 (2009: T€ 2.909) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in T€	2010	2009
Dienstzeitaufwand	339	128
Personalaufwandskomponente	339	128
Zinsaufwand	209	191
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-76	-61
Zinsaufwandskomponente	133	130

Die Personalaufwandskomponente des Geschäftsjahres entfällt in Höhe von T€ 201 (2009: T€ 23) auf die Verwaltungskosten und in Höhe von T€ 138 (2009: T€ 105) auf die Vertriebskosten.

Die Entwicklung des Anwartschaftsbarwerts, des Planvermögens sowie der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste unterteilt nach Anwartschaftsbarwert und Planvermögen zeigt folgende Tabelle:

in T€	2010	2009	2008	2007
Anwartschaftsbarwert	5.610	5.014	4.819	4.174
Planvermögen	1.913	1.645	1.664	1.640
Deckungsstatus	3.697	3.369	3.155	2.534

Erfahrungsbedingte Anpassungen gem. IAS 19.120 Ap waren im Betrachtungszeitraum aufgrund des im Rahmen der Bewertung unveränderten Mengengerüsts nicht notwendig.

#### Beitragsorientierte Pläne („Defined contribution plans“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA, die 21 Jahre oder älter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge werden jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag USD 0,50 für jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d.h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Im Geschäftsjahr 2010 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den Gewinnbeteiligungsplan TUSD 0 (2009: TUSD 0) und für den 401 (k) Plan TUSD 148 (2009: TUSD 162).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von T€ 2.227 (2009: T€ 1.526) abgeführt.

### (23) (LANGFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

in T€	Stand 01.01.10	Verbrauch	Zuführung	Stand 31.12.10
Altersteilzeit	711	-245	42	508

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt für Arbeitnehmer der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec AG, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung / Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82 % des monatlichen Vollzeitnettoarbeitsentgelts beträgt. Der Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

### (24) FINANZSCHULDEN

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2010 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31.12.2010 in T€	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	203	720	3.600	4.523
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen	0	8.964	0	8.964
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	916	1.083	0	1.999
<b>Gesamt</b>	<b>1.119</b>	<b>10.767</b>	<b>3.600</b>	<b>15.486</b>

31.12.2009 in T€	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	833	19	0	852
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen	0	8.948	0	8.948
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	914	1.995	0	2.909
<b>Gesamt</b>	<b>1.747</b>	<b>10.962</b>	<b>0</b>	<b>12.709</b>

### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich in Höhe von T€ 0 (2009: T€ 752) aus der Inanspruchnahme eingeräumter Kreditlinien sowie in Höhe von T€ 4.523 (2009: T€ 100) aus langfristigen Darlehensverträgen zusammen.

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2010	2009
Kreditlinie	9.700	12.451
Inanspruchnahme	5.649	3.783
<b>Verfügbare Kreditlinie</b>	<b>4.051</b>	<b>8.668</b>

Das bisherige Bankenkonsortium unter Führung der Fortisbank wurde zum 31.03.2010 durch ein neues Konsortium unter der Führung der Bayern LB abgelöst. Die SÜSS MicroTec AG hat im März 2010 mit dem neuen Bankenkonsortium Kreditverträge unterzeichnet, mit denen eine Kreditlinie in Höhe von € 6 Mio. gestellt wird. Die Kreditlinie läuft vorerst bis zum 31. März 2011 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Im Mai 2010 hat die HamaTech APE GmbH & Co. KG mit der BW Bank Mannheim einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die HamaTech APE GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherung besteht eine weitere Kreditlinie zur Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften in Höhe von € 2,5 Mio.

Zum Bilanzstichtag ist die Linie in Höhe von T€ 5.649 (Vorjahr: T€ 3.031) in Form von Avalen genutzt.

Im Gegenzug reduzierte sich die lokale Kreditlinie in Japan von YEN 100 Mio. im Vorjahr auf YEN 0 Mio. .

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien betrug 1,1 % (2009: 1,88 %).

Zur Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstücks in Sternenfels hat die SÜSS MicroTec AG am 25./28. Mai 2010 einen Darlehensvertrag mit einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen beläuft sich auf 4,5 Mio. € und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Es wurde am 6. Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht.

Neben der SÜSS MicroTec AG verfügt nur noch die Suss MicroTec Precision Photomask Inc. über Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Im Einzelnen setzen sich die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres wie folgt zusammen:

**KONZERNGESELLSCHAFT**

in T€	2010	2009	Zinssatz	Fälligkeit
SÜSS MicroTec AG	4.500	0	3,98 %	30.6.2020
Suss MicroTec Precision Photomask Inc.	23	102	9,27 %	26.3.2011
<b>Gesamt</b>	<b>4.523</b>	<b>102</b>		
... davon kurzfristig fällig	203	102		
... davon langfristig fällig	4.320	0		
... fällig 2011	203			
2012	180			
2013	180			
2014	180			
2015	180			
... später	3.600			
	<b>4.523</b>			

**Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen**

Die Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen betreffen ausschließlich die SÜSS MicroTec AG und setzen sich wie folgt zusammen:

**KONZERNGESELLSCHAFT**

in T€	2010	2009	Zinssatz	Fälligkeit
SÜSS MicroTec AG	2.988	2.982	6,00 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	2.988	2.982	6,17 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	2.988	2.982	6,06 %	21.12.2012
<b>Gesamt</b>	<b>8.964</b>	<b>8.946</b>		
... davon kurzfristig fällig	0	0		
... davon langfristig fällig	8.964	8.946		
... fällig 2011	0			
2012	8.964			
2013	0			
2014	0			
2015	0			
... später	0			
	<b>8.964</b>			

**Verbindlichkeiten aus Finance Lease**

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungsbereich unter Operating-Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Software, Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance-Lease-Verträge, deren zugrundeliegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden.

Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

in T€	Finance Lease	Operating Lease	davon Operating Lease mit nahestehen- den Personen
Abschreibungen / Aufwendungen 2010	945	2.286	0
Abschreibungen / Aufwendungen 2009	311	2.350	0
Künftige Verpflichtungen ... fällig 2011	994	2.243	0
2012	976	1.683	0
2013	98	1.495	0
2014	4	152	0
2015	0	114	0
... später	0	0	0
<b>Gesamt zukünftig</b>	<b>2.072</b>	<b>5.687</b>	<b>0</b>
Zinsanteil	73		
<b>Verbindlichkeit 31.12.2010</b>	<b>1.999</b>		
... davon kurzfristig	916		
... davon langfristig	1.083		

**(25) (KURZFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN**

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2010	2009
Garantierückstellungen	1.941	1.226
Restrukturierung	1.457	0
Abfindungen	0	81
Übrige Rückstellungen	1.215	465
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>4.613</b>	<b>1.772</b>

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Am 10. Juni 2010 hat die SÜSS MicroTec AG ihren Entschluss mitgeteilt, den im US-amerikanischen Waterbury (Vermont) ansässigen Geschäftsbereich Substrat Bonder noch in diesem Jahr nach Deutschland zu verlegen. Im Zuge der geplanten Umstrukturierung werden die Funktionsbereiche Forschung und Entwicklung, Produktion sowie das Produktmanagement der Bonder-Produktlinien an den neuen Standort Sternenfels verlegt. Die nordamerikanische Service- und Vertriebsorganisation sowie das Applikationscenter werden zeitgleich von Waterbury ins „Silicon Valley“, Kalifornien, verlagert.

Die zu erwartenden Aufwendungen der Umstrukturierung werden sich auf insgesamt 6,5 Mio. € belaufen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres sind Restrukturierungsaufwendungen von rund 3,9 Mio. € angefallen. Die Restrukturierungsrückstellung beläuft sich zum 31. Dezember 2010 auf 1,5 Mio. €.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2010	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
Garantierückstellungen	1.226	-1.194	0	1.909	1.941
Abfindungen	81	-81	0	0	0
Restrukturierung	0	0	0	1.457	1.457
Übrige Rückstellungen	465	-415	-29	1.194	1.215
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>1.772</b>	<b>-1.690</b>	<b>-29</b>	<b>4.560</b>	<b>4.613</b>

## (26) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in T€	2010	2009
Prämien und Provisionen	2.781	1.825
Fremdleistungen	2.392	1.753
Aufsichtsratsvergütung	161	132
Negative Marktwerte aus Devisentermingeschäften	111	17
Negative Marktwerte aus Zinsswaps	390	442
Sonstiges	623	367
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>	<b>6.458</b>	<b>4.536</b>

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte aus den Devisentermingeschäften und Zinsderivaten aus. Weitere Einzelheiten zu den Devisentermingeschäften und Zinssicherungsgeschäften finden sich in Textziffer (29) „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

## (27) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in T€	2010	2009
Erhaltene Anzahlungen	23.580	12.118
Abgegrenzte Personalkosten	2.795	1.785
Passive Rechnungsabgrenzung	480	524
Umsatzsteuer	53	326
Sonstiges	125	153
<b>Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>27.033</b>	<b>14.906</b>

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

## (28) STEUERSCHULDEN

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von T€ 4.917 (2009: T€ 554) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von T€ 495 (2009: T€ 41).

## SONSTIGE ANGABEN

### (29) ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER FINANZINSTRUMENTE

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten.



Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

in T€	2010	2009
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>		
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	15.977	10.489
Kredite und Forderungen	16.149	15.154
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	150	43
	<b>32.276</b>	<b>25.686</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten	501	459
Finanzielle Verbindlichkeiten	29.190	18.335
	<b>29.691</b>	<b>18.794</b>

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar.

in T€	2010		2009	
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	36.525	36.525	20.621	20.621
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.659	15.659	14.842	14.842
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	640	640	355	355
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	490	490	312	312
bewertet zum Marktwert	150	150	43	43
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	15.977	15.977	10.489	10.489
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.746	9.746	4.458	4.458
Finanzschulden	15.486	16.527	12.709	13.476
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.523	4.691	854	809
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen	8.964	9.810	8.946	9.827
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	1.999	2.026	2.909	2.840
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	6.458	6.458	4.536	4.536
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	5.957	5.957	4.077	4.077
bewertet zum Marktwert	501	501	459	459

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

**Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente:** Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

**Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:** Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

**Sonstige finanzielle Vermögenswerte / Verbindlichkeiten:** Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

**Wertpapiere:** Der Marktwert der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte entspricht dem Kurswert in einem aktiven Markt.

**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:** Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

**Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen:** Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

**Verbindlichkeiten aus Finance Lease:** Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2010	2009
Kredite und Forderungen	-342	78
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	65	164
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	-31	53

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

Nettogewinne bzw. -verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten Marktwertveränderungen der derivativen Finanzinstrumente.

Im Berichtsjahr wurde die während der Laufzeit im kumulierten übrigen Eigenkapital – nach der Berücksichtigung latenter Steuern – erfasste Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte in Höhe von T€ -31 infolge der Endfälligkeit dieser Wertpapiere aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

### Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2010		2009	
	Aktiva	Passiva	Aktiva	Passiva
Devisentermingeschäfte	150	111	43	17
Zinsswaps	0	390	0	442

Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des US-Dollars und des japanischen Yen, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Das Unternehmen ist bestrebt, Zinsrisiken, die sich aus der Sensitivität von Finanzschulden in Bezug auf Schwankungen des Marktzinsniveaus ergeben können, durch den Einsatz von Zinsderivaten, wie Zinsswaps, zu begrenzen. So hat die Gesellschaft den variablen Teil des in 2007 begebenen Schuldscheindarlehens mit laufzeitkongruenten Swap-Kontrakten gesichert. Auch das in 2010 aufgenommene Darlehen, das der Finanzierung des Grundstücks Sternenfels dient und einen variablen Zins aufweist, wurde mit einem laufzeitkongruenten Swap gesichert. Die Zinsswaps gleichen die Auswirkung zukünftiger Veränderungen der Zinssätze auf die Zahlungsströme der zugrunde liegenden variabel verzinslichen Anlagen aus. Um die Marktwertschwankungen des Zinsswaps für das Grundstücksdarlehen im kumulierten übrigen Eigenkapital abzubilden, hat die Gesellschaft für diesen Zinsswap Hedge Accounting angewendet. Im Vorjahr wurde im ersten Quartal auch Hedge Accounting für die beiden Zinsswaps des Schuldscheindarlehens angewendet. Nachdem die Effektivität der Sicherungsbeziehung im zweiten Quartal 2009 nicht mehr gegeben war, fiel die Anwendung von Hedge Accounting weg und die Marktwertschwankungen der Zinsswaps wurden wieder in den Zinserträgen bzw. -aufwendungen erfasst.

### (30) NAHESTEHENDE PERSONEN

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20 % oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Im Vorjahr wurde der Konzern von den Angabepflichten nach IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“ in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zum mittlerweile ausgeschiedenen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der SÜSS MicroTec AG berührt. Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Richter, war zugleich Vorstand der Thin Materials AG, Eichenau. Im ersten Quartal 2009 hat die SÜSS MicroTec AG einen Kooperationsvertrag mit dieser Gesellschaft abgeschlossen. Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit beider Unternehmen im Bereich Dünn-Wafer-Prozessierung. Dabei hat die SÜSS MicroTec AG Intellectual Property (IP) und Know-how für 0,9 Mio. € im Bereich Dünn-Wafer-Handling erworben. Die aktivierte IP wird über fünf Jahre abgeschrieben. Auf der Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG, die am 24. Juni 2009 stattfand, hat Herr Dr. Richter sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft niedergelegt.

### (31) FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2010	2009
Bestellobligo	17.171	7.052
Mietverpflichtungen	4.677	6.150
Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>	<b>21.848</b>	<b>13.202</b>

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

### (32) ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SÜSS-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cashflow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Betrag von T€ 350 (2009: T€ 350) der ausgewiesenen flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag als Sicherheit für einen Kautionsversicherungsvertrag. Im Vorjahr war ein Guthaben von T€ 362 zur Deckung einer Mietbürgschaft verpfändet.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von T€ -2.854 (2009: T€ 432) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte.

Der im Berichtsjahr durchgeführte Erwerb der HamaTech APE wird zusammen mit dem Erwerb des Grundstücks Sternenfels als Investition im Cashflow aus Investitionstätigkeit dargestellt. Der im Berichtsjahr erfolgte Verkauf des Test-Bereichs wird als Desinvestition im Cashflow aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Durch den Verkauf und die Entkonsolidierung der Süss MicroTec Test Systems GmbH sind am 27. Januar 2010 Zahlungsmittel dieser Gesellschaft in Höhe von T€ 2.834 aus dem Konzern abgeflossen. Mit dem Erwerb und der Erstkonsolidierung der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der HamaTech Beteiligungs GmbH hat der Konzern am 15. Februar 2010 Zahlungsmittel dieser Gesellschaften in Höhe von T€ 220 übernommen.

### (33) SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

#### Informationen zu den Segmenten

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IFRS 8 („Operating Segments“) nach Produktlinien als primärem Berichtsformat und nach Regionen als sekundärem Berichtsformat abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung sowie Berichterstattung und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden in die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment aufgeteilt. Zusammen mit dem Segment Sonstige werden diese Aktivitäten in der Segmentberichterstattung unter den fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen. Im Segment Sonstige werden weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt. Unter den nicht fortgeführten Aktivitäten wird das Segment Test Systeme ausgewiesen.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS-Konzern die Produktlinien Mask Aligner und Coater. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Vaihingen bzw. Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist in den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.

Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind bis zum Ende des Berichtsjahres vor allem am Standort Waterbury, Vermont, in den USA konzentriert. Der Vertrieb ist über Waterbury hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa und in Asien ansässig. In diesem Segment bildet der XBC300, ein Produktions-Bonder für bis zu 300-mm-Wafern, die Ausgangsplattform für die drei wichtigsten Bondtechniken im Bereich der 3D-Integration (einer unserer Zukunftsmärkte): das temporäre und permanente Bonden sowie das Debonden. Zu den Schlüsseltechnologien, die die 3D-Integration erfordert, zählt darüber hinaus das Dünnen von Wafern sowie die weitere Handhabung dieser äußerst fragilen Substrate („Thin Wafer Handling“). Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6- und 8-Zoll-Wafer-Anwendungen angeboten. Im Zuge der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs nach Deutschland wird der Standort Waterbury im ersten Halbjahr 2011 geschlossen werden. Produktion, Forschung und Entwicklung sowie das Produktmanagement werden nach Sternenfels verlagert werden.

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien HMx, ASx, MaskTrack und MaskTrack Pro der am 15. Februar 2010 akquirierten HamaTech APE GmbH & Co. KG. Die Entwicklung und Produktion der auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisierten Systeme ist am Standort Sternenfels angesiedelt.

Das in Sacka bei Dresden angesiedelte Segment Test Systeme ist am 27. Januar 2010 verkauft worden. Die im Berichtsjahr noch angefallenen Geschäftsvorfälle werden in der Segmentberichterstattung als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen. Das Segment Test Systeme umfasste die Entwicklung, Produktion sowie den Vertrieb in Europa von Test-Equipment. Die Test Systeme sind im Wesentlichen für Laboranwendungen, insbesondere z.B. für die Fehleranalyse, aber auch teilweise für Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme) bestimmt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Maskenbereich, im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.

#### **Sonstige Erläuterungen zur Segmentberichterstattung**

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. In Folge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten auch die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Systembetrieb von SAP.

Um den Anforderungen des IFRS 8 „Segmentberichterstattung“ zu entsprechen, enthält die Segmentberichterstattung die Angabe eines Vorsteuerergebnisses je Segment. Damit ist die Überleitung der Summe der Segmentergebnisse zum Gesamtkonzernergebnis vor Steuern möglich.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch der Personalaufwand aus den Aktienoptionsplänen sowie die Auflösung von Rückstellungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inkl. Geschäfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Die Abschreibungen enthielten im Vorjahr Wertminderungen in Höhe von T€ 4.690. Diese resultierten ausschließlich aus der Bewertung zum beizulegenden Wert im Zusammenhang mit den nicht fortgeführten Aktivitäten im Bereich Test Systeme.

Für die geographische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. Eine Erhebung dieser Information für das Inland ist nicht Gegenstand des Konzernreportings. Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standortes der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt.

## (34) VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

### Vorstand der Konzernobergesellschaft

Mitglieder des Vorstandes der SÜSS MicroTec AG im Jahr 2010 waren:

<b>Frank Averdung</b>	Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender
Zuständigkeitsbereiche:	Vertrieb, Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung, Materialwirtschaft, Logistik, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen und Konzernstrategie
<b>Michael Knopp</b>	Diplom-Kaufmann, Ratingen, Mitglied des Vorstands
Zuständigkeitsbereiche:	Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Facility Management, Investor Relations

Die Bezüge des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert. Eine nachträgliche Änderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die gesamte Barvergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr T€ 828. Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschließlich der Zuschüsse zur Sozialversicherung und dem geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des Firmenfahrzeugs) wurden Herrn Averdung T€ 97 und Herrn Knopp T€ 85 aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Rückstellung für den variablen Gehaltsbestandteil ausbezahlt.

Für den Jahresbonus 2010 von Herrn Averdung und Herrn Knopp wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung von T€ 338 gebildet.

Diese Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

2010 in T€	Frank Averdung	Michael Knopp
<b>Barvergütung</b>		
Fixum	267	223
Erfolgsbezogen	188	150
<b>Summe</b>	<b>455</b>	<b>373</b>

Weiterhin wurden aufgrund der an Vorstände gewährten Optionen T€ 64 (2009: T€ 69) als Personalaufwand in der Holding erfasst.

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von T€ 7 (2009: T€ 5).

Zudem wurden Gehaltszahlungen in Höhe von T€ 0 (2009: T€ 195) an ein ehemaliges Vorstandsmitglied geleistet.

**Aufsichtsrat**

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2010:

**Dr. Stefan Reineck** Kirchartd, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender

weitere Mandate: AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
NanoScape AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
Bosch Solar CISTech GmbH, Brandenburg an der Havel (Mitglied im Beirat)  
Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im „Board of Directors“)  
VHF-Technologies SA, Yverdon-les-Bains, Schweiz (Vorsitzender des Verwaltungsrats)

**Jan Teichert** Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar

weitere Mandate: keine

**Sebastian Reppegather** Zürich, Investment Director bei der Fidinam S.A., Lugano, Schweiz

weitere Mandate: Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands (Mitglied im „Board of Directors“)  
IED Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main (Mitglied der Geschäftsführung bis zum 29. Dezember 2010)  
International Equity Development S.L., Barcelona, Spanien (Mitglied der Geschäftsführung seit 6. August 2010)

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen eine feste Vergütung pro Geschäftsjahr. Gemäß der Satzungsänderung vom 23. Juni 2010 erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats T€ 45 p.a., sein Stellvertreter T€ 40 p.a. und jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats T€ 35 p.a. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von T€ 1,5 für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse.

Im Einzelnen setzen sich die Aufsichtsratsvergütungen für das abgelaufene Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

2010 in €	Zeitraum der Zugehörigkeit	Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz	Gesamt
Sebastian Reppegather	ganzjährig	35.000,00	13.500,00	4.910,76	53.410,76
Dr. Stefan Reineck	ganzjährig	45.000,00	13.500,00	6.756,14	65.256,14
Jan Teichert	ganzjährig	40.000,00	13.500,00	201,75	53.701,75

Im Vorjahr setzten sich die Aufsichtsratsvergütungen wie folgt zusammen:

2009 in €	Zeitraum der Zugehörigkeit	Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz und Umsatzsteuer	Gesamt
Sebastian Reppegather	ab 24.06.2009	17.500,00	7.500,00	4.050,00	29.050,00
Dr. Franz Richter	bis 24.06.2009	22.500,00	6.000,00	5.415,00	33.915,00
Dr. Stefan Reineck	ganzjährig	42.500,00	13.500,00	21.321,50	77.321,50
Jan Teichert	ganzjährig	37.500,00	13.500,00	9.690,00	60.690,00



Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

	2010		2009	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Michael Knopp	37.500	97.500	22.500	97.500
Frank Averdung	42.500	67.500	27.500	67.500
Dr. Stefan Reineck	9.600	40.000	9.600	40.000

### (35) MITARBEITER

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 591 Mitarbeiter (2009: 623 Mitarbeiter) in der SÜSS-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2010	2009
Verwaltung	74	79
Marketing und Vertrieb	234	238
Produktion und Technik	308	297
<b>Summe</b>	<b>616</b>	<b>614</b>

### (36) HONORARE DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Das im Geschäftsjahr für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erfasste Honorar nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB n. F. beträgt T€ 320 (2009: T€ 226) und setzt sich wie folgt zusammen:

in T€	2010	2009
Abschlussprüfung	284	224
Steuerberatung	36	0
Sonstige Leistungen	0	2
<b>Gesamt</b>	<b>320</b>	<b>226</b>

Die Position Abschlussprüfung enthält das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften. Enthalten ist außerdem das Honorar für die Unterstützung bei der Anfang 2010 durchgeführten Prüfung durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung.

Das Honorar für Steuerberatung betrifft die steuerliche Beratung der SÜSS MicroTec AG in ausgewählten steuerlichen Einzelfragen sowie die laufende steuerliche Beratung der HamaTech APE GmbH & Co. KG.

### (37) CORPORATE GOVERNANCE

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im November 2010 die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 mit vier Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung / Stimmrechtsvertreter, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprochen haben und zukünftig der aktualisierten Fassung vom 26. Mai 2010 mit fünf Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung / Stimmrechtsvertreter, Briefwahl / Stimmrechtsvertreter, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprechen werden.

Die Entsprechenserklärung wurde im Internet unter [www.suss.com](http://www.suss.com) dauerhaft zugänglich gemacht.

### (38) ANGABE GEMÄSS § 160 NR. 8 AKTG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Am 15. Januar 2010 hat uns Herr Tito Tettamanti, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Januar 2010 die Schwelle von 20 % unterschritten hat und zu diesem Tag 19,70 % beträgt (3.352.152 Stimmrechte von 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihm 19,70 % (3.352.152 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihm zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man
- Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 15. Januar 2010 hat uns die Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Januar 2010 die Schwelle von 20 % unterschritten hat und zu diesem Tag 19,70 % beträgt (3.352.152 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihr 19,70 % (3.352.152 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihr zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 15. Januar 2010 hat uns die Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Januar 2010 die Schwelle von 20 % unterschritten hat und zu diesem Tag 19,70 % beträgt (3.352.152 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten).

Am 25. Mai 2010 hat uns die Falcivest, SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. Mai 2010 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,78 % beträgt (520.267 Stimmrechte).

Am 25. Mai 2010 hat uns die Stichting Vest (vormals firmierend unter Terramater [Stichting]), Amsterdam, Niederlande, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. Mai 2010 die Schwelle von 10 % unterschritten hat und zu diesem Tag 9,44 % beträgt (1.766.348 Stimmrechte). Davon sind der Stichting Vest 9,44 % (1.766.348 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die der Stichting Vest zuzurechnenden Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- Süssvest SCS (vormals Süss SCS), Strassen, Luxemburg

Am 25. Mai 2010 hat uns die Crest S.A., Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. Mai 2010 die Schwelle von 10 % unterschritten hat und zu diesem Tag 9,44 % beträgt (1.766.348 Stimmrechte). Davon sind der Crest Capital S.A. 9,44 % (1.766.348 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die der Crest Capital S.A. zuzurechnenden Stimmrechte waren dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- Süssvest SCS (vormals Süss SCS), Strassen, Luxemburg

Am 25. Mai 2010 hat uns die Equinet AG, Frankfurt am Main, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. Mai 2010 die Schwellen von 3 % und 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 9,09 % beträgt (1.701.912 Stimmrechte).

Am 25. Mai 2010 hat uns die Equinet AG, Frankfurt am Main, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 25. Mai 2010 die Schwellen von 3 % und 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0,00 % beträgt (0 Stimmrechte).

Am 20. September 2010 hat uns die Swiss & Global Asset Management AG, Zürich, Schweiz, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 15. September 2010 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,10 % beträgt (580.000 Stimmrechte). Davon sind der Swiss & Gobal Asset Management AG 2,83 % (530.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Am 20. September 2010 hat uns die Swiss & Global Asset Management Holding AG, Zürich, Schweiz, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 15. September 2010 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,10 % beträgt (580.000 Stimmrechte). Davon sind der Swiss & Gobal Asset Management AG 2,83 % (530.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i.V.m. Satz 2 WpHG zuzurechnen und 0,27 % (50.000 Stimmrechte) werden der Swiss & Global Asset Management Holding AG nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet.

Am 20. September 2010 hat uns die GAM Holding AG, Zürich, Schweiz, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 15. September 2010 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,10 % beträgt (580.000 Stimmrechte). Davon sind der GAM Holding AG 2,83 % (530.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i.V.m. Satz 2 WpHG zuzurechnen und 0,27 % (50.000 Stimmrechte) werden der GAM Holding AG nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet.

Am 10. November 2010 hat uns die Süssvest SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 9. November 2010 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,49 % beträgt (840.056 Stimmrechte).

Am 10. November 2010 hat uns die Stichting Vest, Amsterdam, Niederlande, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 9. November 2010 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,49 % beträgt (840.056 Stimmrechte). Davon sind der Stichting Vest 4,49 % (840.056 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die der Stichting Vest zuzurechnenden Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- Süssvest SCS, Strassen, Luxemburg

Am 10. November 2010 hat uns die Crest Capital S.A., Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 9. November 2010 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,49 % beträgt (840.056 Stimmrechte). Davon sind der Crest Capital S.A. 4,49 % (840.056 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die der Crest Capital S.A. zuzurechnenden Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Süss Micro-Tec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- Süssvest SCS, Strassen, Luxemburg

Am 10. Dezember 2010 hat uns Herr Tito Tettamanti, Schweiz, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 10. Dezember 2010 die Schwellen von 15 %, 10 %, 5 % und 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0,00 % beträgt (0 Stimmrechte von 18.721.038 Stimmrechten).

Am 10. Dezember 2010 hat uns Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 10. Dezember 2010 die Schwellen von 15 %, 10 %, 5 % und 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0,00 % beträgt (0 Stimmrechte von 18.721.038 Stimmrechten).

Am 10. Dezember 2010 hat uns Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 10. Dezember 2010 die Schwellen von 15 %, 10 %, 5 % und 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0,00 % beträgt (0 Stimmrechte von 18.721.038 Stimmrechten).

Am 16. Dezember 2010 hat uns die Deutsche Bank AG London, Großbritannien, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG in Verbindung mit § 32 Abs. 2 InvG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 14. Dezember 2010 die Schwellen von 3 % und 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 8,68 % beträgt (1.625.000 Stimmrechte von insgesamt 18.721.038 Stimmrechten).

Am 28. Dezember 2010 hat uns die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 27. Dezember 2010 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,12 % beträgt (585.000 Stimmrechte).

Am 28. Dezember 2010 hat uns die Swiss & Global Asset Management AG, Zürich, Schweiz, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. Dezember 2010 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,83 % beträgt (530.000 Stimmrechte). Davon sind der Swiss & Global Asset Management AG 2,83 % (530.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Am 28. Dezember 2010 hat uns die Swiss & Global Asset Management Holding AG, Zürich, Schweiz, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. Dezember 2010 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,83 % beträgt (530.000 Stimmrechte). Davon sind der Swiss & Global Asset Management AG 2,83 % (530.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i.V.m. Satz 2 WpHG zuzurechnen.

Am 28. Dezember 2010 hat uns die GAM Holding AG, Zürich, Schweiz, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil

an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. Dezember 2010 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,83 % beträgt (530.000 Stimmrechte). Davon sind der GAM Holding AG 2,83 % (530.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i.V.m. Satz 2 WpHG zuzurechnen.

Am 13. Januar 2011 hat uns die Süssvest SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte).

Am 13. Januar 2011 hat uns die Stichting Vest, Amsterdam, Niederlande, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte). Davon sind der Stichting Vest 2,3078 % (432.049 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Am 13. Januar 2011 hat uns die Crest Capital S.A., Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte). Davon sind der Crest Capital S.A. 2,3078 % (432.049 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Am 1. Februar 2011 hat uns die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 1. Februar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,94 % beträgt (550.000 Stimmrechte).

Die Credit Suisse Fund Management S.A. Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. März 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. Februar 2011 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,35 % beträgt (627.435 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,99 % (185.380 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

### (39) FREIGABE DES ABSCHLUSSES

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS Konzernabschluss am 18. März 2011 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 18. März 2011

Der Vorstand

Frank Averdung

Michael Knopp

## VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching, 18. März 2011

SÜSS MicroTec AG



Frank Averdung



Michael Knopp

# BESTÄTIGUNGSVERMERK

des Abschlussprüfers

Wir haben den von der SÜSS MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie ihren Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 18. März 2011

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Renner  
Wirtschaftsprüfer

Dr. Rüttler  
Wirtschaftsprüfer

# GLOSSAR

## ■ 3D-Integration

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien: das 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging bezeichnet Bauteile, die auf Wafer-Level-Packaging-Ebene gestapelt werden, ohne durch sogenannte „Through Silicon Vias“ (TSV) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging werden Technologien wie SOC (Systems-on-Chip) sowie weitere Verfahren subsumiert, bei denen die Verbindung üblicherweise auf Wire-Bonding („Drahtbonden“) basiert. 3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile, die durch „Through Silicon Vias“ (TSVs) verbunden sind. Dabei handelt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das in der Regel stark gedünnte massive Silizium.

## ■ 300-mm-Technologie

Wafer sind runde Scheiben z.B. aus einkristallinem Reist-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (~42%) der heute weltweit verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 300 mm. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können. Je höher die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro einzelner Chip.

## ■ Advanced Packaging

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Unter

„Advanced Packaging“ versteht man weiterentwickelte Packagingverfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im sogenannten „Frontend“ der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

## ■ Backend

„Backend“ bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat („Frontend“), beginnt der „Backend“-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der „Backend“-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene „Backend“-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundries) durchführen lassen.

## ■ Bonden

Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z.B. bedeutet „adhesives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (Van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Durch ein anschließendes Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid

(kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nicht lösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

## ■ Bump

(Engl.: Unebenheit); Metallische (Lot, Gold o.Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugeln auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

## ■ Chip

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlussstelle, mit der der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire- oder Flip-Chip-Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

## ■ Cluster

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen (z.B. Coater, Aligner), die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestückt wird.

## ■ Coater (Beschichtungsgerät)

Coater sind Spezialmaschinen für die Halbleiterfertigung, die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft auf dem Wafer verteilen.

## ■ Compound Semiconductor

Siehe Verbindungshalbleiter.

## ■ Cost of Ownership (CoO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann



in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die „Cost of Ownership“ der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders im Rahmen der Massenproduktion von großer Bedeutung.

#### ■ C4NP

IBM hat in den späten sechziger Jahren den Weg für das Flip-Chip-Bonding bereitet. Zum ersten Mal wurde diese Technologie 1973 in dem „IBM System 3“ eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen „IBM C4“ Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. „C4“ steht für „Controlled Collapse Chip Connection“ und wird teilweise auch synonym für Flip-Chip-Bonding verwendet. „C4NP“ ist die Technologie der nächsten Generation, die IBM gemeinsam mit SÜSS MicroTec auf Basis des bewährten C4-Prozesses entwickelt hat. „NP“ steht dabei für New Process.

#### ■ Die

„Die“, „IC“ (Integrated Circuit) und „Chip“ sind oft synonym verwendete Begriffe. „Die“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse integriert wurden. Solange der Wafer also die einzelnen Prozessschritte durchläuft, spricht man von „Dies“. Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der Dies spricht man von „Chips“.

#### ■ DRAM

DRAM = Dynamic Random Access Memory. Elektronischer Speicherbaustein, der hauptsächlich in Computern eingesetzt wird. Weltweit am weitesten verbreitetster Speicherchip.

#### ■ Fab

(engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von ICs auf Wafern (Chips)

spezialisiert haben. Die Errichtung einer großen modernen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis zu 4 Mrd USD.

#### ■ Flip-Chip-Bonding

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d.h., der Chip muss vor der Montage umgedreht werden (engl.: to flip).

#### ■ Fotoresist

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, sodass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

#### ■ Foundry

Eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für den Vertrieb und das Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre F&E-Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die weltweit führenden Foundrys sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

#### ■ Frontend

„Frontend“-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an

sich hergestellt. Danach schließt sich das „Backend“ an. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

#### ■ Halbleiter

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

#### ■ IC

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

#### ■ LED

Light Emitting Diode. Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnfache Lebensdauer wie eine normale Glühlampe.

#### ■ Lithografie

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material

(Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske werden so mittels Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im „Frontend“ liegen heute in einer Größenordnung von 32 nm (0,032 Mikrometer) bis 0,6 Mikrometer. Im „Backend“ werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z.B. um die Bumps für das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

#### ■ Mask Aligner (Belichtungsgerät)

Mask Aligner richten eine Glasmasken submikrometerngenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmasken wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

#### ■ Maske

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines ICs benötigt werden. Die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise.

#### ■ MEMS

Micro Electro Mechanical System. MEMS ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der

Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

#### ■ Mikrometer / Mikron

Metrisches Längenmaß. Symbol:  $\mu\text{m}$ . Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60  $\mu\text{m}$ .

#### ■ Mikrosystem

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

#### ■ Mikrosystemtechnik

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Mikro System Technology oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z.B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z.B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, er wird zum Auslösen des Airbags eingesetzt, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

#### ■ Nanoimprinting / Nano Imprint Lithografie (NIL)

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt

werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter-Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

#### ■ Nanotechnologie

(griech.: nānos = Zwerg) ist ein Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehrere hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10<sup>-9</sup> m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometer-Bereich zu schaffen.

#### ■ Optoelektronik

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit sogenannten III/V-Materialien wie z.B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (Faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

#### ■ Packaging Foundries

Siehe Backend.

#### ■ Prober (Test- und Prüfsysteme)

Prober führen individuelle analytische Tests von Mikrochips durch. Mit Hilfe von Mess-Spitzen werden elektrische Signale von mikroskopisch kleinen Strukturen innerhalb des Chips aufgegriffen und ausgewertet. Oder Belastungstests mittels Druck, Strom, Kraft, Hitze oder Kälte zeigen, ob die Chips den Anforderungen gerecht werden, und weisen frühzeitig auf Fehler hin. Der modulare Aufbau unserer Prober macht diese äußerst flexibel, was insbesondere in Entwicklungsprojekten sehr geschätzt wird.

#### ■ Sensor

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung. Diese Größe wird in ein elektrisches Signal umgewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

#### ■ Silizium

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften. Halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

#### ■ Substrat Bonder (Verbindungsgerät)

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Löten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können unsere Airbags, Reifendruckensoren,

GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker etc. funktionieren.

#### ■ Systems-on-Chip

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten. Bis vor kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige erforderlich sind oder ein einzelner ausreicht und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht Systems-on-Chips immer größere Wichtigkeit.

#### ■ Through-Silicon-Vias (TSV)

Bei der „Through-Silicon-Via“-Technik werden die einzelnen Chipkomponenten übereinander gestapelt und mittels vertikaler Durchkontaktierungen („Through-Silicon-Via“) miteinander verbunden. Dadurch verkürzt sich der Weg des Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten und lassen sich Kapazitätsverluste wesentlich reduzieren. Through-Silicon-Vias tragen somit zu einer Verringerung der Baugröße von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit bei.

#### ■ Tool

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw. Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zur einer Produktionslinie kombiniert werden.

#### ■ Verbindungshalbleiter

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.). Vorteile gegenüber einfachen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell, können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

#### ■ Wafer

Runde Scheiben z.B. aus Reinst-Silizium oder Verbindungshalbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid etc.), auf denen Chips produziert werden. In den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300 mm vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300 mm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200 mm-Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30 % niedriger.

#### ■ Wire-Bonding

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden.

#### ■ Yield

Die Ausbeute – eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

# FINANZKALENDER 2011

Geschäftsbericht 2010	30. Mrz.
FCF Investorenkonferenz, Abu Dhabi	4. Apr.
Quartalsbericht 2011	5. Mai.
Photonics-Konferenz, München	24. Mai.
Sustainable Technologies Conference, Zürich	8. Jun.
Hauptversammlung, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München	21. Jun.
Halbjahresfinanzbericht 2011	4. Aug.
Neunmonatsbericht 2011	8. Nov.
TMT Konferenz Morgan Stanley, Barcelona	16.–18. Nov.
Deutsches Eigenkapitalforum Herbst 2011	21.–23. Nov.

# IMPRESSUM & KONTAKT

## IMPRESSUM

<b>Herausgeber</b>	SÜSS MicroTec AG
<b>Redaktion</b>	Investor Relations, Finance
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	KPMG Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
<b>Konzept und Gestaltung</b>	Whitepark GmbH & Co., Hamburg
<b>Druck</b>	Druckerei BluePrint Group, Munich
<b>Fotos</b>	Michael Lange, SÜSS MicroTec AG

## KONTAKT

SÜSS MicroTec AG  
Schleißheimer Straße 90  
85748 Garching, Deutschland  
Fon: +49 (0)89-32007-0  
E-Mail: [info@suss.com](mailto:info@suss.com)

Investor Relations  
Fon: +49 (0)89-32007-161  
E-Mail: [ir@suss.com](mailto:ir@suss.com)

**Zukunftsorientierte Aussagen:** Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.





SÜSS MicroTec AG  
Schleißheimer Straße 90  
85748 Garching, Deutschland  
Fon: +49 (0)89-32007-0  
E-Mail: [info@suss.com](mailto:info@suss.com)

[www.suss.com](http://www.suss.com)